

วิวัฒนาการของการเกิดอินเดียมอร์เช่ในศตวรรษที่ปัจจุบันแผ่นดินลายตาราง

นายธีรวัฒน์ ลิมวงศ์

สถาบันวิทยบริการ

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาชีวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาชีวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2551

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

EVOLUTION OF InAs QUANTUM DOTS GROWN ON CROSS-HATCH SUBSTRATES

Mr. Teeravat Limwongse

สถาบันวิทยบริการ

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Engineering Program in Electrical Engineering

Department of Electrical Engineering

Faculty of Engineering

Chulalongkorn University

Academic Year 2008

Copyright of Chulalongkorn University

หัวข้อวิทยานิพนธ์	วิวัฒนาการของการเกิดอินเด็กมอร์เซ่ในค้วอนดัมคอตที่ปลูกบนแผ่นดินลาดตาร่าง
โดย	นายธีรวัฒน์ ลิ่มนวงศ์
สาขาวิชา	วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก	รองศาสตราจารย์ ดร. ทรงพล กาญจนชัย
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม	ดร. ชัยชนะ ธรรมานนท์

คณะกรรมการสาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

..... คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ดร. บุญสม เลิศหริรักษ์)

คณะกรรมการสอนวิทยานิพนธ์

..... ประธานกรรมการ
(ศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
(รองศาสตราจารย์ ดร. ทรงพล กาญจนชัย)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
(ดร. ชัยชนะ ธรรมานนท์)

..... กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย
(ดร. สุวัฒน์ ไสวศิรพันธ์)

..... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร. มนตรี สวัสดิศรุตงมา)

ธีรัตน์ ลิ่มวงศ์ : วิพัฒนาการของการเกิดอินเดียมอร์เซในคุณค่าต้นดอตที่ปูกรอบนแผ่นฐานลายตาราง。
(EVOLUTION OF InAs QUANTUM DOTS GROWN ON CROSS-HATCH SUBSTRATES)

อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : รองศาสตราจารย์ ดร. ทรงพล กาญจนชัย, อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม :
ดร. ชัยชาดา ชนชยานนท์, 96 หน้า.

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอวิพัฒนาการของการเกิด InAs คุณค่าต้นดอตบนแผ่นฐานลายตาราง InGaAs ซึ่งเริ่มน้ำจากการสังเกตการณ์การเกิดคุณค่าต้นดอตบนแผ่นฐานลายตาราง พนักงานกลุ่มของคุณค่าต้นดอต ในแต่ละ คำแห่งนี้มีช่วงความสูงที่แตกต่างกัน จากการทำ Image thresholding ของชิ้นงานดังกล่าว ได้แบ่งคุณค่าต้นดอต บนผิวน้ำออกได้เป็น 4 กลุ่ม เรียงตามความสูงจากมากไปน้อยได้แก่ กลุ่มคุณค่าต้นดอตที่จุดตัดของลายตาราง กลุ่มคุณค่าต้นดอตบนแนวเส้นลายตารางที่ขนานกับทิศ [1-10] ตามด้วยทิศ [110] และกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่ม คุณค่าต้นดอตบนพื้นเรียบที่ไม่มีลายตาราง ซึ่งได้ตั้งสมมติฐานว่าคุณค่าต้นดอตทั้ง 4 กลุ่มนี้มีลำดับการเกิด ก่อนหลังตามความสูงที่จัดกลุ่มไว้ โดยกลุ่มที่สูงกว่าก่อตัวขึ้นก่อน

เพื่อพิสูจน์ข้อสมมติฐานข้างต้น คุณสมบัติของชิ้นลายตารางซึ่งถูกปรับทั้งสัดส่วน In ใน InGaAs และ ความหนาของชิ้นลายตาราง และได้ผลว่า เมื่อสัดส่วนของ In และความหนาของชิ้น InGaAs ลดลงจะทำให้ความ หนาแน่นของเส้นของลายตารางลดลงทั้งแนว [1-10] และ [110] เนื่องจากทั้งสองวิธีมีผลในการลดความเครียด ภายในชิ้นลายตาราง ซึ่งความเครียดนี้ส่งผลต่อการเกิด Dislocation เมื่อทำการปูกรอบคุณค่าต้นดอตบนลาย ตาราง คุณค่าต้นดอตจะเรียงตัวตามเส้น Dislocations ที่เกิดขึ้นนี้ การทดลองอีกชุดหนึ่งคือการปรับปรุง InAs ในชิ้นคุณค่าต้นดอต โดยเปลี่ยนค่าเป็น 0.8, 0.76 และ 0.72 ML ขณะที่มีอัตราการปูกรอบที่คงที่ หรือทำการปูกร โดยหดตัวอัตราที่หดตัวที่คงที่ 0.8 ML ทั้งสองวิธีที่กล่าวมาให้ผลเชิงคุณภาพ เช่นเดียวกันซึ่งสามารถพิสูจน์ว่าวิพัฒนาการของการเกิด InAs คุณค่าต้นดอตบนแผ่นฐานลายตาราง InGaAs เริ่มต้นจากการก่อตัวของคุณค่าต้นดอต Threading dislocation (TD) ตามด้วยการก่อตัวที่จุดตัดของเส้นลาย ตาราง ตามด้วยการก่อตัวตามแนว Misfit dislocation (MD) ในทิศ [1-10] ตามด้วยตามแนว MD ในทิศ [110] และตามด้วยการก่อตัวบนพื้นเรียบ หลักการพื้นฐานที่ใช้อธิบายลำดับการก่อตัวดังกล่าวคือ การกระเข้าด้วยกัน ไม่สามารถของความเครียด รอบๆเส้น Dislocation ซึ่งแสดงให้เห็นด้วยการจำลอง

ภาควิชา..... วิศวกรรมไฟฟ้า..... ลายมือชื่อนิสิต..... นีรัตน์ ลิ่มวงศ์
สาขาวิชา..... วิศวกรรมไฟฟ้า..... ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก วงศ์ กาญจน์,
ปีการศึกษา 2551 ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม นิตา นิตา

4970362621 : MAJOR ELECTRICAL ENGINEERING

KEY WORD: / InAs QD / InGaAs / CROSS-HATCH / STRAIN / DISLOCATION

TEERAVAT LIMWONGSE : EVOLUTION OF InAs QUANTUM DOTS GROWN ON CROSS-HATCH SUBSTRATES. THESIS PRINCIPAL ADVISOR : ASSOC. PROF. SONGPHOL KANJANACHUCHAI, DR. THESIS COADVISOR : CHANCHANA THANACHAYANONT, DR., 96 pp.

This thesis reports the evolution of InAs QDs on InGaAs cross-hatch substrates. By observing the differences of QDs formed on the cross-hatch substrate, it is found that the heights are different. Image thresholding analyses indicate that surface QDs can be categorized into 4 groups in order of height: those formed at the intersection of the cross-hatch; those formed along the [1-10] direction, along the [110] direction, and those formed on the flat area. It is thus hypothesized that these 4 groups of QDs may form on cross-hatch in sequence, with taller dots being earlier formed.

In order to probe the above hypothesis, the properties of the cross-hatch layer are adjusted. Both the In composition in and the thickness of the InGaAs cross-hatch layer are varied. It is found that when the In content and the thickness of the InGaAs decrease, the line density of the cross-hatch in both [110] and [1-10] directions also decrease. This is due to the fact that both methods reduce the strain in the cross-hatch layer. Consequently, the dislocations are affected. When QDs are grown on the cross-hatch surface, they are aligned along these direction lines. In another set of experiment, the amount of InAs QD layer is varied by setting the deposited amount to 0.8, 0.76 and 0.72 ML while the substrate rotates, or by stopping substrate rotation and grow up to a nominal thickness of 0.8 ML. Both procedures yield the same qualitative results which prove that InAs quantum dots grown on cross-hatch substrates evolves from the formation of QDs *on* threading dislocation (TD), *at* the intersections of cross-hatches, *along* the [1-10] misfit dislocation (MD) lines, *along* the [110] MD lines, and *on* the flat area. The underlying principle which explains the formation sequence is asymmetrical strain distribution around dislocation lines which is shown by simulation.

Department.....Electrical Engineering..... Student's signature.....

Field of study.....Electrical Engineering Principal Advisor's signature.....

Academic year...2008..... Co-advisor's signature.....

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มิอาจดำเนินจดล่วง ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ หากขาดเครื่องมือทำ การทดลองและวิจัย รวมทั้งการช่วยเหลือและสนับสนุนจากผู้มีพระคุณทั้งหลายในห้องปฏิบัติการ วิจัยสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ ภาคไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เขียนขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษา รศ. ดร. ทรงพล กาญจนชุษย์ ที่เอื้อเฟื้อ ৎเวลาอันมีค่า เพื่อมาช่วยเหลือ คุ้มครองและให้คำปรึกษาอันมีประโยชน์ยิ่ง แก่ข้าพเจ้ามาตั้งแต่ ข้าพเจ้าเรียนปริญญาตรีจนกระทั่งจบการศึกษาระดับปริญญาโท

ผู้เขียนขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ดร. ชัยชนะ ชนชยานนท์ ที่เอื้อเฟื้อ ৎเวลาอันมีค่า ให้คำปรึกษา และให้คำแนะนำด้านสอนของนุ้มติดหัวข่าววิทยานิพนธ์

ผู้เขียนขอขอบคุณคณะกรรมการสอบอนุมัติหัวข่าววิทยานิพนธ์ สอบจบการศึกษา ประกอบไปด้วย ศ. ดร. สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว รศ.ดร.มนตรี สวัสดิศถุงมา ดร. สุวัฒน์ โสภิตพันธ์ และ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

ผู้เขียนขอขอบคุณพี่ๆห้องธุรกิจ ที่ให้ความช่วยเหลือด้านงานธุรกิจ และการ เทคนิค ประกอบไปด้วย พี่ศุภโชค และ พี่วัฒน์เรือน ไทยน้อย พี่พรชัย ช่างม่วง พี่พัฒนา พันธุวงศ์ และพี่ท่านอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวถึง

ผู้เขียนขอขอบคุณพี่ๆปริญญาโท และ ปริญญาเอก ทั้งที่จบไปแล้ว และที่ยังศึกษาอยู่ที่ให้ความช่วยเหลืออย่างอบอุ่นเรื่อยมา

ผู้เขียนขอขอบคุณศูนย์วิจัยร่วมเนพาระทางด้านส่วนประกอบชาร์ดิสก์ไครป์ (IUCRC in HDD Component) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีไทย (TGIST) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) ที่ให้ทุน สนับสนุนทุนการศึกษาและทุนวิจัย

สุดท้ายนี้ผู้เขียนขอขอบคุณครอบครัว ประกอบไปด้วย บิดา มารดา และญาติพี่น้อง ที่เป็นกำลังใจ และให้คำปรึกษาอย่างดีตลอดมา ประโยชน์อันใดที่เกิดจากข้าพเจ้าขอมอบเป็น เครื่องบูชาบูพาราเย็ตตลอดจนคุณบิดามารดาที่เป็นผู้มีพระคุณยิ่งต่อข้าพเจ้า

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	๑
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	๒
กิตติกรรมประกาศ.....	๓
สารบัญ.....	๔
สารบัญตาราง	๕
สารบัญภาพ.....	๖
 บทที่ 1 บทนำ.....	 1
 บทที่ 2 ทฤษฎีและความรู้พื้นฐาน	 5
2.1 เอเทอโรเอปิเทกซ์ (Heteroepitaxy).....	5
2.2 ความไม่พอดีกันของค่าคงที่ผลึก (Lattice mismatch).....	9
2.2.1 ความเครียดและการผ่อนคลายความเครียด.....	10
2.2.2 Dislocations.....	11
2.2.3 Surface steps.....	13
2.3 ควอนตัมโดต (Quantum dots).....	15
2.4 แผ่นฐานลายตาราง (Cross-hatch substrate).....	17
 บทที่ 3 การปลูกโครงสร้างและการวัดลักษณะสมบัติ.....	 22
3.1 การปลูกโครงสร้างด้วยเครื่องปลูกผลึกแบบลำไไมเลกุล.....	22
3.1.1 เครื่องปลูกผลึกแบบลำไไมเลกุล.....	23
3.1.2 ระบบตรวจวัดแบบเดดติงภายใน (in-situ).....	28
3.1.2.1 การวัดค่าความดันไอ (Flux measuring).....	29
3.1.2.2 RHEED (Reflective High-Energy Electron Diffraction).....	30
3.1.2.3 Quadrupole Mass Spectrometer.....	33
3.1.3 กระบวนการการปลูก.....	34
3.1.3.1 การเตรียมพิวหน้า.....	34
3.1.3.2 การปลูกชั้นผลึก.....	39
ก. ชั้นผลึกแบบก้อนผลึก.....	40

	หน้า
ช. ขั้นตอนต้มดอต.....	40
ก. ขั้นลายตาราง.....	42
ง. ขั้นกลบทับ.....	43
3.2 การวัดลักษณะสมบัติด้วยระบบวัดติดตั้งภายนอก (ex-situ).....	44
3.2.1 กล้องจุลทรรศน์แรงดันต่ำ (AFM).....	44
3.2.2 ระบบวัดไฟฟ์คลูมินสเซนส์ (PL).....	39
 บทที่ 4 ผลการทดลองและการวิเคราะห์.....	 48
4.1 ความต้มดอตบนลายตาราง.....	48
4.1.1 การเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนอินเดียมต่อแกลเลียม (ค่า X ใน $In_xGa_{1-x}As$).....	49
4.1.2 การเปลี่ยนแปลงความหนาชั้นลายตาราง.....	50
4.2 วิัฒนาการของการเกิดความต้มดอตบนลายตาราง.....	53
4.2.1 วิธีที่ 1 (ชิ้นงาน น0817 และ น0815).....	56
4.2.2 วิธีที่ 2 (ชิ้นงาน น0840).....	60
4.3 สาเหตุการเกิดความต้มดอตพื้นผิวลายตาราง.....	63
4.4 คุณสมบัติเชิงแสงของความต้มดอตโไมล์คูล.....	65
 บทที่ 5 สรุป.....	 68
 รายการอ้างอิง.....	 70
ภาคผนวก.....	75
ผลงานตีพิมพ์.....	81
ผลงานนำเสนอ.....	82
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์.....	83

สารบัญตาราง

ตาราง	หน้า
2.1 คุณสมบัติทางกายภาพของ InAs, GaAs และ InGaAs [10].....	9



สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญภาพ

หน้า
2.1	แผนภาพเฟสสมดุล (Equilibrium phase diagram) ในรูปของฟังก์ชันระหว่าง H กับ ε ^{.....}
	โดยภาพประกอบด้านบนและล่างแสดงถึงลักษณะของผิวน้ำของโภมดต่างๆ
	ทั้ง 6 โภมด สามเหลี่ยมเล็กสีขาวแทนโครงสร้างเกาสามมิติที่มีเสถียรภาพ
	สามเหลี่ยมใหญ่รูปหลายเหลี่ยมในแทนโครงสร้างเกาสามมิติที่โตเต็มที่ (Ripening island)
	เฟสแต่ละรูปแบบลูกแบ่งด้วยเส้นขอบเขต $Hc_1(\epsilon)$: FM-R ₁ , FM-SK ₁ ; $Hc_2(\epsilon)$: SK ₁ -R ₂ ;
	$Hc_3(\epsilon)$: SK ₂ -SK ₁ ; $Hc_4(\epsilon)$: VW-SK ₂ , VW-R ₃6
2.2	Unit cell และขอบเขตของค่าคงที่ผลึกของ GaAs.....10
2.3	การเกิดชั้นผลึกของคู่สารที่ไม่เข้ากันแบบอัดตัว (Compressive).....10
2.4	รูปแบบของ dislocation แบบ (a) Edge dislocation โดย b คือ Bergers vector เส้นที่เกิดจากการแยกของชั้นคือ dislocation line และ (b) Screw dislocation.....11
2.5	Dislocation ของฟิล์มที่ปลูกบนแผ่นฐานแบบมีความไม่เข้ากันของค่าคงที่ผลึก (a) Slip plane ของ (001)-Face Center Cubic (FCC) และ Misfit dislocation และ Threading dislocation ที่เกิดขึ้น (b) Bergers vector ของ Slip plane ดังกล่าวแยกย่อยเป็น Edge-, Screw Bergers vector.....12
2.6	TD และ MD (a) เมื่อ $h < h_c$ ยังไม่ปรากฏ MD ขึ้น และ TD มาจากแผ่นฐานเท่านั้น (b) เมื่อ $h > h_c$ แล้ว TD จะเริ่มเคลื่อนและทำให้ MD ขยาย $\Delta\lambda$ ตามความหนา dh ที่มากขึ้น (c) เมื่อ TD เคลื่อนมาจับพนกับ MD อิสระที่วางอยู่ TD จะหยุดเคลื่อนที่กลายเป็น Immobile TD13
2.7	การเกิด Surface step elimination (a) ชั้นฟิล์มเกิด Compressive strain (b) เกิด Dislocations และ Surface steps ตามมา (c) เมื่อเพิ่มความหนาต่อไปจะเกิดเนินที่เกิดจาก Surface step elimination.....14
2.8	(ແຄວນ) โครงสร้างแบบก้อนผลึก, แบบความต้มเวลา และแบบความต้มดอต (ແຄາກລາງ) สถานะแบบขั้นของความต้มเวลา และความต้มดอต (ແຄວ່າງ) ความหนาแน่นสถานะ (DOS).....15
2.9	ระดับพลังงานภายในของโครงสร้างแบบก้อนผลึก (ซ้าย) และความต้มดอต (ขวา).....16
2.10	ลักษณะของการเกิดความต้มดอต InAs บนแผ่นฐาน GaAs แบบ SK.....17
2.11	ผิวน้ำของความต้มดอต Ge ปลูกบน SiGe/Si (100) ที่วัดค่ายกล้องจุลทรรศน์ แรงอะตอม.....19

รูปที่	หน้า
2.12 ผิวหน้าลายตารางจากสารประกอบอนุมูลท์ III-V (a) $In_{0.2}Ga_{0.8}As$ 50 nm บน GaAs (001) (b) เมื่อปลูกทับด้วยความตื้นด้วย InAs 0.8 ML ทั้ง (a) และ (b) วางแผนทิศทางเดียวกัน ตามลูกศร.....	19
2.13 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาของชั้น InGaAs (Monolayer) ที่ปลูกบน GaAs กับสัดส่วนของ In (ค่า X).....	20
3.1 เครื่องปั๊กผลึกแบบลำโมเลกุล RIBER 32P.....	23
3.2 Diaphragm pump.....	24
3.3 รูปแบบโมเลกุลของ Zeolite (ซ้าย) ตัวอย่าง Sorption pump (กลาง) และ ภาคตัดขวาง (ขวา).....	25
3.4 แผนภาพอย่างง่ายภายในห้องปั๊กของเครื่องปั๊กผลึกแบบลำโมเลกุล.....	26
3.5 ภาพจากกล้องจุลทรรศน์แรงดึงดูดแสดงผิวหน้าของชั้นงานเดียวกันเมื่อวัด (ก) ทันที หลังจากปั๊ก และ (ข) เมื่อปล่อยทิ้งไว้ 4 เดือน.....	28
3.6 แผนผังแสดงระบบ RHEED.....	30
3.7 RHEED pattern (ก) ผิวหน้า GaAs ที่เรียบ (ข) ผิวหน้าของแผ่นฐาน GaAs หลัง De-ox และ (ค) ผิวหน้าของ InAs ความตื้นด้วยอบบนแผ่นฐาน GaAs.....	31
3.8 (ซ้าย) Specular beam (ขวา) ตำแหน่งของ Specular beam บน RHEED screen เมื่อถ่าย อิเล็กตรอนยิงมาทางทิศ [1-10].....	31
3.9 ความสัมพันธ์ของลักษณะผิวหน้าและ RHEED oscillation (a) การก่อตัวของ GaAs บน GaAs (001) 1 ML จาก A ไป E (b) การสั่นของความสว่างของ Specular beam (00) ขณะทำการปั๊ก GaAs บนแผ่นฐาน GaAs (100) (c) ความสว่างของ Specular beam กับการก่อตัวของผลึกใน (a)	32
3.10 แผนภาพการทำงานของ Quadrupole mass analyzer.....	33
3.11 Profile ของโปรแกรมอัตโนมัติของกระบวนการ Heat treatment (Pre-heat).....	35
3.12 Profile ของกระบวนการ De-gas ช่องสาร In และ Ga.....	36
3.13 Profile ของกระบวนการ De-ox ที่รวมขั้นตอนการวัดแรงดันไอของ As_4 ด้วย.....	37
3.14 แผนภาพแสดง RHEED pattern ณ อุณหภูมิ T_1-T_4 สำหรับการหา T_{trans}	39
3.15 ภาพจาก RHEED screen ขณะปั๊กความตื้นด้วย InAs บนแผ่นฐานลายตาราง $In_{0.15}Ga_{0.85}As/GaAs$ (a) เมื่อเริ่มเกิดความตื้นด้วย (b) เกิดความตื้นด้วยแล้ว (c) Chevron pattern.....	40
3.16 ความสัมพันธ์ของ Chevron pattern ต่อลักษณะทางกายภาพของความตื้นด้วย.....	41

รูปที่	หน้า
3.17	การกลบหับแบบบางสำหรับปลูกโกรงสร้างความตันดอตความหนาแน่นสูง (a) กลบหับแบบบางและปลูกซ้ำด้วยความหนา 0.6 ML 3 ครั้ง (b) กลบหับแบบบาง และปลูกซ้ำด้วยความหนา 0.6 ML 4 ครั้งแรกและ 1.2 ML ครั้งสุดท้าย43
3.18	Seiko SPA-400 (a) ภาพจริงของเครื่องที่ห้องปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ (b) แผนภาพอย่างง่ายของการทำงานของกล้องจุลทรรศน์เรืองอะตอม.....44
3.19	ระบบวัดไฟโตลูมิเนสเซนส์.....46
4.1	ภาพจากกล้องจุลทรรศน์เรืองอะตอมแสดง InAs ความตันดอตบนแผ่นฐานลายตาราง $In_xGa_{1-x}As$ เมื่อ X มีค่าเป็น (a) 0.08, (b) 0.10, (c) 0.16 และ (d) 0.20 โดยทุกภาพมีขนาด $10 \times 10 \mu\text{m}^2$ ลูกศรแสดงทิศ [1-10] (e) แบบจำลองของภาพตัดขวางโกรงสร้างของชิ้นงาน ในการทดลอง.....49
4.2	ผิวน้ำของ InAs ความตันดอตกลบหับบนแผ่นฐานลายตาราง $In_{0.15}Ga_{0.85}As$ ที่ความหนา ของชิ้นลายตาราง (a) 50 nm (b) 100 nm และ (c) 150 nm วัดจากกล้องจุลทรรศน์เรง อะตอม ทิศทางตามลูกศรคือทิศ [1-10]50
4.3	แบบจำลองของภาพตัดขวางของ InAs ความตันดอตบนแผ่นฐานลายตาราง $In_{0.15}Ga_{0.85}As$ ที่ความหนา (a) 50 nm (b) 100 nm (c) 150 nm51
4.4	(a) ภาพจากกล้องจุลทรรศน์เรืองอะตอมแสดงผิวน้ำขนาด $10 \times 10 \mu\text{m}^2$ โดยลูกศรแสดง ทิศทาง [1-10] และ (b) แบบจำลองภาพตัดขวางโกรงสร้างของชิ้นงาน น0842.....52
4.5	(a) ภาพจากกล้องจุลทรรศน์เรืองอะตอมแสดงผิวน้ำขนาด $2 \times 2 \mu\text{m}^2$ และภาพจาก ใช้ Image thresholding โดยมีระดับ Threshold ที่ (b) 5.5-, (c) 4.9-, (d) 4.0- และ (e) 3.0 nm โดยลีกาวหมายถึงบริเวณที่มีความสูงต่ำกว่า และลีคำหมายถึงบริเวณที่มีความ สูงกว่าค่า Threshold.....53
4.6	ชิ้นงาน น0811 : ชิ้นลายตาราง $In_{0.2}Ga_{0.8}As$ เปล่าๆบนแผ่นฐาน GaAs (a) โกรงสร้างชิ้นงาน (b) ผิวน้ำชิ้นงานที่วัดจากกล้องจุลทรรศน์เรืองอะตอมขนาด $10 \times 10 \mu\text{m}^2$ ทิศทางตามลูกศร (c) Line scan ผิวน้ำขนาดกับทิศ [110] เพื่อวัดความสูง ของเส้นลายตารางทิศ [1-10] (d) Line scan ผิวน้ำขนาดกับทิศ [1-10] เพื่อวัดความสูง เส้นลายตารางทิศ [110].....55
4.7	ภาพจากกล้องจุลทรรศน์เรืองอะตอมแสดงผิวน้ำของชิ้นงาน น0817 ขนาด $10 \times 10 \mu\text{m}^2$ และ (b) $2 \times 2 \mu\text{m}^2$ โดยลูกศรแสดงทิศทาง [1-10].....56
4.8	ภาพจากกล้องจุลทรรศน์เรืองอะตอมแสดง (a) ผิวน้ำชิ้นงาน น0817 กับรูปที่ 4.7 ขนาด $8 \times 5 \mu\text{m}^2$ และ (b), (c) ส่วนขยายขนาด $2.5 \times 2.5 \mu\text{m}^2$ ของบริเวณที่ตีกรอบเส้นประใน

รูปที่

หน้า

- (a) โดย Line scans ในทิศทางขานานกับ [1-10] และ [110] ในรูป (b) และ (c) ลูกแสดง
ในรูป (d) และ (e) ตามลำดับ.....57
- 4.9 สภาพของผิวหน้าของชิ้นงานที่ลดปริมาณ InAs ลงไปเป็นก้อนที่จะก่อตัวเป็นความดัน[†]
ลดจาก 0.8 ML เหลือ 0.72 ML วัดจากกล้องจุลทรรศน์แรงดันที่ (a) $10 \times 10 \mu\text{m}^2$
และ (b) $2 \times 2 \mu\text{m}^2$ ลูกแสดงทิศ [1-10].....58
- 4.10 ภาพจากกล้องจุลทรรศน์แรงดันขนาด $3 \times 3 \mu\text{m}^2$ ของชิ้นงาน 27n
(InAs ความดันลดที่ความหนา ต่ำกว่า 0.8 ML บน $\text{In}_{0.13}\text{Ga}_{0.87}\text{As}$ หนา 50 nm)
และภาพแสดงวิวัฒนาการการเกิดความดันลดที่จุดของตัดลายตาราง จากทั้ง 6 จุดที่ทำ
เครื่องหมายไว้.....59
- 4.11 ผิวหน้าชิ้นงาน n0840 ที่ตัดแน่นต่างๆ กันแสดงถึง InAs ความดันลด
บนชั้นลายตารางที่ปริมาณ InAs ต่างๆ กัน ลูกแสดงทิศ [1-10] ภาพจากกล้อง
จุลทรรศน์แรงดันแบบเป็นภาพขนาด $10 \times 10 \mu\text{m}^2$ และแคลบล่างมีขนาด $2 \times 2 \mu\text{m}^2$
เป็นส่วนขยายจากบริเวณที่ตัดรอบในภาพบน.....62
- 4.12 ภาพแสดงแบบจำลองของการกระจายตัวของความเครียดบนผิวหน้าสองมิติของ
ชั้นลายตาราง (a) ของแนว [110] (b) ของแนว [1-10] และ (c) ของจุดตัดของทั้งสองแนว
(d) ภาพจากกล้องจุลทรรศน์ขนาด $1 \times 1 \mu\text{m}^2$ และแสดงผิวหน้าและเส้นประหนายถึงบริเวณที่
แบบจำลองเป็นสีเข้มที่สุด.....63
- 4.13 (a) ภาพจากกล้องจุลทรรศน์แรงดันขนาด $2 \times 2 \mu\text{m}^2$ และแสดงผิวหน้าชิ้นงาน n0702
(b) การกระจายตัวของความเค้นอัดที่ผิวหน้าฟิล์มจาก Surface step แต่ละเส้นของ
n0702 ทับซ้อนกัน ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับที่ใช้ในรูปที่ 4.12 โดยสีอ่อนหมายถึง
ความเค้นอัดต่ำ สีเข้มหมายถึงความเค้นอัดสูง (c) นำ b ไปซ้อนทับบน a และแสดงถึง
โอกาสที่แต่ละบริเวณจะมีการก่อตัวของความดันลด.....64
- 4.14 (a) ภาพตัดขวางของโครงสร้างความดันลดโดยเลกูลผลและผลการเปลี่ยนเส้นที่วัด
ได้จากชิ้นงานจริง (เส้นทึบ) และผลจากการใช้เครื่องมือเพื่อจำแนกออกเป็น
Gaussian functions (เส้นประ) ของชิ้นงานที่มีการกลับทันแบบบาง (a) 15 และ
(b) 25 ML รูปเล็กที่แทรกอยู่แสดงถึงโครงสร้างที่สามารถอธิบาย
ผลการเปลี่ยนเส้นที่แสดงไว้ได้.....67

บทที่ 1

บทนำ

สิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ (Semiconductor devices) ได้มีการนำมาใช้อย่างแพร่หลายและ
ยาวนาน จนถึงปัจจุบันสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำเกี้ยงคงมีการพัฒนามาตลอด ทั้งด้านเทคนิคการ
ปลูกผลิต (Epitaxial growth) และการพัฒนาโครงสร้าง (Structure) ของสิ่งประดิษฐ์ อันเนื่องมาจาก
การศึกษาลักษณะเฉพาะตัว (Characterization) ของสารกึ่งตัวนำแบบสารบริสุทธิ์ และสารกึ่งตัวนำ
ผสม (Compound semiconductor) ตลอดมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน สิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำนี้ไม่ได้
ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในเฉพาะด้านคุณสมบัติทางไฟฟ้าเท่านั้น แต่ยังถูกใช้ทางด้านแสงอีกด้วย
ทั้งความสามารถในการตรวจจับแสง และความสามารถในการเปล่งแสงของสิ่งประดิษฐ์ เช่น ตัว
ตรวจจับแสง (Photodetector) หลอดไอดีโอดเปล่งแสง (LED, Light Emitting Diode) เลเซอร์
(LASER) เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell) ซึ่งสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำที่กล่าวมานี้สามารถพบเห็นได้
ทั่วไปจากชีวิตประจำวัน ดังนั้นการศึกษาลักษณะเฉพาะตัวของสารกึ่งตัวนำ เทคนิคการปลูก
โครงสร้างสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ จึงไม่ใช่เรื่องไกลตัว และยังน่าสนใจต่อการค้นคว้าวิจัย
เพราะว่าขั้นสามารถคิดค้นเทคนิค หรือการประยุกต์ใช้ใหม่ๆได้ เพื่อสร้างโครงสร้างขนาดเล็ก
รูปแบบต่างๆ เช่น ความตื้นเมล็ด (Quantum well) ความตั้มดอต (Quantum dot) ชูบเปอร์แลตทิซ
(Super lattice) ความตั้มring (Quantum ring) ความตั้มดอตโมเลกุล (Quantum dot molecule) และ^{1,2,3,4,5]}
ความตั้มดอตบนลายตาราง (Cross-hatch quantum dots)

การปลูกผลิตของสารกึ่งตัวนำสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การปลูกผลิตด้วยวิธีการเกิดผลิต
จากสถานะของเหลว (LPE, Liquid Phase Epitaxy) การปลูกผลิตแบบการแกําตัวด้วยไอเคมี (CVD,
Chemical Vapor Deposition) สำหรับหนึ่งในวิธีที่มีความละเอียดสูงสุดในการสร้างผลึกสารกึ่ง
ตัวนำ คือวิธีการปลูกผลิตด้วยเครื่องปลูกผลิตแบบลำไบโมเลกุล (MBE, Molecular Beam Epitaxy)
เพราะว่าสามารถควบคุมการเกิดขึ้นได้ในระดับหน่วยของ ชั้นอะตอมต่อวินาที (ML/s, Monolayer
per second) และยังสามารถใช้เทคนิคการปลูกผลิตได้หลายแบบ จากการควบคุมการเปิด-ปิดชัตต์
เตอร์ (Shutter) ของเตาละห้องสาร (Effusion Cell) เพื่อควบคุมการผสมสาร และอัตราส่วนของสาร
ผสม (Compound) จากการควบคุมอุณหภูมิของเตา (Crucible) ของเตาละห้อง ด้วยความละเอียดที่
สูงในระดับนี้ ทำให้สามารถปลูกชั้น Heterostructure ได้ด้วยความหนาที่น้อยในระดับนาโนเมตร

(Nanometer) ถึงอังสตروم (Angstrom, Å) เพื่อให้เกิดเป็นโครงสร้างความตั้มเวลล์ ซึ่งมีระดับความอิสระสองมิติ [6] สามารถใช้กักประจุพาหะ (Charged carrier) ไว้ได้ และยังนิยมนำมาใช้เป็นโครงสร้างของหลอดไดโอดเปล่งแสง [7,8] เพราะว่าสามารถใช้เป็นแหล่งรวมตัวแบบเปล่งแสงของประจุพาหะ (Radiative recombination center) [6] ได้อีกด้วย มีประโยชน์ใช้ประยุกต์ได้มาก many และถ้าสารที่ใช้มีค่าคงที่ผลึก (Lattice constant) ต่างกันมากถึงค่าหนึ่ง ประกอบกับความหนาชั้นผลึกถึงค่าความหนานิวเคลียร์ (Critical thickness) จะทำให้เกิดเป็นโครงสร้างสามมิติขนาดเล็กที่สามารถกักประจุพาหะไว้ได้ เช่นกัน แต่เป็นที่ระดับความอิสระเป็นศูนย์ และมีระดับพลังงานเป็นชั้นๆแบบไม่ต่อเนื่องดังเป็นอะตอมเทียม (Artificial atom) นั่นคือ โครงสร้างความตั้มดอต [1]

โครงสร้างความตั้มดอตเป็นโครงสร้างสามมิติซึ่งเกิดจากการคลายความเครียดของการเกาะกันของสารที่มีความไม่พอดีกันของค่าคงที่ผลึกและมีความหนานากพอ โครงสร้างความตั้มดอตนี้มีปัจจัยที่ส่งผลถึงลักษณะสมบัติทางไฟฟ้าและทางแสงหลายปัจจัยได้แก่ ขนาดและรูปร่างของความตั้มดอต และส่วนประกอบของสารภายในโครงสร้างความตั้มดอต ขนาดที่แตกต่างกันของความตั้มดอตจะส่งผลถึงค่าระดับพลังงานภายในของความตั้มดอต [1] โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสมบัติทางแสงของความตั้มดอต ขนาดของความตั้มดอตที่แตกต่างกันนี้จะให้ผลตอบสนองทางแสงที่แตกต่างกัน ทั้งนี้นอกจากคุณสมบัติของความตั้มดอตแต่ละดอตแล้ว การเรียงตัวของกลุ่มของความตั้มดอตก็ยังได้มีการศึกษาด้วยว่าให้ผลต่อข้าม (Polarization) ของผลการเปล่งแสงของชิ้นงานที่มีกลุ่มของความตั้มดอตอีกด้วย [9]

แผ่นฐานตั้งต้น (Substrate) ที่ใช้ในการทดลองทั้งหมดสำหรับงานในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นแผ่นฐานตั้งต้น GaAs (Gallium arsenide) ระนาบ (Plane) 100 ซึ่งเขียนตามข้อกำหนดของ Miller indices เป็นรูปแบบมาตรฐานคือ (100) โดยโครงสร้างทุกโครงสร้างที่ปัลอกภายในตัว วิทยานิพนธ์นี้เป็นการปัลอกบนแผ่นฐานตั้งต้นชนิดนี้โดยตรง รวมทั้งแผ่นฐานลายตารางที่ศึกษาก็ต้องทำการปัลอกบนแผ่นฐาน (100)-GaAs นี้ด้วยเช่นกัน

แผ่นฐานลายตาราง (Cross-hatched substrate) เป็นหนึ่งในแผ่นฐานที่สามารถปัลอกความตั้มดอตทับด้านบนได้ และยังส่งผลต่อการประกอบตัวเอง (Self assembly) [3] ของกลุ่มของความตั้มดอตที่ปัลอกลงไป รวมทั้งทำให้แน่นการเกิดก้อนและหลังของความตั้มดอตเมื่อทำการปัลอกชั้นของความตั้มดอตไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง แผ่นฐานลายตารางที่ใช้เกิดจากการปัลอกผลึกแบบสอง

มิติของสารประกอบ InGaAs [10] แต่ชั้นของแผ่นฐานลายตารางจะแตกต่างจากการปั๊กผลึกแบบสองมิติทั่วไปคือ ภายในแผ่นฐานลายตารางจะมีจุดที่เกิดความผิดปกติทางตำแหน่งของอะตอมที่เกากัน (Dislocations) และความผิดปกตินี้ก็ยังส่งผลต่อเนื่องไปสู่ผิวน้ำของชั้นแผ่นฐานนี้อีกด้วย โดยทำมุม 60° จากแนวระนาบก่อให้เกิดความผิดปกติของโครงสร้างแบบ เรียกว่า Threaded dislocations และ Misfit dislocation [11,12,13,14]

เอกสารนี้ของแผ่นฐานชนิดนี้คือเป็นเส้นสองแนวไขว้กันเป็นลายตารางทั่วทั้งผิวน้ำ ทั้งนี้เส้นลายตารางดังกล่าวสามารถปรับแต่งความสูง ความหนาแน่นของจำนวนเส้น ได้จากปัจจัยหลายอย่างในระหว่างการปั๊ก เช่น ความหนาของชั้นแผ่นฐาน [15] และอัตราส่วนของส่วนประกอบของสารภายในชั้นแผ่นฐานลายตาราง [3] เป็นต้น

วิัฒนาการการเกิดอินเดียมอาร์เซไนด์ความตั้มดอตบนแผ่นฐานลายตาราง เริ่มจาก การศึกษาลักษณะการเกิดความตั้มดอตบนแผ่นฐานลายตาราง โดยศึกษาทั้งขนาดของความตั้มดอตบนลายตารางเทียบกับความตั้มดอตบนแผ่นฐานแกแลลิเมอร์เซไนด์ธรรมชาติ ซึ่งด้วยเงื่อนไข ความหนาวิกฤติที่แตกต่างกัน รวมทั้งแผ่นฐานสำหรับปั๊กความตั้มดอตต่างกัน ผลที่ออกมานี้มีลักษณะของความตั้มดอต การเรียงตัวของกลุ่มของความตั้มดอตที่แตกต่างกัน และวิธีการเรียงตัวของกลุ่มของความตั้มดอตทั้งสองแบบ รวมทั้งเวลาของการเกิดความตั้มดอตที่ตำแหน่งต่างๆ กันไม่พร้อมกัน ทั้งที่อยู่ภายใต้สภาวะลำไมเลกูลของสารตัวยิ่งเงื่อนไขเดียวกัน [16]

ผลการศึกษาจากงานภายในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ทำให้พบว่าความตั้มดอตบนลายตารางสามารถแบ่งได้ออกเป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เกิดตรง Threading dislocation กลุ่มที่เกิดตรงจุดของเส้นไขว้ของลายตาราง กลุ่มที่เกิดบนเส้นแนวที่นานกับทิศ [1-10] กลุ่มที่เกิดบนแนวเส้นที่นานกับทิศ [110] และกลุ่มที่เกิดบนบริเวณที่ไม่มีแนวเส้น โดยทั้ง 5 กลุ่มนี้จะแตกต่างกันทั้งขนาดและเวลา การก่อตัวเป็นความตั้มดอต ดังนั้นจึงสามารถควบคุมการเกิดกลุ่มของความตั้มดอตบนลายตาราง ได้ด้วยการหยุดเวลาการปั๊กของชั้นอินเดียมอาร์เซไนด์ความตั้มดอตที่เหมาะสมกับเงื่อนไขที่ต้องการให้เกิดความตั้มดอตในบริเวณที่ต้องการ อย่างไรก็ตาม การปรับผิวน้ำของลายตาราง สำหรับปั๊กความตั้มดอตทั้งนี้ มีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะของความตั้มดอต และ การเรียงตัวของกลุ่มของความตั้มดอตบนลายตารางด้วย ดังนั้นวิธีการปรับแต่งแผ่นฐานให้

เหมาะสมกับเงื่อนไขการปลูกความตั้มดอตที่เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเข่นกันกับปัจจัยอื่นๆของการปลูกความตั้มดอตด้วย

ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิัฒนาการการเกิดความตั้มดอตบนลายตารางนี้คือการที่จะสามารถกำหนดให้เกิดความตั้มดอตบนลายตารางแค่บางตำแหน่งเท่านั้น อันเนื่องมาจากเหตุผลที่กล่าวไปแล้ว และด้วยการที่สามารถควบคุมบริเวณที่ต้องการให้เกิดการก่อตัวของความตั้มดอตได้รวมทั้งขนาดและการเรียงตัวของกลุ่มของความตั้มดอตทำให้สามารถควบคุมผลการเปล่งแสงของสิ่งประดิษฐ์ที่มีโครงสร้างความตั้มดอตบนลายตารางได้ การปรับแต่งขนาดของความตั้มดอตและการเรียงตัวของกลุ่มของความตั้มดอต ก็จะส่งผลไปถึงความยาวคลื่นแสงที่จะเปล่งออกมากได้และรูปแบบของข้อของแสงที่เปล่งออกมา ซึ่งการที่เราสามารถปรับแต่งการตอบสนองทางแสงของสิ่งประดิษฐ์ที่มีโครงสร้างความตั้มดอตได้ อีกหนึ่งในการใช้ข้อได้เปรียบของโครงสร้างความตั้มดอตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาในบทต่อไปของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ประกอบไปด้วย บทที่ 2 ทฤษฎีและความรู้พื้นฐาน บทที่ 3 การปลูกโครงสร้างและการวัดลักษณะสมบัติ ซึ่งจะอธิบายรายละเอียดในการปลูกโครงสร้างด้วยเทคนิค MBE (Molecular Beam Epitaxy) รวมทั้งระบบวัดลักษณะสมบัติและระบบตรวจวัดนะปลูกโครงสร้างทั้งแบบติดตั้งภายในและภายนอกเครื่องปลูกผลึก บทที่ 4 ผลการทดลองและการวิเคราะห์ ซึ่งจะกล่าวถึงวิัฒนาการการเกิดความตั้มดอตบนลายตารางและความสำคัญของข้อมูลดังกล่าว ท้ายสุดเป็นการสรุปในบทที่ 5

สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทที่ 2

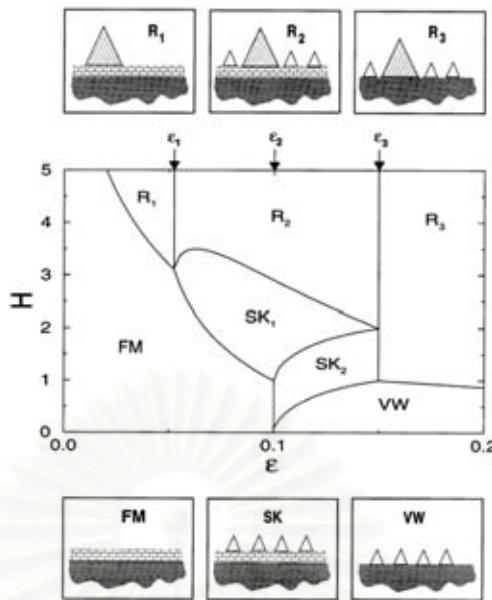
ทฤษฎีและความรู้พื้นฐาน

เนื้อหาในบทนี้ครอบคลุมถึงทฤษฎีและความรู้พื้นฐานที่จะใช้อ้างอิงในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงวิัฒนาการของการเกิดความตั้งตัวของสารในดีไซน์บล็อกนั้นๆ ลายตาราง ประกอบด้วย 4 หัวข้อได้แก่ เอเทอโรเอพิตาคซี (Heteroepitaxy), ความไม่พอดีกันของค่าคงที่ผลึก, ความตั้งตัว และ แผ่นฐานลายตารางอินเดียมแกลเลียมอาร์เซไนด์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

2.1 เอเทอโรเอพิตาคซี (Heteroepitaxy)

เทคนิคการปูกลayer เดียวชั้นดีฟิล์มบาง (Thin film epitaxy) สามารถให้ชั้นผลึกเดียวที่หนาในระดับนาโนเมตร (Nanometer) ถึงไมโครเมตร (Micrometer, micron) ได้เนื่องจากฟิล์มบางนั้นมีการประยุกต์ใช้ได้หลายด้าน โดยเฉพาะด้านของสิ่งประดิษฐ์ทางอิเล็กทรอนิกส์จำพวกสารกึ่งตัวนำ [17] ดังนั้นกระบวนการการเกิดชั้นผลึกแบบฟิล์มบางจึงมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมการผลิตสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำอย่างมาก

การปูกลayer ด้วยเครื่องปูกลayerแบบลำโมเลกุล (MBE) สามารถสร้างชั้นผลึกแบบฟิล์มบางที่สามารถควบคุมความหนาได้อย่างแม่นยำในระดับชั้นอะตอม และสามารถควบคุมความบริสุทธิ์ของเนื้อสารให้เข้าใกล้ความเป็นอุดมคติ เนื่องจากกระบวนการปูกลayerเกิดภายใต้ภาวะสุญญากาศ ซึ่งมีความดันต่ำในระดับ 10^{-9} ถึง 10^{-12} Torr และมีระบบสร้างสุญญากาศที่ทำงานอย่างต่อเนื่องตลอดกระบวนการ เครื่องปูกลayerแบบลำโมเลกุลอาศัยหลักการการปล่อยไอโมเลกุลออกไปเป็นลำ ยิงไปที่ชั้นงาน เพื่อให้ลำโมเลกุลแตก (Dissociate) ถ่ายเทพลังงานภายใน และไปเกาะตัว (Deposit) อยู่ที่ผิวน้ำของชั้นงาน ล่างผลให้เกิดการปูกลayer (Growth) ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งลูกกำหนดโดยหมายปัจจัย โดยเฉพาะความไม่พอดีกันของค่าคงที่ผลึก ค่าความเครียด (Strain: ϵ) และความหนา (Thickness: H) ดังแสดงในรูปที่ 2.1



รูปที่ 2.1 แผนภาพเฟสสมดุล (Equilibrium phase diagram) ในรูปของฟังก์ชันระหว่าง H กับ ϵ โดยภาพประกอบด้านบนและล่างแสดงถึงลักษณะของผิวน้ำของโภมดต่างๆทั้ง 6 โภมด สามเหลี่ยมเล็กสีขาวแทนโครงสร้างเก้าสามมิติที่มีเสถียรภาพ สามเหลี่ยมใหญ่รูปสามเหลี่ยมในแทนโครงสร้างเก้าสามมิติที่โตเต็มที่ (Ripening island) เฟสแต่ละรูปแบบลูกแบ่งด้วยเส้นขอบเขต $H_c(\epsilon)$: FM- R_1 , FM-SK₁; $H_c_1(\epsilon)$: SK₁-R₂; $H_c_2(\epsilon)$: SK₂-SK₁; $H_c_3(\epsilon)$: VW-SK₂, VW-R₃ [18]

รูปแบบการปลูกผลึกซึ่งขึ้นกับ ϵ และ H ดัง รูปที่ 2.1 มีอย่างต่ำ 3 โภมด ประกอบไปด้วยโภมดการเกิดซึ่ง Frank-van der Merwe, FM โภมดการเกิดซึ่ง Wetting layer ผสมความตั้มดอตซึ่งเรียกว่า สารานสกี-คราสตานอฟ (Stranski-Krastanov, SK) และโภมดการเกิดความตั้มดอตอย่างเดียว ที่เรียกว่า โวลเมอร์-วีเบอร์ (Volmer-Weber, VW) โดยตัวแปรหลักในการกำหนดว่าการปลูกผลึกจะเกิดขึ้นในโภมดใดได้แก่ ความหนาของชั้นฟิล์ม (H) และความเครียดจากความไม่พอดีกันของค่าคงที่ผลึก (Misfit strain: ϵ)

$$\epsilon = \frac{a_f - a_s}{a_s} \quad (2.1)$$

เมื่อ a_f คือค่าคงที่ผลึกของฟิล์มบางในสภาพสมดุล และ a_s คือค่าคงที่ผลึกของแผ่นฐาน (Substrate) ดังนั้นยิ่งค่าคงที่ผลึกของสารทึ้งสองชนิดต่างกันมาก ($a_f - a_s$ มีค่าสูง) ความเครียด (ϵ) ก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย ค่าความเครียด (ϵ) และความหนาของฟิล์มที่ลูกปลูก (H) จะเป็นตัวกำหนดโภมดในการปลูกในรูปที่ 2.1 ดังนี้ [18]

1. Frank-van de Merwe (FM, 2D growth mode) เป็นโภมดของการเกิดชั้นผลึกเดี่ยวแบบสองมิติสมบูรณ์แบบ เกิดจากการรักษาให้สถานะของปลูกชั้นผลึกอยู่ในส่วน FM ในแผนภาพเฟส สามคุณโดยมีค่าความไม่พอดีกันของค่าคงที่ผลึกน้อย ($\epsilon < 0.1$) และความหนาต้องไม่เกินขอบเขตของแผนภาพในบริเวณของ FM มิฉะนั้นชั้นผลึกจะก่อตัวในโภมด SK₁, R₁ หรือ R₂ แทน ดังจะกล่าวรายละเอียดในลำดับต่อไป

2. Stranski-Krastanov (SK, 2D + 3D growth mode) เป็นโภมดของการเกิดชั้นผลึกแบบสองมิติผสมกับสามมิติ เกิดจากการที่ค่าความเครียดจากความไม่พอดีกันของค่าคงที่ผลึกของสารที่มาเกาะตัวกับสารตั้งต้นมีค่าอยู่ในช่วงประมาณ $0.05 < \epsilon < 0.15$ ทำให้ชั้นผลึกชั้นแรกๆสามารถเกาะตัวแบบสองมิติได้ โดยจะมีความเครียดสะสมอยู่ในชั้นฟิล์มกระทั่งการปลูกดำเนินต่อไปถึงค่าความหนาวิกฤต (Critical thickness: H_c) ชั้นผลึกสองมิติ (Wetting layer) ที่สะสมความเครียดไว้ก็จะคลายความเครียดเพื่อลดพลังงานรวมของระบบ เกิดเป็นโครงสร้างสามมิติหรือความตั้มดอต (QD) ขึ้นมา อย่างไรก็ตามยังมีบางส่วนที่ยังคงสามารถเกาะกันแบบสองมิติได้ โดยยังคงมีความเครียดสะสมอยู่ส่วนหนึ่ง เรียกว่า Wetting layer

การเกิด Wetting layer และ QD ในโภมด SK มีสองรูปแบบคือ SK₁ และ SK₂ ซึ่งมีผลสุดท้ายที่ได้ไม่ต่างกัน แต่มีลำดับการเกิดต่างกันตามความหนาชั้นผลึกที่เพิ่มขึ้น ในกรณีของโภมด SK₁ มีการเกิดเป็นชั้นผลึกสองมิติก่อน เมื่อความหนาเพิ่มขึ้น ชั้นผลึกสองมิติคลายตัวเป็นรูปแบบสามมิติผสมสองมิติ แต่ในกรณีของโภมด SK₂ นั้นมีการเกิดรูปแบบสามมิติก่อน เมื่อความหนาชั้นผลึกเพิ่มมากขึ้น ก็จะมี Wetting layer ไปก่อตัว ณ บริเวณที่ไม่มีการก่อตัวแบบสามมิติในตอนแรก ทำให้ผลสุดท้าย SK ทั้งสองโภมดให้ผิวน้ำที่มีคุณสมบัติเหมือนกัน คือเป็นรูปแบบการผสมของโครงสร้างสองมิติและสามมิติ อย่างไรก็ตามโภมด SK₂ แท้จริงแล้วคือการเกิดโครงสร้างสามมิติในโภมด VW ก่อน แต่ด้วยความเครียดที่ไม่สูงเกินไป ทำให้มีชั้น Wetting layer เกิดขึ้นได้ภายหลังเมื่อเพิ่มความหนา กลاวยจากโภมด VW เป็นโภมด SK₂

3. Volmer-Weber (VW, 3D growth mode หรือ Island growth mode) เป็นโภมดการเกิดชั้นผลึกแบบสามมิติซึ่งเกิดขึ้นทันทีที่เริ่มทำการปลูกชั้นผลึก เนื่องจากค่า ϵ ที่สูง ($\epsilon > 0.1$) ผลึกของสารที่มาเกาะตัวบนสารตั้งต้นมีความเครียดสูงกว่าแบบ SK ผลึกจึงต้องก่อตัวเป็นรูปแบบเกาะสามมิติเพื่อคลายความเครียดทันที

นอกจากโหมดการเกิดขั้นผลึกหลักสามโหมดข้างต้นแล้ว ยังมีโหมดรองซึ่งเป็นโหมดที่มีโครงสร้างสามมิติโตเต็มที่ (Ripening island) อีก 3 โหมดได้แก่

R_1 (2D + 3D growth mode) เมื่อ $\epsilon < \epsilon_1$ และ $H > 3$ ML โดยประมาณ เป็นโหมดการเกิดขั้นผลึกที่เกิดขึ้นได้เมื่อมีการเพิ่มความหนาขั้นผลึกไปมากกว่าค่าความหนาวิกฤติสำหรับความเครียดค่าหนึ่งๆ ($H_c(\epsilon)$) จากขั้นผลึกแบบ FM ซึ่งลักษณะผิวน้ำคือจะมีการก่อตัวแบบสามมิติที่โตเต็มที่ (Ripening island) และมี Wetting layer อยู่ด้านล่าง

R_2 (2D + 3D growth mode) เมื่อ $\epsilon_1 < \epsilon < \epsilon_3$ และ $H > 2-3$ ML โดยประมาณ เป็นโหมดการเกิด Wetting layer, เกาสามมิติ และ เกาสามมิติที่โตเต็มที่ ซึ่งรูปแบบการเกิดนี้เกิดจากการปลูก SK₁ โดยเพิ่มความหนาไปเกินจุดแบ่ง SK₁-R₂ ในรูปที่ 2.1

R_3 (3D growth mode) เมื่อ $\epsilon > \epsilon_3$ และ $H > 1$ ML โดยประมาณ โหมดการเกิดขั้นผลึกที่เพิ่มความหนามากจาก VW จนความหนาเกินกว่าจุดแบ่ง VW-R₃ ในรูปที่ 2.1 เป็นผลให้เกิดเกาสามมิติแบบปกติ และ เกาสามมิติแบบที่โตเต็มที่ โดยไม่มี Wetting layer

สรุปได้ว่ารูปแบบการเกิดขั้นผลึกแบบต่างๆ มีปัจจัยสำคัญอยู่สองอย่างคือ 1) ความต่างของค่าคงที่ผลึกระหว่างสารที่ทำการปลูกกับสารที่เป็นแผ่นฐานตั้งต้น และ 2) ความหนาขั้นผลึกที่ทำการปลูก เนื่องจากสารแต่ละชนิดมีคุณสมบัติเฉพาะ (Characteristic) ที่แตกต่างกัน เช่นค่าคงที่ผลึกเป็นต้น เป็นสาเหตุให้เกิดการเกาะตัวกันเป็นขั้นผลึกแบบต่างๆ แต่สารบางชนิดอาจจะมีค่าคงที่ผลึกที่เข้ากันได้แม้ว่าจะเป็นคนละชนิดกัน เช่น GaAs และ AlGaAs [19] เนื่องมาจากค่าคงที่ผลึกมีค่าใกล้เคียงกันมากจนประมาณได้ว่ามีค่าคงที่ผลึกเท่ากัน ทำให้สามารถปลูกขั้นผลึกขึ้นแบบสองมิติแบบ Heterostructure ได้โดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงผลึก

สำหรับความอนดัมดอยตั้งหนวดภายในได้การทดลองในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะถูกปลูกในโหมด SK₁ เนื่องจากเป็นการปลูก InAs บน GaAs ($\epsilon \sim 0.07$) หรือบน In_{0.15}Ga_{0.85}As ($\epsilon \sim 0.06$) โดยมีความหนา $H \sim 1.8$ ML และ $H > 0.8$ ML ในการปลูกบน GaAs และปลูกบน In_{0.15}Ga_{0.85}As ตามลำดับเนื้อหาในส่วนต่อไปเป็นการอธิบายเรื่องความไม่พอดีกันของค่าคงที่ผลึกซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อ ϵ และ โหมดในการปลูกผลึก

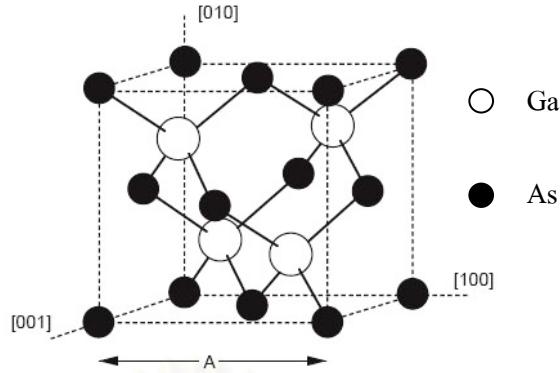
2.2 ความไม่พอดีกันของค่าคงที่ผลึก (Lattice mismatch)

ค่าคงที่ผลึก (Lattice constant : a) คือค่าความกว้างของ Unit cell ของผลึก วัดจาก ศูนย์กลางอะตอมริมสุดด้านหนึ่งของ Unit cell ไปถึงศูนย์กลางอะตอมริมสุดอีกด้านของ Unit cell ดังแสดงเป็นระยะ ‘ A ’ ในรูปที่ 2.2 ค่าคงที่ผลึกจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของสารที่ประกอบกันเป็นโครงผลึก โดยที่ชนิดของสารเป็นตัวกำหนดลักษณะสมบัติที่มีผลต่อค่าคงที่ผลึก เช่น แรงดึงดูดและระหว่างอะตอม พันธะระหว่างอะตอม ทำให้สารประกอบหรือชาตุแต่ละชนิดมี ค่าคงที่ผลึกแตกต่างกันออกไป เช่น InAs และ GaAs มีค่าคงที่ผลึกที่ 6.0583 และ 5.6533 Å [10] และก็อาจจะมีบางชนิดที่มีค่าคงที่ผลึกที่ใกล้เคียงกันมาก จนถือได้ว่าค่าคงที่ผลึกทั้งสองเข้ากันได้ (Lattice match) เช่น GaAs และ AlGaAs

ตารางที่ 2.1 คุณสมบัติทางกายภาพของ InAs, GaAs และ InGaAs [10]

Material	Bandgap (eV) (at 300 Kelvin)	Lattice constant (Å)
GaAs	1.424 / Direct band-gap	5.6533
InAs	0.354 / Direct band-gap	6.0584
$In_xGa_{1-x}As$	$0.324 + 0.7(1-X) + 0.4(1-X)^2$ / Direct band-gap	$5.6533 + 0.405(X)$

สารกึ่งตัวนำที่ทำการทดลองภายใต้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้แก่ InAs, GaAs และ $In_xGa_{1-x}As$ ($X \leq 20\%$) ซึ่งมีคุณสมบัติทางกายภาพโดยสรุปดังตารางที่ 2.1 ในกรณีของ $In_xGa_{1-x}As$ ค่าคงที่ผลึก จะเปลี่ยนไปตามค่า X นั้นหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วน In ต่อ Ga ใน $In_xGa_{1-x}As$ จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพของ $In_xGa_{1-x}As$ ทั้งค่านี้แบบช่องว่างพลังงานและ ค่าคงที่ผลึก ซึ่งค่าคงที่ผลึกที่เปลี่ยนไปมีความสำคัญต่อการดำเนินการปัจจุบัน เพราะว่าจะส่งผลให้ ϵ เปลี่ยนแปลงไปและจะทำให้เกิดการผ่อนคลายความเครียด, Dislocations และ Surface steps ดัง รายละเอียดต่อไปนี้

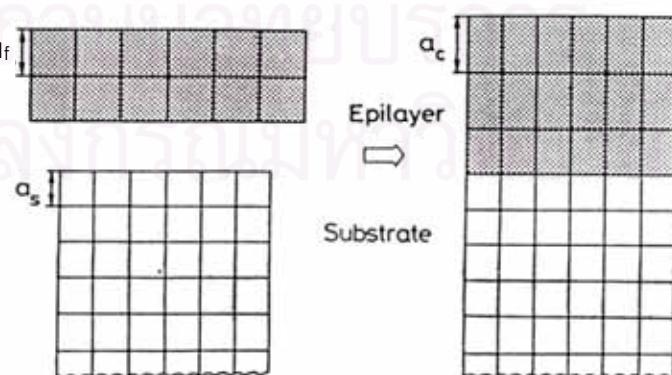


รูปที่ 2.2 Unit cell และขอบเขตของค่าคงที่ผลึกของ GaAs [20]

2.2.1 ความเครียดและการผ่อนคลายความเครียด

การปลูก InAs ลงบน GaAs โดยตรงหรือบน $In_xGa_{1-x}As$ ($X \leq 0.2$) گีตาม ส่งผลให้เกิดการก่อตัวแบบสามมิติ โครงสร้างสามมิติดังกล่าวมีขนาดที่เล็กในระดับ 20-40 nm และสูงในระดับ 3-5 mn [1] และถูกเรียกในวงกว้างว่าคาวอนตัมดอต (Quantum dot, QD) ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากความเครียดและการผ่อนคลายความเครียด

ความไม่เข้ากันของค่าคงที่ผลึกเป็นผลให้ชั้นผลึกด้านบน (Overlayer) ที่ก่อตัวขึ้นต้องก่อตัวแบบบีบอัด (Compressive: $a_f > a_s$) หรือแบบขยายตัว (Tensile: $a_f < a_s$) เนื่องจากในชั้นแรกๆ ของการก่อตัว Overlayer จะถูกบังคับให้ก่อตัวอย่างเป็นระเบียบด้วยค่าคงที่ผลึกแนวราวนาน (a_{\parallel}) ที่เท่ากับค่าของแผ่นฐานที่ถูกปลูกทับบนที่ค่าคงที่ผลึกแนวตั้งจากกับผิวน้ำ (a_{\perp}) มีการยืดตัวดังแสดงในรูปที่ 2.3 [21] โดยสภาพผิวน้ำดังกล่าวจัดได้ว่ามีความเครียด (ε) ถูกสะสมอยู่ภายในผลึก

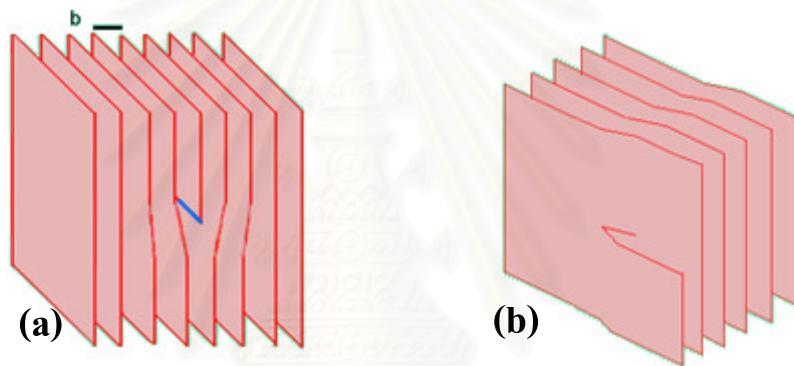


รูปที่ 2.3 การเกิดชั้นผลึกของคุ่สารที่ไม่เข้ากันแบบอัดตัว (Compressive) [21]

2.2.2 Dislocations

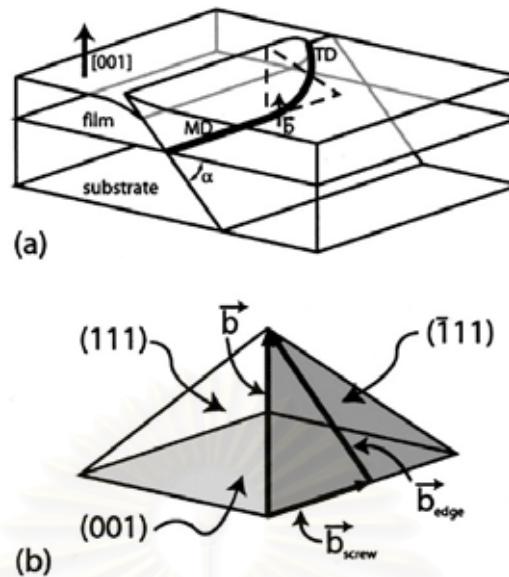
การปะ聚กชั้นผลึกที่มีความกว้างพอๆ กับระหัสความหนาชั้นผลึกดังกล่าวสูงเกินกว่าค่าความหนาวิกฤติ (Critical thickness, h_c) ผลึกจะเริ่มเกิดจุดที่อะตอมเกาะกันอย่างผิดปกติเป็นจุดบกพร่อง (Defect) เพื่อคลายความเครียดลง (Strain relaxation)

จุดบกพร่องที่สำคัญมีลักษณะแบบได้แก่จุดบกพร่องแบบจุด (Point defect) จุดบกพร่องแบบเส้น (Line defect) จุดบกพร่องแบบระนาบ (Planar defect) และจุดบกพร่องแบบปริมาตร (Volume defect) ซึ่งจุดบกพร่องแบบเส้นก็คือ Dislocation ซึ่งยังจำแนกออกเป็นสองชนิดคือ Edge dislocation และ Screw dislocation ดังแสดงในรูปที่ 2.4



รูปที่ 2.4 รูปแบบของ dislocation แบบ (a) Edge dislocation โดย b คือ Bergers vector เส้นที่เกิดจากการแยกของชั้นคือ dislocation line และ (b) Screw dislocation

โดยทั่วไปแล้ว Dislocation ในผลึกจริงจะเป็นการผสมกันระหว่าง Dislocation ทั้งสองแบบ [13] และสามารถระบุได้ด้วยสองสิ่งคือ Bergers vector และ Dislocation line สำหรับ Edge dislocation นั้นแนวของ Bergers vector ต้องหากันกับแนวของ Dislocation line ส่วน Screw dislocation จะกลับกันคือแนวทั้งสองจะขนานกันแทน

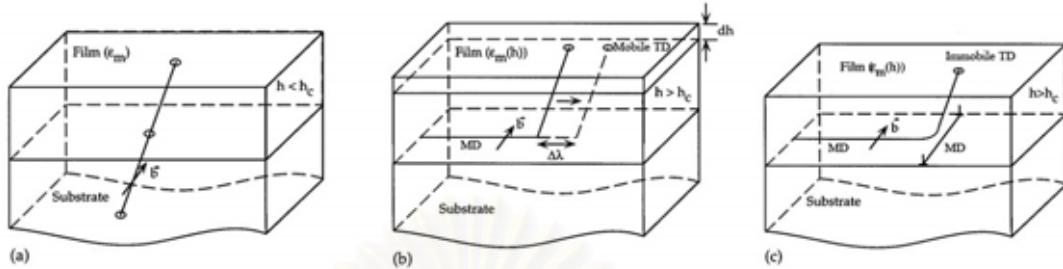


รูปที่ 2.5 Dislocation ของฟิล์มที่ปูลูกบนแผ่นฐานแบบมีความไม่เข้ากันของค่าคงที่ผลึก (a) Slip plane ของ (001)-Face Center Cubic (FCC) แสดง Misfit dislocation และ Threading dislocation ที่เกิดขึ้น (b) Bergers vector ของ Slip plane ดังกล่าว แยกย่อยเป็น Edge-, Screw Bergers vector [13]

Dislocation เป็นผลจากกระบวนการในการคลายความเครียดของชั้นผลึกที่มีความเครียดสะสมจนถึงค่าวิกฤติ แบ่งออกเป็น Misfit dislocation (MD) และ Threading dislocation (TD) ดังแสดงในรูปที่ 2.5 MD เป็น Dislocation ที่มีลักษณะเป็นเส้นยาวเกิดจากการขับกันแบบเหลื่อมของอะตอมอย่างเป็นระเบียบ จุดที่เกิดการเคลื่อนย้ายของอะตอมจะถูกเรียกว่า Defect แต่ส่วนที่ไม่เคลื่อนย้ายจะถูกเรียกว่า Defects รูปที่ 2.5 (a) แสดงให้เห็นว่าการเกิด Dislocation (MD และ TD) ทำให้เกิดระนาบเลื่อนขึ้นมาจาก MD เป็นมุกกับมุกระนาบผิวแผ่นฐาน 60° (60° dislocation) เรียกชื่อว่า Slip plane เกิดขึ้นเป็นแนวยาวตาม MD ปรากฏขึ้นที่ผิวน้ำเรียกว่า Surface step โดยที่จุดสิ้นสุดของ Surface step คือจุดที่ TD วิ่งมาถึงนั่นเอง

Threading dislocation (TD) สามารถเกิดจากแผ่นฐานดังแสดงในรูปที่ 2.6 (a) หรือมาจากฟิล์มที่ปูลูกดังแสดงในรูปที่ 2.6 (b) และ (c) ในกรณีที่ TD เกิดจากฟิล์มที่ปูลูกสามารถจำแนกย่อยได้เป็นสองชนิดได้แก่ Mobile TD และ Immobile TD ซึ่งต่างกันที่อิสระภาพในการเคลื่อนที่ โดย Immobile TD จะถูกกั้น (Block) โดย MD เส้นที่ตั้งจากกัน ส่วน Mobile TD นั้นสามารถเคลื่อน

(Glide) ได้ตามความหนาชั้นพลีกที่ปลูก และขังเพิ่มความยาวให้กับ MD ได้อีกด้วย โดยที่ทั้งสองกรณีนั้นความหนาต้องมากกว่าความหนาวิกฤติขึ้นไป ($h > h_c$) [14] ดังแสดงในรูปที่ 2.6



รูปที่ 2.6 TD และ MD (a) เมื่อ $h < h_c$ ยังไม่ปรากฏ MD ขึ้น และ TD มาจากแผ่นฐานเท่านั้น (b) เมื่อ $h > h_c$ แล้ว TD จะเริ่มเคลื่อนและทำให้ MD ขยาย $\Delta\lambda$ ตามความหนา dh ที่มากขึ้น (c) เมื่อ TD เคลื่อนมาจับกับ MD อีกเส้นที่ขวางอยู่ TD จะหยุดเคลื่อนที่ กลายเป็น Immobile TD [14]

Dislocation ที่เกิดขึ้นทำให้ความเครียดสะสมภายในพลีก $\varepsilon(h_{c60})$ ลดลงตามความหนาที่เพิ่มขึ้น h_{c60} ตามความสัมพันธ์ [10]

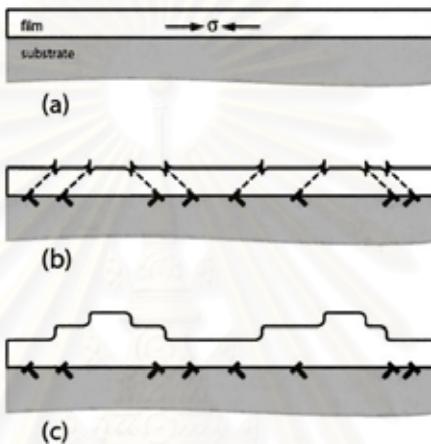
$$\varepsilon(h_{c60}) = \frac{\frac{G_{GaAs}G_{InGaAs}b}{\pi(G_{GaAs}+G_{InGaAs})(1-\nu)}(1-\nu \cos^2\theta)(\ln(\frac{h_{c60}}{b})+1)}{Yh_{c60}} \quad (2.2)$$

Dislocations ที่เกิดขึ้น นอกจากจะทำหน้าที่คลายความเครียดสะสมภายในพลีกแล้ว ยังมีผลต่อผิวน้ำอีกด้วย ซึ่งผลกระทบนี้เป็นต้นเหตุของการเกิดลายตารางบนผิวน้ำ เรียกผิวน้ำนี้ว่า ผิวน้ำลายตาราง ซึ่งผิวน้ำลายตารางนี้หากปลูกความตั้มดอตทับลงไป ผิวน้ำนี้จะسمีอนเป็นแผ่นฐานสำหรับความตั้มดอต เรียกผิวน้ำที่ทำหน้าที่เป็นสมีอนแผ่นฐานนี้ว่า แผ่นฐานลายตาราง (Cross-hatch substrate) หรือแผ่นฐานสมีอนอย่างไรก็ตามนอกจหลวงหนาวิกฤต (h_c) ที่เป็นความหนาที่เริ่มเกิด Dislocation แล้ว ยังมีความหนาวิกฤตอีกค่าหนึ่งที่ Dislocations เกิดขึ้นมากขึ้นแบบทวีคูณ (h_p) ซึ่งมีผลต่อผิวน้ำโดยตรงเช่นกัน

2.2.3 Surface steps

ต้นกำเนิด Surface step มาจาก Dislocation ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น นั่นหมายความว่า ผลของการผ่อนคลายความเครียดสะสมภายในของชั้นพลีกส่งผลต่อผิวน้ำด้วย เมื่อมีการปลูกทับ Surface steps ที่เกิดขึ้นต่อไป ชั้นพลีกจะหนาขึ้นและเกิดกระบวนการกำจัด Surface steps ที่ผิวน้ำ

(Surface step elimination) [13] ดังแสดงในรูปที่ 2.7 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เมื่อความเครียดสะสมในชั้นผลึกปะลูกทับ (Overlayer) ไปจนกระทั่งความหนาชั้นผลึกมากถึงค่าวิกฤติ (h_c) จึงเกิด Dislocation เพื่อผ่อนคลายความเครียดของชั้นผลึกที่สะสมมาหาก ซึ่ง Dislocation ได้ส่งผลไปที่ผิวน้ำโดย Slip plane จาก 60° dislocation เกิดเป็น Surface step สุดท้ายแล้วกระบวนการ Surface step elimination ทำให้ผิวน้ำเกิดความเปลี่ยนแปลงดังรูปที่ 2.7 (c) เมื่อทำการปะลูกชั้นผลึกต่อไป ซึ่งผิวน้ำที่เป็นลักษณะลอนเช่นนี้ (Undulation surface) เป็นลักษณะของแผ่นฐานลายตาราง

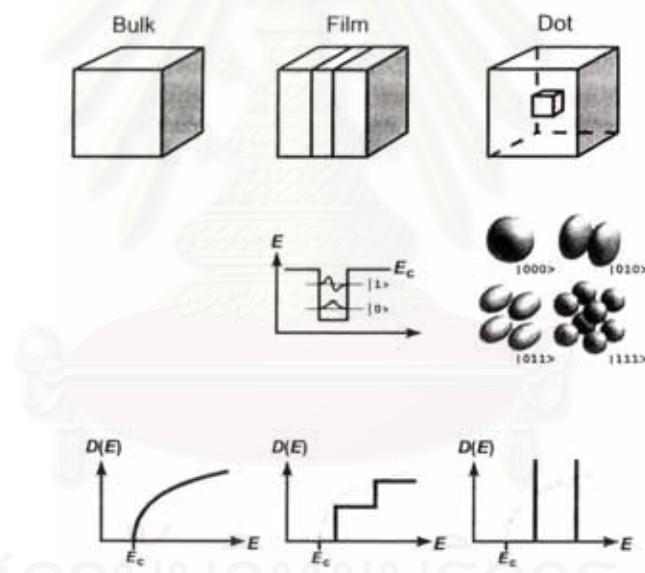


รูปที่ 2.7 การเกิด Surface step elimination (a) ชั้นฟิล์มเกิด Compressive strain (b) เกิด Dislocations และ Surface steps ตามมา (c) เมื่อเพิ่มความหนาต่อไปจะเกิดเนินที่เกิดจาก Surface step elimination [13]

สรุปหัวข้อ 2.2 ได้ว่าแผ่นฐานลายตารางเกิดมาจากการมีความเครียดจากการปะลูกชั้นผลึกที่มีค่าคงที่ผลึกไม่เข้ากันและความเครียดดังกล่าวในชั้นผลึกมีมากจนเกินค่าวิกฤติ ผลึกจะก่อตัวแบบเหลื่อมกันเกิดเป็น Line defects หรือ Dislocations เพื่อลดความเครียดที่เกิดขึ้น แต่ Dislocations (MDs และ TDs) ที่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วจะส่งผลต่อผิวน้ำไปตลอดการปะลูกด้วย Slip plane ซึ่งเป็นผลมาจากการปะลูกชั้นผลึกของ Slip plane ที่ไปปรากฏบนผิวน้ำจะเรียกว่า Surface steps เมื่อการปะลูกชั้นผลึกต่อไป Surface steps ที่เกิดขึ้นจะเป็นต้นเหตุของการเกิดลายตารางจากกระบวนการ Surface step elimination (ดังในรูปที่ 2.7) จะเห็นว่าลายตารางที่เกิดขึ้นในที่สุดนั้น มีต้นเหตุมาจากการปะลูกผลึกด้วยค่าคงที่ผลึกที่ต่างกันดังเช่น InGaAs / GaAs

2.3 ควอนตัมดอต (Quantum dots, QDs)

ควอนตัมดอตคือโครงสร้างขนาดเล็กในระดับที่เข้าใกล้ขนาดของอะตอมหรือโมเลกุลซึ่งมีลักษณะสมบัติที่ต่างจากโครงสร้างขนาดใหญ่ เช่นแบบก้อนพลีก (Bulk) โครงสร้างขนาดเล็กมีหลายรูปแบบซึ่งถูกจำแนกตามมิติความเป็นอิสระ (Degree of freedom) ของพาราเมเตอร์ในโครงสร้าง โครงสร้างขนาดใหญ่ (Bulk) พาราเมเตอร์ในมีอิสระในการเคลื่อนที่ทั้งสามมิติ (3D) สำหรับโครงสร้างขนาดเล็ก ได้แก่ ควอนตัมเวลล์ (Quantum well) ควอนตัมไวร์ (Quantum wire) และ ควอนตัมดอต (Quantum dot) พารามิเตอร์ที่จำกัด (Confine) และมีอิสระภาพในการเคลื่อนที่เพียงสองมิติ หนึ่งมิติ และ ศูนย์มิติตามลำดับ ดังแสดงในรูปที่ 2.8 เมื่อเทียบโครงสร้างแบบต่างๆ กันแล้วพบว่าโครงสร้างแบบก้อนพลีกจะมีความหนาแน่นสถานะ (Density Of States, DOS) แบบต่อเนื่องในขณะที่โครงสร้างขนาดเล็กแบบอื่นๆ จะเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง [6]



รูปที่ 2.8 (ແຄວນ) โครงสร้างแบบก้อนพลีก, แบบควอนตัมเวลล์ และแบบควอนตัมดอต

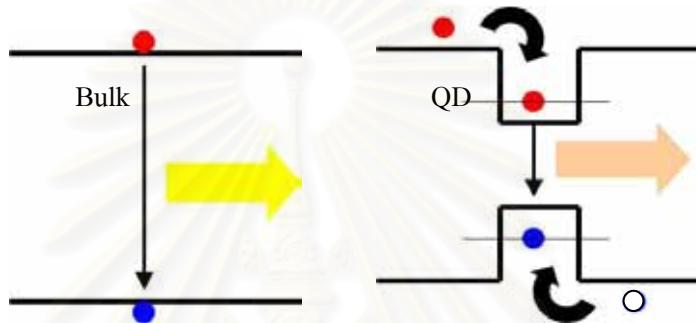
(ແຄວກລາງ) สถานะแบบขั้นของควอนตัมเวลล์และควอนตัมดอต

(ແຄວລ່າງ) ความหนาแน่นสถานะ (DOS) [1]

ลักษณะสมบัติของระดับพลังงานภายในของโครงสร้างขนาดเล็ก เช่น ควอนตัมดอตและควอนตัมเวลล์นี้ จะแตกต่างจากโครงสร้างแบบก้อนพลีก โดยระดับพลังงานภายในของควอนตัมดอตจะมีลักษณะเป็นค่าไม่ต่อเนื่อง (Discrete) เรียกว่า Quantized state [1] ต่างจากโครงสร้างแบบก้อนพลีกที่พารามิเตอร์ที่พลังงานได้ทุกระดับที่พลังงานที่ต่ำกว่า Valence band และสูงกว่า

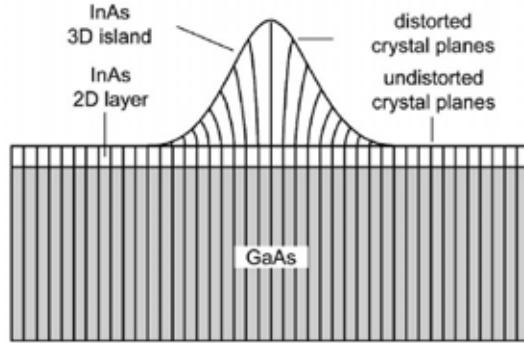
Conduction band ส่วน DOS ของความต้มดอตในอุคุมคติจะเป็น Delta function (δ) [1,6] ดังแสดงในรูปที่ 2.9 หมายความว่าพำนะจะสามารถมีพลังงานได้เพียงบางค่าที่ไม่ต่อเนื่องเท่านั้น

ผลของการที่มีระดับพลังงานเพียงบางค่าและไม่ต่อเนื่องทำให้โครงสร้างความต้มดอตนี้สามารถใช้ประยุกต์เป็นสิ่งประดิษฐ์ทางแสง ได้หลากหลาย และยังปรับแต่งคุณสมบัติของไฟฟอนที่ปล่อยออกมานี้ได้ เช่น โดยการตรวจสอบส่วนของสารประกอบของความต้มดอต ขนาดของความต้มดอต และการเรียงตัวของกลุ่มของความต้มดอตเป็นต้น



รูปที่ 2.9 ระดับพลังงานภายในของโครงสร้างแบบก้อนผลึก (ซ้าย) และ ความต้มดอต (ขวา)

ความต้มดอตสามารถเกิดขึ้นได้จากปัจจัยหลายๆอย่าง โดยวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เน้นไปที่ การปลูกความต้มดอตลงบนแผ่นฐานลายตาราง ซึ่งให้ผลเป็นการเรียงตัวเฉพาะของความต้มดอต แม้ เป็นการปลูกบนแผ่นฐาน GaAs ระนาบ (001) ธรรมชาติ ต่างจากการทำรูปแบบ (Pattern) ลงบนแผ่นฐานซึ่งกรณีนี้เกิดจากการเตรียมแผ่นฐานที่มีการทำหนีไว้ตามลายที่ต้องการก่อนนำมาปลูก [22] เมื่อปล่อยสารที่ต้องการให้เกิดเป็นความต้มดอตลงไป ลายที่ทำไว้ทำหน้าที่เป็นจุดกำหนดตำแหน่ง การเกิดของความต้มดอตบนแผ่นฐาน สำหรับวิธีการปลูกความต้มดอตทับบนชั้นแผ่นฐานลายตาราง เมื่อความต้มดอตเกิดการก่อตัวแบบประกอบตนเอง (Self-assembly quantum dot) ความต้มดอตที่เกิดขึ้นจะมีตำแหน่งไม่เป็นแบบสุ่ม แต่จะเรียงตัวบนเส้นลายตารางที่เกิดบนผิวน้ำของแผ่นฐานลายตาราง แสดงให้เห็นได้ว่าการเกิดความต้มดอตสามารถเกิดได้บนแผ่นฐานแบบต่างๆ และ รูปแบบการเกิดก็แตกต่างกันด้วย



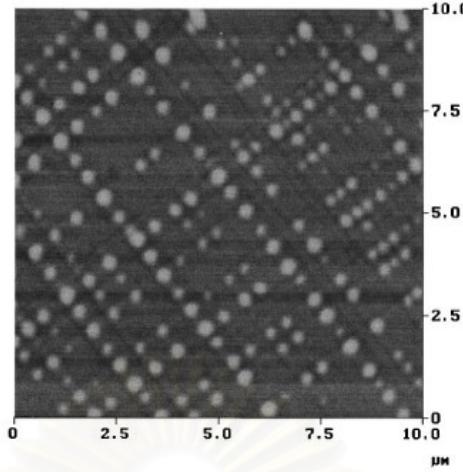
รูปที่ 2.10 ลักษณะของการเกิดความตั้งตัวของ InAs บนแผ่นฐาน GaAs แบบ SK [23]

การเกิดความตั้งตัวของ InAs บน GaAs เป็นรูปแบบการเกิดชั้นผลึกแบบ SK เริ่มต้นด้วยการที่ InAs ชั้นแรกๆ ที่ก่อตัวที่ผิวน้ำ GaAs ทำหน้าที่เป็น Wetting layer เนื่องมาจากค่า ϵ ของกระบวนการนี้คือประมาณ 7 % ซึ่งจากแผนภาพเฟสสมดุลในรูปที่ 2.1 พบว่าที่ $\epsilon = 0.07$ ชั้นแรกๆ ของ InAs จะยังเป็นรูปแบบ FM อยู่ InAs ที่เกิดขึ้นจะเกาะตัวกับแผ่นฐาน GaAs แบบอัดตัว (Compressive) ดังแสดงในรูปที่ 2.3 ซึ่งยังคงเป็นเป็นการเกิดชั้นผลึกแบบสองมิติ เพราะว่าค่าค่าของผลึกของ InAs มากกว่า GaAs เมื่อคำนึงการปลูกชั้น InAs ต่อไป Wetting layer ของ InAs จะหนาขึ้นและความเครียดของชั้นฟิล์มจะเพิ่มขึ้นตามเวลาที่ปลูกชั้น InAs เมื่อความเครียดสะสมถึงระดับหนึ่ง InAs ที่เกาะกันอยู่คิมจะก่อตัวใหม่เพื่อคลายความเครียดที่เกิดจากการเกาะกันแบบอัดตัวจากต่อนแรก การก่อตัวขึ้นใหม่จะเกิดเป็นโครงสร้างความตั้งตัวดังแสดงในรูปที่ 2.10 อย่างไรก็ตามสำหรับการปลูกผลึกที่ Lattice mismatch $\epsilon < 1.5 \%$ เมื่อความเครียดสะสมมากถึงค่าหนึ่ง การคลายความเครียดจะไม่เกิดเป็นความตั้งตัว แต่จะเกิด Dislocation แทน [24] ดังที่กล่าวไว้ในหัวข้อที่ 2.2 ส่งผลให้ผิวน้ำมีลักษณะเป็นลายตารางดังที่จะกล่าวในหัวข้อต่อไป

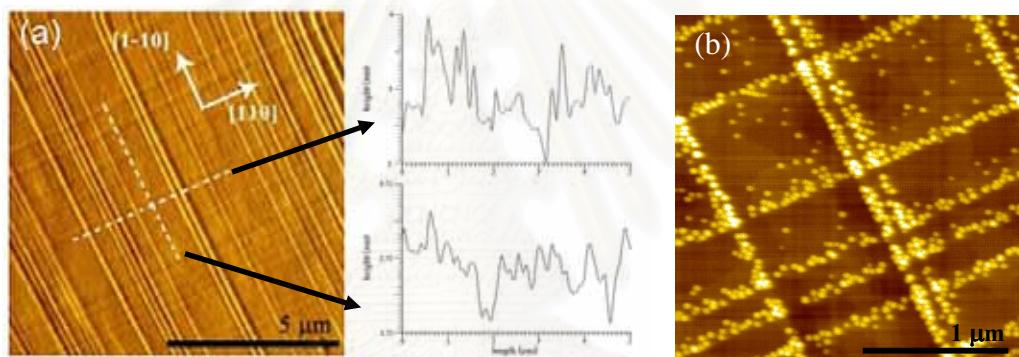
2.4 แผ่นฐานลายตาราง (Cross-hatch substrate)

แผ่นฐานลายตารางเป็นผลมาจากการปลูกชั้นผลึกที่ค่าค่าของฟิล์มที่ปลูกแตกต่างจากของแผ่นฐานในระดับที่ไม่สูงนัก ($\epsilon < 1.5 \%$) การเกิด MD จากกระบวนการดังกล่าวเป็นการเกิดเองตามธรรมชาติและถูกกำหนดโดยหลักการทางสถิติ ลายตารางอันเนื่องมาจากการปลูกฟิล์มทับบน MD และ TD จึงมีลักษณะเป็นแบบสุ่ม คือไม่สามารถกำหนดตำแหน่งที่แน่นอนของลายตารางได้ อย่างไรก็ตามการปรับกระบวนการในการปลูกจะทำให้สามารถกำหนดความหนาแน่นของลายตาราง และความสูงของลายตารางได้

ลายตาราง (Cross-hatch pattern) เกิดจากความไม่เข้ากันของค่าคงที่ผลึก เช่นจากคู่ของสารประกอบ III-V (เช่น InGaAs / GaAs) หรือ จากคู่ของสารประกอบหมู่ IV-IV (เช่น SiGe / Si) [24,25,26] เป็นต้น คู่ของสารประกอบหมู่ IV-IV กับ III-V เมื่อมีอันตรายที่ลายตารางมีต้นเหตุการเกิดเดียวกันคือเกิดจากความไม่เข้ากันของค่าคงที่ผลึกแบบ Low lattice mismatch และการเกิด Dislocation จากกระบวนการ Strain relaxation แต่ก็มีความแตกต่างกันด้วย ตรงที่เส้นลายตารางของคู่สารประกอบหมู่ IV-IV ทั้งสองแนวที่ตั้งฉากกันของลายตารางนั้นเมื่อมีอันตรายแสดงในรูปที่ 2.11 ในขณะที่ลายตารางจากสารประกอบหมู่ III-V อย่างเช่น InGaAs/GaAs จะให้ลายตารางสองแนวที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน เพราะว่าสารประกอบหมู่ III-V นั้นเกิดจากชาตุของหมู่ III และหมู่ V เกาะเป็น Unit cell ด้วยรูปแบบ Zinc blend [20] ดังแสดงในรูปที่ 2.2 ดังนั้นถ้านำแผ่นฐาน GaAs (001) มาเป็นแผ่นฐานตั้งต้น เมื่อปั๊กทับด้วย InGaAs ภายใต้เงื่อนไข Low lattice mismatch แล้วลายตารางที่ขานานกับทิศ [1-10] กับ [110] จะมีความแตกต่างกันดังในรูปที่ 2.12 (a) ซึ่งเป็นรูปของผิวน้ำชั้นงานซึ่งปั๊กชั้นลายตาราง $In_{0.2}Ga_{0.8}As$ หนา 50 nm บนแผ่นฐาน GaAs ระนาบ (001) มี Line scan ของเส้นลายตารางทั้งสองแนวแสดงไว้ด้านข้าง พบว่าความสูงของเส้นลายตารางที่ขานานกับทิศ [1-10] มีความสูงมากกว่าเส้นลายตารางที่ขานานกับทิศ [110] เนื่องมาจากการที่เป็นแกน (Core) ของทั้งสองแนวนั้นต่างกัน โดยแนว [1-10] มี As เป็น Core ขณะที่แนว [110] มี Ga เป็น Core [12] เป็นผลให้ลายตารางที่เกิดขึ้นจากทั้งสองแนวมีคุณสมบัติต่างกันด้วย และผลนี้ยังส่งผลถึงชั้นความตั้มดอตที่ปั๊กทับลายตารางอีกด้วย ซึ่งผลของการปั๊กชั้นความตั้มดอต 0.8 ML ทับบนแผ่นฐานลายตารางที่ปั๊กด้วยเงื่อนไขเดียวกัน ดังแสดงในรูปที่ 2.12 (b) ซึ่งความตั้มดอตบนแนวเส้นที่ขานานกับทิศทาง [1-10] ที่มีขนาดสูงกว่าบนแนวเส้นที่ขานานกับ [110] เช่นกัน เพราะว่าเป็นผลมาจากการชั้นลายตารางนั้นเอง [16] สำหรับข้อสรุปเกี่ยวกับชั้นลายตารางจะกล่าวละเอียดในบทที่ 4



รูปที่ 2.11 ผิวหน้าของความตั้มดอต Ge ปลูกบน SiGe/Si (100) ที่วัดด้วยกล้องจุลทรรศน์แรง
อะตอม [25]



รูปที่ 2.12 ผิวหน้าลายตารางจากสารประกอบอนุพันธุ์ III-V (a) $In_{0.2}Ga_{0.8}As$ 50 nm บน GaAs (001) (b)
เมื่อปลูกทับด้วยความตั้มดอต InAs 0.8 ML ทั้ง (a) และ (b) วางแผนทิศทางเดียวกันตามลูกศร [16]

การเกิด Dislocations จากการปลูก InGaAs / GaAs โดยที่ $\varepsilon < 1.5\%$ จะเริ่มเกิดขึ้นเมื่อปลูก
ชั้นผลึกหนาเกินค่าวิกฤต (h_{c60}) ซึ่งหากความหนาขึ้นอย่างกว่าค่าวิกฤตนี้ ผลึกยังคงมีความเครียดอยู่และ
ยังไม่เกิด Dislocation เพื่อคลายความเครียด แต่ถ้าชั้นผลึกหนามากกว่าค่าวิกฤตนี้ ผลึกจะเริ่มมี
Dislocations ขึ้นบางตำแหน่งและความเครียดในชั้นผลึกจะเริ่มลดลง และลดลงเรื่อยๆ หากทำการ
ปลูกต่อไป ค่า h_{c60} สามารถหาได้จากความสัมพันธ์ด้านล่าง [10]

$$h_{c60} = \frac{\frac{G_{GaAs} G_{InGaAs} b}{\pi(G_{GaAs} + G_{InGaAs})(1-\nu)} (1 - \nu \cos^2 \theta) (\ln(\frac{h_{c60}}{b}) + 1)}{Y_f} \quad (2.3)$$

$$G = C_{11} - \frac{1}{3} (2C_{44} + C_{12} - C_{11}) \quad (2.4)$$

$$b = \frac{\sqrt{2}}{2} a_{InGaAs} \quad (2.5)$$

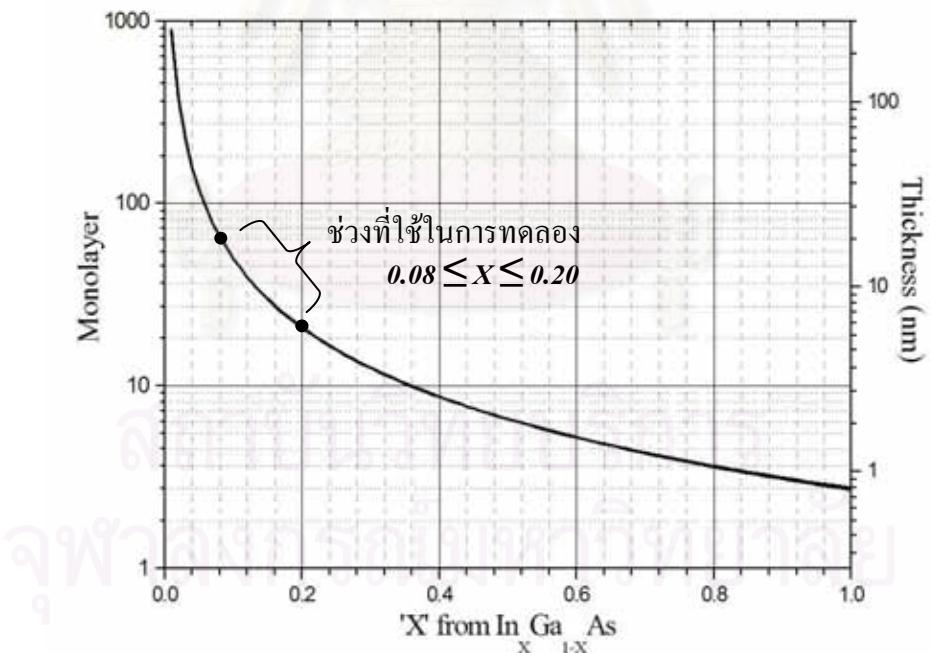
$$\nu = \frac{c_{12}}{c_{12} + c_{11}} \quad (2.6)$$

$$Y = C_{11} + C_{12} - 2 \frac{c_{12}^2}{c_{11}} \quad (2.7)$$

$$f = \frac{a_{InGaAs} - a_{GaAs}}{a_{InGaAs}} \quad (2.8)$$

เมื่อ h_{c60} คือความหนาบริเวณที่ 60° dislocation เกิดขึ้นพอดี, $\Theta = 60^\circ$, ν คือ Poisson ratio, G แทน Anisotropic factor, C คือ Elastic constant และ Y คือ Young's modulus

จากความสัมพันธ์ข้างบน พบว่าค่าความหนาบริเวณที่ของ InGaAs บน GaAs จะมีค่าเปรียบเทียบตาม X ใน $In_xGa_{1-x}As$ ดังรูปที่ 2.13 ซึ่งมีแนวโน้มคือ เมื่อสัดส่วนของ In ใน InGaAs เพิ่มขึ้น ค่าความหนาบริเวณจะลดลง



รูปที่ 2.13 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาบริเวณของชั้น InGaAs (Monolayer) ที่ปะลูกบน GaAs กับสัดส่วนของ In (ค่า X)

สำหรับการทดลองทั้งหมดในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะใช้ค่า X ระหว่าง 8-20 % ซึ่งมีค่า h_c อยู่ระหว่าง $6.0 < h_c < 18.7 \text{ nm}$ ซึ่งจะทำให้ได้ผิวน้ำเป็นลายตารางและจะใช้ประโยชน์ในการนำมาเป็นแพลตฟอร์มเสมือน (Virtual substrate) เพื่อใช้ในการจัดเรียงความตั้งคอดตัวยการประกอบตุณเองดังจะได้กล่าวโดยละเอียดในบทที่ 4 สำหรับบทต่อไปเป็นการอธิบายถึงเทคนิคการปลูกผลึกและการวัดลักษณะสมบัติ



บทที่ 3

การปลูกโครงสร้างและการวัดลักษณะสมบัติ

โครงสร้างชิ้นงานทั้งหมดในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ปลูกด้วยเครื่องปลูกผลึกแบบลำโมเลกุล (Molecular Beam Epitaxy, MBE) ยี่ห้อ RIBER รุ่น 32P ซึ่งติดตั้งอยู่ที่ห้องปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ (SDRL, Semiconductor Device Research Laboratory) โดยที่เครื่องปลูกผลึกแบบลำโมเลกุลเป็นอุปกรณ์หลักสำหรับการปลูกโครงสร้างความตั้มดอตแบบประกอบตนเอง (Self-Assembled Quantum Dots, SAQD) ความสามารถในการควบคุมการปล่อยปริมาณสารในลำโมเลกุลที่ละเอียดและมีความคลาดเคลื่อนในระดับต่ำ ทำให้เทคนิค MBE สามารถปลูกโครงสร้างความตั้มแบบต่างๆ ได้ตามที่ต้องการ ทั้งความตั้มเวลล์ (Quantum well) และความตั้มดอตหลายๆแบบ เช่นความตั้มดอตแบบกลุ่ม (QDM, Quantum Dot Molecule) ความตั้มดอตแบบคู่ (Quantum dots pair) และความตั้มดอตบนลายตาราง (Quantum dots on cross-hatches) เป็นต้น ความเข้าใจในหลักการของเครื่องปลูกผลึกแบบลำโมเลกุลเป็นสิ่งจำเป็นต่อการศึกษาวิวัฒนาการของความตั้มดอตบนแผ่นฐานลายตาราง ซึ่งเป็นงานหลักของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้

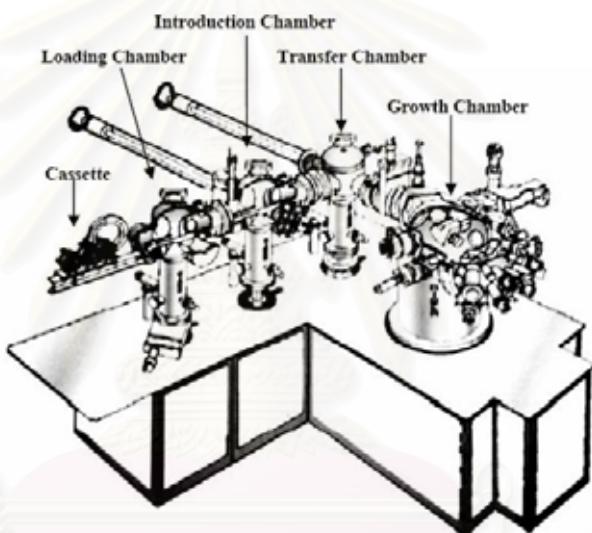
ชิ้นงานที่ได้จากการปลูกนี้สามารถศึกษาและวิเคราะห์ได้จากการวัดลักษณะสมบัติของโครงสร้าง ทั้งการวัดเพื่อตรวจสอบ (Monitor) ขณะทำการปลูกโครงสร้างด้วยเครื่องวัดแบบติดตั้งภายในระบบ (*in-situ*) เพื่อใช้ติดตามสภาพปัจจุบันแบบตามเวลาจริง (Real-time monitoring) และการวัดเพื่อคุณภาพด้วยเครื่องวัดภายนอกระบบ (*ex-situ*) โดยผลที่วัดได้จะเป็นผลของโครงสร้างที่ปลูกเสร็จแล้ว ซึ่งมีทั้งระบบวัดที่ใช้วัดผิวน้ำ วัดการปลดปล่อยทางแสง วัดสภาพหน้าตัด เป็นต้น ความเข้าใจในหลักการของการวัดลักษณะสมบัติด้วยเครื่องวัดแบบต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะใช้ยืนยันว่าโครงสร้างที่ปลูกนั้นเป็นโครงสร้างตามที่ต้องการจริง และผลที่ได้นั้นก็เป็นผลจากโครงสร้างที่ปลูกขึ้นจริง ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดก็คือสามารถเชื่อมโยงเชิงทฤษฎีระหว่างลักษณะโครงสร้างที่ปลูกกับคุณสมบัติทางแสงที่วัดได้

3.1 การปลูกโครงสร้างด้วยเครื่องปลูกผลึกแบบลำโมเลกุล

การปลูกชั้นผลึก (Epitaxial growth) สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การปลูกชั้นผลึกแบบสถานะของเหลว (LPE, Liquid-Phase Epitaxy) แบบสถานะไอ (VPE, Vapor-Phase Epitaxy) และ

แบบลำไไมเลกุล (MBE) โดย MBE มีข้อได้เปรียบหลายอย่าง เช่น ความบริสุทธิ์ของชั้นผลึกที่ปัจจุบันได้ อันเนื่องมาจากกระบวนการจะเกิดในห้องปัจจุบัน (Growth chamber) ที่ความดันต่ำในระดับ 10^{-9} Torr มีระบบดูดอากาศภายในออก และมีระบบหล่อเย็นด้วยไนโตรเจนเหลวตลอดเวลา ทำให้มีอนุภาคอื่นๆ เจือปนน้อยมาก หมายความว่าการปัจจุบันสิ่งประดิษฐ์ทางอิเล็กทรอนิกส์และทางแสงต่างๆ ที่ต้องการความแม่นยำในการปัจจุบันชั้นผลึกสูง เช่น เลเซอร์ เชลล์แสงอาทิตย์และไอดิโอดเปล่งแสง เป็นต้น

รายละเอียดการปัจจุบันมีขั้นตอนเบ็ดที่กว้างมาก เนื้อหาในหัวข้อนี้จึงจำกัดไว้เท่าที่จำเป็น ได้แก่ รายละเอียดของเครื่องปัจจุบันผลึกแบบติดตั้งภายในและกระบวนการปัจจุบัน



รูปที่ 3.1 เครื่องปัจจุบันผลึกแบบลำไไมเลกุล RIBER 32P

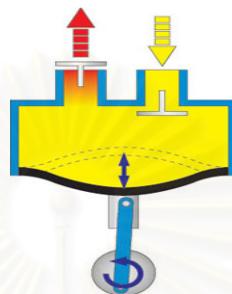
3.1.1 เครื่องปัจจุบันผลึกแบบลำไไมเลกุล

เครื่องปัจจุบันผลึกแบบลำไไมเลกุลประกอบไปด้วยห้อง (Chamber) ทั้งหมด 4 ห้องดังแสดงในรูปที่ 3.1 ซึ่งแต่ละห้องจะมีประตู (Gate) กันไว้ เพื่อให้แต่ละห้องเป็นอิสระต่อกัน โดยห้องทั้ง 4 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. **Loading chamber** ห้องโหลดเป็นห้องที่ใช้สำหรับส่งผ่านชิ้นงาน (Samples) ซึ่งได้มาจากการตัดแผ่นวงฟอเรอร์ (Wafer) ที่ถูกติดอยู่ที่ MO Block (Molybdenum block) จากสภาวะภายในเข้าสู่ภายในเครื่องปัจจุบันผลึกแบบลำไไมเลกุลที่เป็นระบบสูญญากาศ (Vacuum system) ห้องโหลดนี้

จะอยู่ติดกับห้องอินไทร์ดักชัน (Introduction chamber) ซึ่งถูกกันด้วยประตูกันเพื่อไม่ให้อากาศจากภายนอกทำให้ความดันภายในห้องอินฯเปลี่ยนแปลง

ภายในห้องนี้ชั้นงานทั้งหมดจะถูกกล้ามเลึงผ่านรถที่ใช้ระบบสายพานเป็นตัวส่ง การควบคุมสายพานกระทำได้ด้วยมือ (Manual control) โดยการหมุนเป็นขับเพื่อส่งสายพานจากภายนอก



รูปที่ 3.2 Diaphragm pump

ระบบสุญญาการในห้องโอลดอนนี้จะมีสองชนิดคือ Diaphragm pump และ Sorption pump ซึ่งการลดความดันในห้องโอลดจะใช้ Diaphragm pump ทำงานก่อนเพื่อคัดอากาศภายในห้องโอลดให้ต่ำลงมาจากค่าความดันบรรยายกาศ (760 Torr) ลงมาสู่ประมาณ 60 Torr การทำงานของ Diaphragm pump นั้นจะใช้หลักการของการหมุนแกนมอเตอร์ ร่วมกับคุณสมบัติความยืดหยุ่นของแผ่น Diaphragm ซึ่งนิยมใช้วัสดุดินปูร์เกท ยาง หรือ เทฟลอน (Teflon) ตามรูปที่ 3.2 ซึ่งจะเห็นได้ว่าอากาศจะถูกดูดออกจากทางด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่งได้ โดยอากาศจะถูกไล่จากท่อเข้า และถูกแผ่น Diaphragm ซึ่งบังคับด้วยการหมุนของแกนมอเตอร์นี้ ไล่ให้ออกไปทางท่อออก จะเห็นว่าด้วยวิธีการหมุนแกนมอเตอร์ไปในทิศทางเดียวแบบนี้ อากาศที่ถูกดูดออกจะไม่มีโอกาสในการไหลย้อนกลับ แต่ข้อเสียของ Diaphragm pump คือมีความสามารถในการคัดอากาศไม่ค่อยดีนัก ซึ่งถ้าเทียบกับความดันในระบบสุญญาการภายในเครื่องปั๊มผลึกแบบลำโมเลกุลแล้ว ความดันที่ได้จาก Diaphragm pump ถือว่ายังไม่ต่ำพอที่จะเปิดประตูกันจากห้องโอลดไปห้องอินไทร์ดักชันได้ ซึ่งก็ต้องเปิดระบบคัดอากาศ Sorption pump !เข้ารับช่วงต่อจาก Diaphragm pump



รูปที่ 3.3 รูปแบบโนมเลกุลของ Zeolite (ซ้าย) ตัวอย่าง Sorption pump (กลาง) และภาคตัดขวาง (ขวา)

Sorption pump จะทำงานต่อจาก Diaphragm pump ที่ระดับความดันประมาณ 60 Torr การทำงานของ Sorption pump นั้นอาศัยหลักการการดูดโนมเลกุลอากาศด้วยวัสดุที่ดูดซึมໄได้ (Porous material) เช่น Zeolite (เป็นสารประกอบอะลูมิโนไซลิเกต aluminosilicate) ซึ่งมีการเกาะกันของโนมเลกุลดังแสดงในรูปที่ 3.3 (ซ้าย) และถูกบรรจุอยู่ภายในถังอզูมินีขมที่อยู่ภายในกระเบ้าโฟมดังแสดงในรูปที่ 3.3 (ขวา) โดยมีช่องให้หล่อเย็นด้วยไนโตรเจนเหลว

เมื่อทำให้ Zeolite เย็นด้วยไนโตรเจนเหลว โนมเลกุลของ Zeolite จะสามารถดูดจับอากาศได้ดี ซึ่งใช้หลักการของการทำให้อากาศหรือไอที่ดักจับได้เกิดการควบแน่นและเกาะอยู่ตลอดเวลาที่ Zeolite ยังคงถูกหล่อเย็นอยู่ หลังจากปล่อยให้ Sorption pump ทำงานติดต่อกันเป็นเวลาประมาณ 20-30 นาที ความดันภายในห้องโหลดจะอยู่ที่ระดับประมาณ 10^{-3} Torr เมื่อความดันภายในห้องโหลดไม่ลดลงไปมากกว่านี้แล้ว ก็จะใช้ระบบดูดอากาศของห้องอินโพรดักชันช่วยแทนโดยการเปิดประตูก้นอย่างช้าๆเพื่อให้ความดันค่อยๆถ่ายเทไปให้ห้องอินโพรดักชันดูดออก สุดท้ายเมื่อสามารถเปิดประตูกันได้สุดบาน ก็จะทำการลามเลียงชิ้นงานผ่านร่องสายพานไปห้องอินโพรดักชันได้ต่อไป

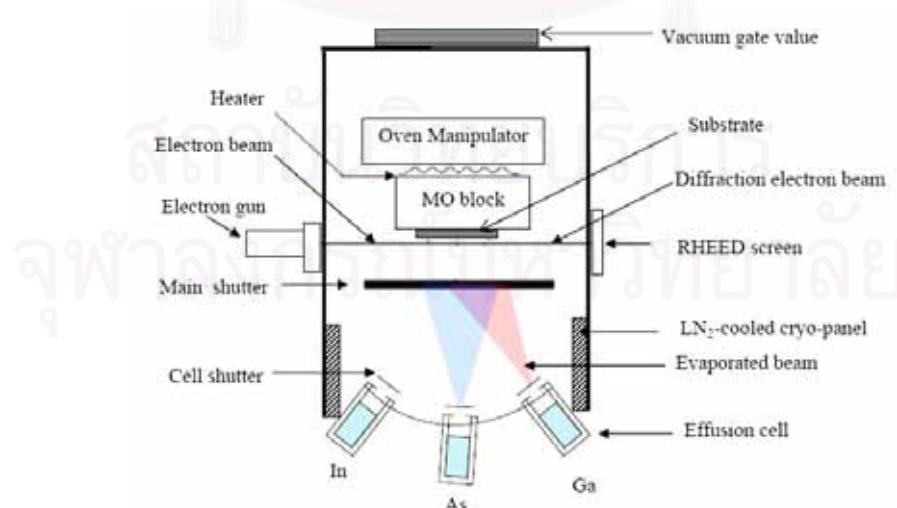
2. Introduction chamber ในห้องอินโพรดักชันนี้นิ่นออกจากจะใช้ลามเลียงชิ้นงานผ่านจากห้องโหลดไปห้องทรานส์เฟอร์แล้ว ยังมีแขนจับ (Magnetic arm) ที่เอ้าไว้จับ MO Block ออกจากรถ เพื่อสลับตำแหน่งบล็อก หรือใช้นำชิ้นงานไปเข้ากระบวนการ Heat treatment (Pre-heat) เพื่อขัดสิ่งเจือปนที่เกาะอยู่ที่ผิวน้ำของชิ้นงาน และแขนจับก็ยังเป็นตัวกลางในการส่งผ่านชิ้นงานจากรถ

คันแรก (สำหรับน้ำยาชีนงานระหว่างห้องโอลด์และห้องอินไทร์ดักชัน) ไปสู่รอกันที่สอง (สำหรับน้ำยาชีนงานระหว่างห้องอินไทร์ดักชันและห้องทรายส์เฟอร์) สำหรับการทำ Heat treatment นั้นจะกล่าวโดยละเอียดในส่วนการเตรียมพิวาน้ำยาชีนงานสำหรับปลูกชั้นผลึก

ระบบดูดอากาศภายในห้องนี้เป็นระบบ Ion pump และ Titanium pump ซึ่งระบบดูดอากาศนี้จะล้มเหลวถ้าเมื่อความดันภายในห้องนี้มีมากกว่าที่ระบบดูดอากาศสามารถดูดออกได้ คือ ประมาณ 10^{-6} ถึง 10^{-5} Torr ระบบดูดอากาศจะตัดการทำงานตัวเองลง หากต้องการจะใช้งานใหม่ ก็จะต้องใช้ Diaphragm pump และ Sorption pump ทำการดูดอากาศออกบางส่วนก่อน จากนั้นก็จะใช้ระบบดูดอากาศของห้องข้างๆกันช่วยดูดลงไปให้ถึงระดับที่สามารถเปิดการทำงานของระบบ Ion pump และ Titanium pump ที่ปิดตัวลงไปได้

3. *Transfer chamber* ห้องทรายส์เฟอร์ใช้สำหรับการส่งชิ้นงานจากรอกันที่สองเข้าสู่ห้องปลูก และยังเป็นที่พักชิ้นงานที่รอการปลูก หรือรอการทำ Heat treatment ด้วย เพราะว่าเป็นห้องที่ติดกับห้องปลูกและห้องอินไทร์ดักชัน ระบบดูดอากาศภายในห้องนี้เป็นระบบเดียวกับห้องอินไทร์ดักชันและห้องปลูก ซึ่งสามารถรักษาความดันภายในห้องทรายส์เฟอร์ให้อยู่ในระดับประมาณ 10^{-9} Torr

ภายในห้องนี้มีแขนจับอยู่อีก 1 แขนเพื่อเอาไว้จับ MO Block ที่ติดชิ้นงานที่ต้องการจะนำเข้าสู่ห้องปลูก และใช้ข้ายำตำแหน่งบล็อกบนรถอีกด้วย



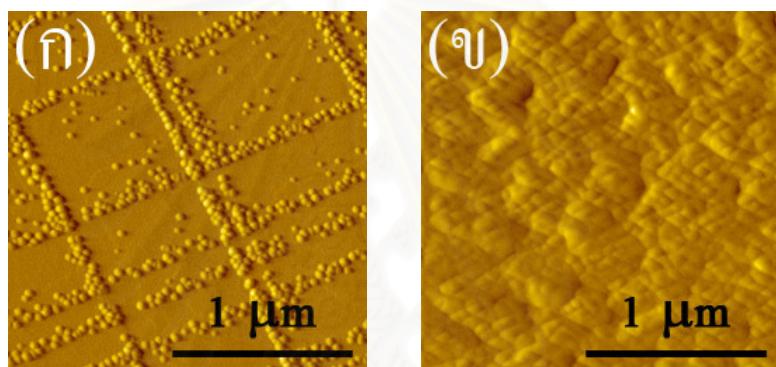
รูปที่ 3.4 แผนภาพอย่างง่ายภายในห้องปลูกของเครื่องปลูกผลึกแบบลำไมเลกุล [3]

4. Growth chamber ห้องปั๊กเป็นห้องที่ใช้ทำการบวนการปั๊กผลึกด้วยลำไบโมเลกุล จึงถือว่าเป็นหัวใจของเครื่องปั๊กผลึกแบบลำไบโมเลกุล ส่วนประกอบสำคัญภายในห้องปั๊กดังแสดงในรูปที่ 3.4 ได้แก่

- แท่น Manipulator มีที่สับล็อก ซึ่งมีอุปกรณ์วัดแรงดันไอ (Ionization gauge) ติดตั้งอยู่ และมี Heater ไว้สำหรับปรับอุณหภูมิชิ้นงาน แท่นนี้ตรงส่วนที่ติดกับ MO Block จะสามารถหมุนได้ โดยขับด้วยมอเตอร์ที่ปรับความเร็วของการหมุนได้จากแป้นหมุน เพื่อให้ชิ้นงานได้รับลำไบโมเลกุลสม่ำเสมอทั้งชิ้นงาน และแท่นนี้ยังสามารถปรับมุมไปได้หลายมุม เพื่อใช้ในหน้าที่ต่างๆ เช่น มุมประมาณ 160-170° คือมุมสำหรับนำ MO Block เข้า-ออกจากห้องปั๊ก มุม 224° คือมุมสำหรับวัดแรงดันไอ และมุม 330° คือมุมปั๊กเนื่องจากชิ้นงานจะหันหน้าเข้าตรงตำแหน่งลำไบโมเลกุลที่ปล่อยออกมายากแต่ละเซลล์พอดี
- ระบบดูดอากาศออก เป็นระบบ Ion pump และ Titanium pump เช่นเดียวกับห้องอินโตรคัชั่นและห้องทรานส์ฟอร์ ต่างกันที่ห้องนี้จะเป็นระบบดูดอากาศทึบสองกีเดียวเมื่อออยู่ในสถานะพักเท่านั้น โดยในขณะปั๊กระบบ Titanium pump จะต้องปิดไว้และเปิดให้ทำงานได้เฉพาะ Ion pump เท่านั้น
- ระบบตรวจวัดแบบติดตั้งภายใน (*In-situ* monitor system) มี Quadrupole mass spectrometer เพื่อวิเคราะห์มวลของอนุภาคภายในห้องปั๊ก โดยสามารถเทียบได้จากตารางว่ามีสารใดในห้องปั๊กบ้างจากยอด (Peak) ของกราฟที่คาดค่ามวลในช่วงที่ตั้งไว้ เพราะเครื่องจะบอกมาเป็นเลขมวลของสาร และมี RHEED (Reflection High-Energy Electron Diffraction) เพื่อดูลักษณะผิวน้ำตามเวลาจริงให้สามารถติดตามผลกระทบระหว่างการปั๊กได้ทันที

หลักการปั๊กผลึกแบบลำไบโมเลกุลสามารถพิจารณาได้จากรูปที่ 3.4 ชิ้นงานที่ติดอยู่กับ MO Block จะมีม่านชัตเตอร์หลัก (Main shutter) ปิดอยู่เพื่อป้องกันผิวน้ำชิ้นงานไม่ให้มีอนุภาคเลือดลอดมาเกาะได้ ไม่ว่าม่านชัตเตอร์ของเซลล์ (Cell shutter) จะเปิดหรือปิดอยู่กีตาม เซลล์บรรจุสารแต่ละเซลล์ (Effusion cell) ก็จะมีม่านชัตเตอร์ของแต่ละเซลล์แยกอิสระต่อ กัน ซึ่งหน้าที่ของม่านชัตเตอร์แยกย่อยของแต่ละเซลล์นี้ก็เอาไว้ใช้ควบคุมการปล่อยลำไบโมเลกุล (Molecular beam) ของสาร

นั้นๆ หากเป็นม่านชัตเตอร์พร้อมกันมากกว่าหนึ่งเซลล์ ก็จะทำให้เกิดเป็นสารผสมเช่นเปิค์ม่านชัตเตอร์ของเซลล์อาร์เซนิก (As_4) แกลเดียม (Ga) และอินเดียม (In) พร้อมกัน ก็จะได้เป็นสารประกอบอินเดียมแกลเดียมอาร์เซไนด์ ($InGaAs$) ส่วนการควบคุมปริมาณสารในลำไไมเลกุลนั้นจะควบคุมด้วยการปรับอุณหภูมิเตา (Crucible) ของเซลล์ที่ทำการปล่อยลำไไมเลกุลอยู่ ยิ่งอุณหภูมิสูง สารนั้นก็จะถูกปล่อยออกมาก อย่างไรก็ตาม อัตราเร็วในการเปลี่ยนอุณหภูมิของสารแต่ละชนิดก็จะแตกต่างกันออกไป หากเป็นสารผสม การควบคุมอุณหภูมิของแต่ละเซลล์ก็จะเป็นการปรับอัตราส่วนของสารผสมนั้นๆด้วย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงและต้องควบคุมอย่างแม่นยำในการปักลูกชิ้นแผ่นฐานลายตาราง (Cross-hatch substrate)



รูปที่ 3.5 ภาพจากกล้องจุลทรรศน์แรงดันต่ำแสดงผิวน้ำของชิ้นงานเดียวกันเมื่อวัด (ก) ทันทีหลังจากปั๊ก และ (ข) เมื่อปั๊บตั้งไว้ 4 เดือน

ขึ้นงานที่ปลูกสร้างแล้วก็จะถูกลำเลียงย้อนกลับออกจากห้องปลูก ไปยังห้องทราบส์เพอร์ ห้องอินโกรดักชัน และห้องโหลดเพื่อนำออกสู่สภากา yanok ในที่สุด ขึ้นงานที่ปลูกแล้วบางชิ้นงานอาจจะทำปฏิริยา กับอากาศภายนอก ดังนั้นต้องคำเลียงของอย่างระมัดระวังและเก็บรักษาอย่างดี หรืออาจจะต้องรีบทำการวัดลักษณะสมบัติให้เร็วที่สุดเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท น้อยที่สุด สำหรับรูปที่ 3.5 แสดงถึงการเปรียบเทียบระหว่างผิวน้ำของชิ้นงานเดียวกันที่วัด (ก) ทันทีหลังจากปลูกสร้างและ (ข) หลังจากที่ไว้ภายในกล่องบรรจุที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลาประมาณ 4 เดือน จึงเห็นได้ว่าความแตกต่างของผิวน้ำอย่างชัดเจน

3.1.2 ระบบตรวจวัดแบบติดตั้งภายใน (in-situ)

การปฎิกรองสร้างบันชีนงานด้วยเครื่องปฎิชนิดนี้ หลังจากที่ได้นำชีนงานเข้าไปที่ห้อง
โหลดแล้วชีนงานจะไม่สัมผัสกับบรรยายการสภาพนอกรถ ก็จะต้องนำชีนงานเข้าสู่ห้องปอก

ผู้ดำเนินการจะไม่สามารถรับรู้สภาพของชิ้นงานระหว่างปั๊กโครงสร้างได้ด้วยตา เพราะว่าห้องปั๊กเป็นห้องทึบ ไม่สามารถเห็นได้จากภายนอก และแม้ว่าเครื่องปั๊กผลึกบางรุ่นอาจมี Viewport แต่กระบวนการการเกิดโครงสร้างบนผิวน้ำก็เป็นในระดับชั้นของอะตอมหรือโมเลกุล จึงไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าอยู่ดี ระบบวัดแบบติดตัวภายในเครื่องปั๊กผลึกแบบลำโมเลกุลจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ทราบสถานการณ์ภายในห้องปั๊กในขณะดำเนินการอยู่ ทั้งการสังเกตการณ์การเกิดโครงสร้างบนผิวน้ำ การวัดค่าความดัน ไอและการเกิดความพิเศษระหว่างดำเนินการ

ระบบตรวจวัดแบบติดตัวภายในเครื่องปั๊กผลึกแบบลำโมเลกุลที่สำคัญประกอบด้วย เกจ (Gauge) วัดแรงดันไอ (Flux) ระบบตรวจวัดผิวน้ำด้วย RHEED (Reflection High Energy Electron Diffraction), ระบบวัดมวลและปริมาณสาร QMS (Quadrupole Mass Spectrometer) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

3.1.2.1 การวัดค่าแรงดันไอ (Flux measuring)

เกจวัดแรงดันไอเป็นชนิด Ionization gauge ซึ่งติดตัวอยู่ที่แท่น Manipulator แต่อยู่มุมที่แตกต่างกันกับมุมที่ใส่ MO Block ทำให้ไม่สามารถวัดแรงดันไอที่ถูกต้องระหว่างปั๊กได้ ดังนั้น ก่อนทำการปั๊กทุกครั้งจึงต้องวัดค่าแรงดันไอของสารแต่ละชนิดก่อน

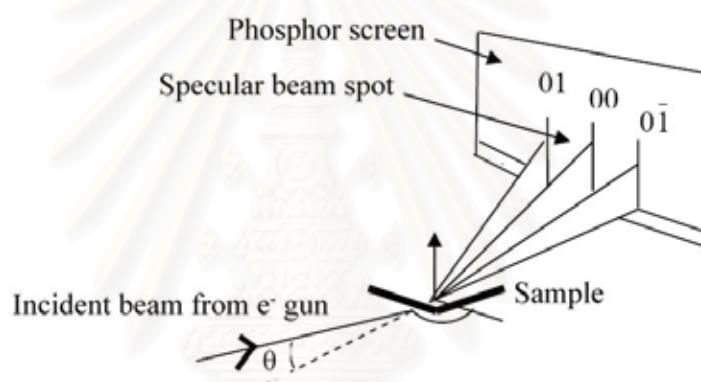
สารที่ใช้สำหรับปั๊กโครงสร้างในการศึกษามีอยู่สามชนิดคือ In, Ga และ As ก่อนที่จะทำการปั๊กโครงสร้าง สารทั้งสามชนิดนี้ต้องผ่านกระบวนการวัดค่าแรงดันไอให้ครบถ้วนค่า ซึ่งสิ่งที่ควบคุมได้คือ อุณหภูมิเตาและม่านชัตเตอร์ ดังนั้นมีอุ่นแรงดันไอที่วัดมาแล้ว ต้องบันทึกค่า อุณหภูมิเตาที่สอดคล้องกันด้วย การวัดแรงดันไอมีเงื่อนไขคือ In และ Ga ต้องถูกวัดก่อน As เพราะว่า In และ Ga นั้นมีอุ่นแรงดันไอที่ต้องการตั้งแต่ 400 ถึง 500 องศาเซลเซียส แต่สำหรับ As ค่าที่อ่านได้จากเกจจะเปลี่ยนแปลงหลังจากการเปิด-ปิดชัตเตอร์มากกว่าสารสองชนิดแรกมาก และเมื่อปิดม่านชัตเตอร์แล้ว As จะยังคงอยู่ในห้องปั๊กอีกระยะหนึ่ง เกจจึงไม่สามารถแสดงผลการเปลี่ยนแปลงไปสู่ค่าแรงดันไอจริงทันทีได้

สำหรับ In และ Ga ก่อนเริ่มทำการวัดแรงดันไอ ต้องทำการส่องประกายหลักก่อน (De-gas process) เนื่องจากขณะที่ไม่ได้มีการใช้เครื่อง ในโton เจนเพื่อไม่ได้ถูกป้อนเข้าสู่ระบบ ทำให้อุ่นภาคและสิ่งแวดล้อมทั้งหลายที่อยู่ที่ผนังห้องปั๊กมีการหลุดออกมานำจะไปเกาะตัวอยู่ที่

บริเวณซองปล่อยสาร ได้ การทำความสะอาดทำได้โดยเพิ่มอุณหภูมิเตาไปมากกว่าค่าที่มากที่สุดที่จะใช้อยู่ประมาณ 50°C เช่นหากใช้ In สูงสุดที่ 670°C จะต้องเพิ่มอุณหภูมิเตาไปที่ 720°C เพื่อทำความสะอาดดีขึ้น รายละเอียดดังกล่าวจะถูกอธิบายไว้ในหัวข้อ 3.1.3.1

3.1.2.2 RHEED (Reflective High-Energy Electron Diffraction)

RHEED เป็นระบบตรวจวัดที่ใช้หลักการสะท้อน (Reflection) และเลี้ยวเบน (Diffraction) ของอิเล็กตรอนพลังงานสูง (High-energy electron) ระบบนี้ถูกติดตั้งภายในเครื่องปั๊กผลึกแบบคำไม้เลกุลเพื่อใช้สังเกตสถานการณ์ที่ผิวน้ำชั้นงานขณะดำเนินการปั๊ก และยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการวัดเที่ยบอัตราปั๊ก (Growth rate calibration) อิกตวย

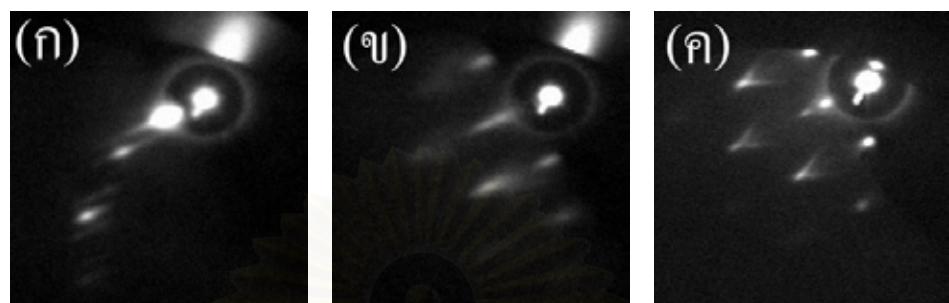


รูปที่ 3.6 แผนผังแสดงระบบ RHEED [3]

ระบบ RHEED ประกอบด้วยปืนยิงอิเล็กตรอนพลังงานสูง (High-energy electron gun) ในระดับ 10-30 kV [27] และจอฟอสเฟอร์ (Phosphor screen) [28] นิยมใช้ทั้งสแตนฟิลามนต์ (Tungsten filament) เป็นแหล่งกำเนิดอิเล็กตรอนที่ข้าวคาโทด (Cathode) เพราะว่าทั้งสแตนมีค่า Work function ต่ำ อิเล็กตรอนจึงถูกสกัดออกมาได้ง่าย เมื่ออิเล็กตรอนพุ่งมาที่ชั้นงานทำมุม Θ (มีค่าประมาณ 1° - 3°) ดังแสดงในรูปที่ 3.6 อิเล็กตรอนจะสะท้อนและเลี้ยวเบนผ่านช่องระหว่างระบบของอะตอมที่ผิวน้ำของชั้นงาน (อะตอมที่อยู่ลึกกว่าหน้าจอที่ไม่มีผลกับ RHEED) และสุดท้ายไปตกกรอบที่จอฟอสเฟอร์ ทำให้ภาพเปลี่ยนแปลงแสงออกมารูปภาพที่สืบสานสภาพผิวน้ำของชั้นงานในขณะนั้น [28]

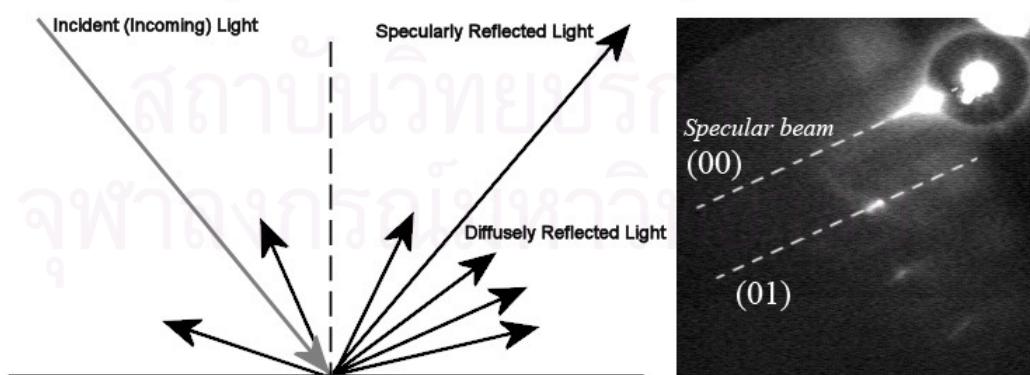
ภาพที่ปรากฏบนจอหน้าจอที่ไม่ได้สืบสานสภาพผิวน้ำทางกายภาพออกมารูปทรง (Real space) แต่เป็นภาพที่สืบสานความหมายโดยอ้อม เนื่องจากเป็นในมิติกลับ (Reciprocal space) ภาพที่เป็น

รูปแบบเฉพาะของ RHEED [28] ซึ่งต้องดีความหรือเปรียบเทียบก่อน จึงจะทราบได้ว่าสภาพผิวน้าเป็นอย่างไร ดังนั้นจะดำเนินการปลูกโครงสร้าง ผู้ดำเนินการจำเป็นต้องทราบว่า RHEED pattern ที่เห็นสะท้อนถึงสภาพผิวน้าที่แท้จริงอย่างไร



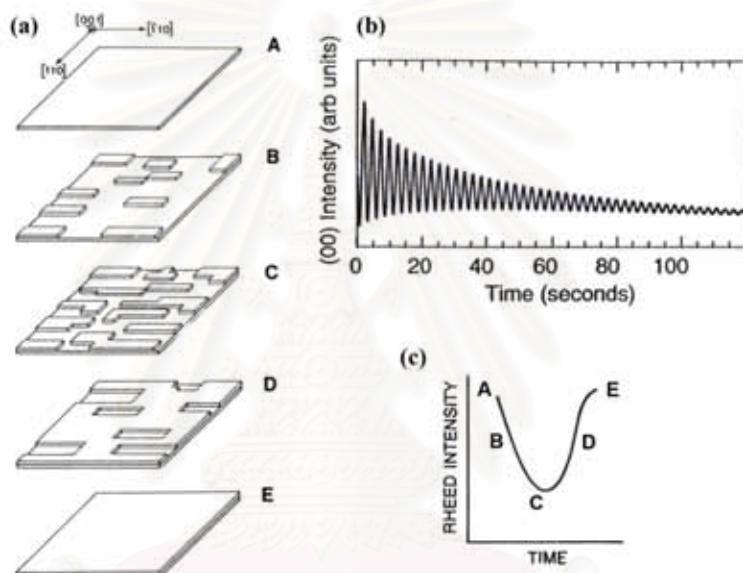
รูปที่ 3.7 RHEED pattern (ก) ผิวน้า GaAs ที่เรียบ (ข) ผิวน้าของแผ่นฐาน GaAs หลัง De-ox และ (ค) ผิวน้าของ InAs ควบคุมดอตบนแผ่นฐาน GaAs

RHEED pattern ที่มีประโยชน์มากที่สุดต่อการปลูกผลึกได้แก่ (ก) Streaky pattern ในรูปที่ 3.7 (ก) ซึ่งสื่อถึงผิวน้าขัณฑ์เป็น GaAs ที่เรียบ, Pattern ในรูปที่ 3.7 (ข) แสดงถึง pattern ที่เริ่มเกิดขึ้นเมื่อผิวน้ามีอุณหภูมิ 580°C ซึ่งก็คืออุณหภูมิที่ยกเท่าจาก $T_{\text{de-ox}}$ นั้นเอง pattern นี้ปรากฏเพียงครั้งเดียว เมื่อทำการกลบด้วย GaAs แล้วจะไม่ปรากฏขึ้นมาอีก และ (ค) Spotty pattern ในรูปที่ 3.7 (ค) ซึ่งสื่อถึงผิวน้าที่ไม่เรียบ เกิดเป็นเกาะสามมิติ และมี Chevron [1] แสดงถึงการมีอยู่ของควบคุมดอตบนผิวน้า ผู้ที่ดำเนินการปลูกเป็นประจำจะเป็นต้องคุ้นเคยกับ pattern เหล่านี้ เพื่อที่จะสามารถติดตามผลการปลูกได้ทันที



รูปที่ 3.8 (ซ้าย) Specular beam (ขวา) ตำแหน่งของ Specular beam บน RHEED screen เมื่อคำนวณยังมาทางทิศ [1-10]

ประโยชน์ของ RHEED นอกจากสามารถใช้ในการสานะของฟิล์มน้ำผึ้งได้แล้วยังสามารถใช้ในการปรับเทียบอัตราปลูก (Growth rate calibration) ได้ด้วย [29] โดยการสังเกตการสั่นของความเข้มของ RHEED (RHEED intensity oscillation) ซึ่งเป็นการสังเกตความเปลี่ยนแปลงของความเข้มของ RHEED ตรงตำแหน่ง Specular beam ดังแสดงในรูปที่ 3.8 เมื่อจาก Specular beam เป็นลำที่มาจากการสะท้อนลำอิเล็กตรอนโดยตรง ดังนั้นความเข้มที่ตำแหน่ง Specular beam จึงแสดงถึงความเรียบของผิวสะท้อน คือ ความสว่างของ Specular beam มาก หมายถึงผิวนี้ความเรียบมากนั่นเอง



รูปที่ 3.9 ความสัมพันธ์ของลักษณะผิวหน้าและ RHEED oscillation (a) การก่อตัวของ GaAs บน GaAs (001) 1 ML จาก A ไป E (b) การสั่นของความสว่างของ Specular beam (00) ขณะทำการปลูก GaAs บนแผ่นฐาน GaAs (100) (c) ความสว่างของ Specular beam กับการก่อตัวของผิวใน (a) [29]

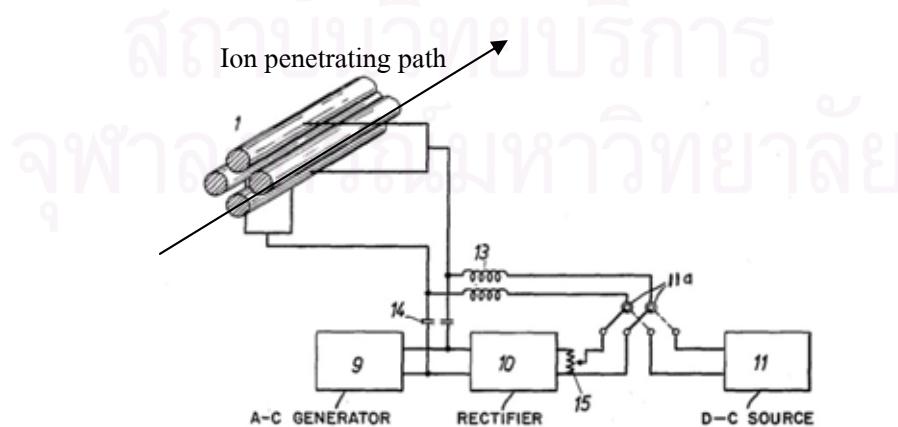
การปรับเทียบอัตราปลูกของ GaAs บนแผ่นฐาน GaAs (001) ใช้หลักการข้างต้นที่กล่าวไว้ คือการสังเกตการสั่นของความเข้มของ Specular beam เริ่มต้นด้วยแผ่นฐานตั้งต้น GaAs ที่เรียบดังแสดงในรูปที่ 3.9 (a) (จุด A) ความเข้มของ Specular beam จะสูงที่สุดดังแสดงในรูปที่ 3.9 (c) (จุด A) เมื่อเริ่มให้ GaAs ก่อตัวขึ้นบนแผ่นฐานดังกล่าว จาก GaAs ที่ก่อตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผิวหน้าขบวนที่ GaAs กำลังก่อตัวแต่ยังไม่เต็มแผ่นนั้นไม่เรียบดังแสดงในรูปที่ 3.9 (a) (จุด B, C และ D ตามลำดับ) เนื่องจากผิวสะท้อนไม่เรียบ Specular beam จะเข้มน้อยลง เพราะว่ามี Diffusion มาก

จากผิวน้ำที่บูรณะ ดังแสดงในรูปที่ 3.9 (c) (จุด B, C และ D ตามลำดับ) เมื่อ GaAs เกาะจนเต็ม แผ่น ทำให้ผิวน้ำกลับมาเรียบเหมือนเดิมอีกครั้ง Specular beam ก็จะกลับมาเข้มอีกครั้ง แสดงว่า ได้มีการก่อตัวของ GaAs ครบ 1 ML พอดี ดังนั้นหากทำการจับเวลาและนับจำนวนรอบของการสั่น ของความเข้ม จะทำให้สามารถหาค่าอัตราปลูกในหน่วย ML/s ได้ อย่างไรก็ตามประโยชน์ของ RHEED ต่อการปรับเทียบอัตราปลูกของ InAs บน GaAs นั้นยังสามารถทำได้ เช่นกัน เพียงแต่จะใช้ วิธีการปรับเทียบโดยการจับเวลาการเกิด Spotty pattern แทนการสังเกตจากการสั่นของความเข้ม ของ Specular beam

3.1.2.3 Quadrupole mass spectrometer

Quadrupole mass spectrometer หรือเครื่องวิเคราะห์มวล ทำให้ทราบได้ทันทีว่ามีสารใดอยู่ ภายในห้องปลูกบ้าง (ในสถานะก๊าซ) ดังนั้นมีอนุภาคของสารที่ไม่ต้องการ เช่น Oxide หรือ สาร อื่นที่อยู่ในเบ้าร่วมกับสารที่จะสามารถทราบได้ทันที และดำเนินการแก้ไขต่อไป

ด้านในการทำงานของเครื่องวิเคราะห์มวลมี Quadrupole mass analyzer ดังแสดงในรูปที่ 3.10 ประกอบไปด้วยแท่งโลหะที่วางห่างกันและขนานซึ่งกันและกันสี่แท่ง (Quadrupole) โดยจะ จ่ายแรงดันไฟฟ้าคลื่นความถี่วิทยุ (R.F. Voltage) ชี้ไปบน (Superimpose) สัญญาณกระแสตรงทำ ให้เกิดการสั่นของสนามไฟฟ้าในช่องระหว่างห่างแท่งโลหะทั้งสี่ เมื่อมีอนุภาคผ่านเข้ามา จะเกิดการ สั่นตามสนามไฟฟ้าที่สั่นจากแท่งหักสี่ด้วยค่า Mass-to-charge ratio ที่ต่างกัน อนุภาคที่สั่นเข้ากับ ความถี่ที่ใช้ได้อย่างมีเสถียรภาพเท่านั้นที่จะสามารถเดินทางพ้นจากแท่งหักสี่ตรงไปสู่ Detector ได้ อนุภาคอื่นๆ ก็จะสั่นอย่างไม่มีเสถียรภาพและเดินทางจะไม่ตรงไปสู่ Detector



รูปที่ 3.10 แผนภาพการทำงานของ Quadrupole mass analyzer [30]

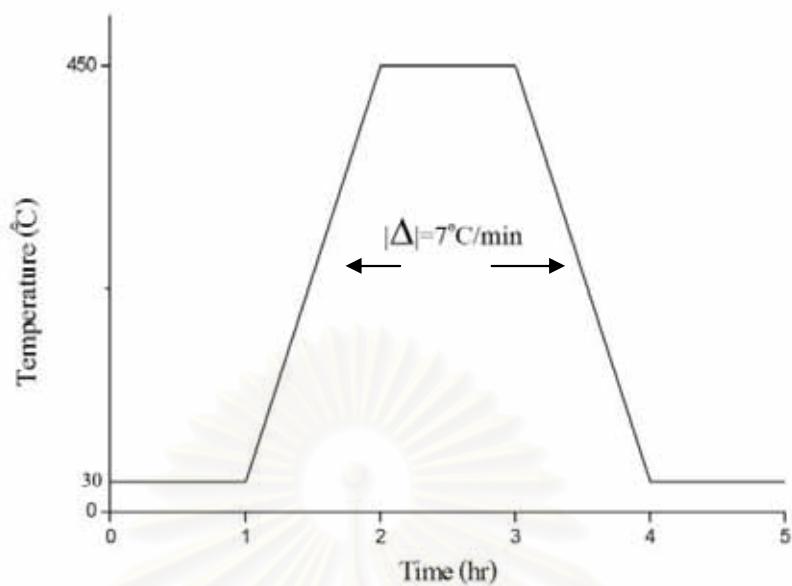
การเปลี่ยนความถี่ของแรงดันที่จ่ายไปอย่างต่อเนื่อง มีผลให้มวลของอนุภาคที่สามารถเดินทางเลี้กลดลง Quadrupole "ไปสู่" Detector ได้เปลี่ยนแปลงไปด้วย ดังนั้นหากนำผลการตรวจจับด้วย Detector มาเป็นแกนตั้ง (Y-axis) และค่ามวล (ที่หาได้จาก Mass-to-charge ratio) ซึ่งสัมพันธ์กับค่าความถี่ของแรงดันมาเป็นแกนนอน (X-axis) สุดท้ายก็จะได้เป็นผลการตรวจจับมวลแบบ gwad ขึ้นทางจอแสดงผล จุดยอด ณ ค่ามวลต่างๆ สามารถชี้ได้ว่าในห้องปลูกมีองค์ประกอบของสาร ไดอิย์ เช่น ถ้าค่าออดอิย์ที่ 28 หมายความว่ามี CO (Carbonmonoxide) หรือค่าออดที่ 75 หมายความว่ามี As_4

3.1.3 กระบวนการปลูก

กระบวนการปลูกที่จะกล่าวถึงในหัวข้อนี้ครอบคลุมตั้งแต่การเตรียมชิ้นงานก่อนที่จะเข้าสู่ห้องปลูก การเตรียมผิวน้ำให้เรียบในห้องปลูก กระทั่งเสร็จสิ้นกระบวนการปลูก ขั้นตอนต่างๆ ระหว่างดำเนินการปลูกควรทำด้วยความระมัดระวัง เพราะหากมีความผิดพลาดเกิดขึ้น ความแม่นยำของค่าตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ในการปลูก เช่น อุณหภูมิเตา แรงดันไออก ฯลฯ จะต่ำลง และทำให้ผลที่ได้คลาดเคลื่อน นอกจากนี้ยังอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ดำเนินการได้ หากมีสารพิษร้ายๆ หลอกอุกมาหรือเครื่องปลูกหลักอาจมีความเสียหายได้

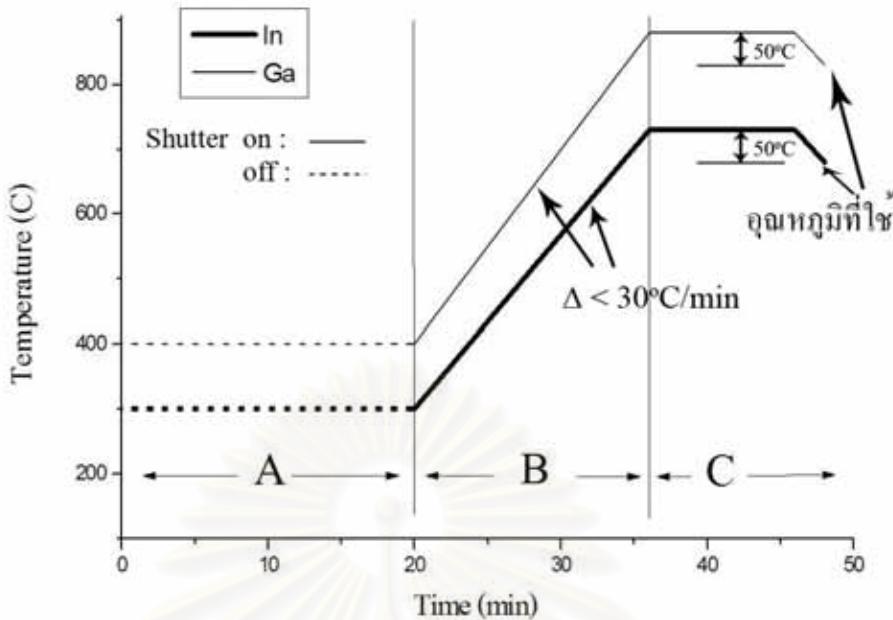
3.1.3.1 การเตรียมผิวน้ำ

ก่อนชิ้นงานจะเข้าสู่ห้องปลูก จะต้องผ่านกระบวนการการกำจัดอนุภาคสิ่งแปลกปลอมต่างๆ และไอน้ำก่อน เพื่อให้ได้ผิวน้ำชิ้นงานที่มีคุณภาพและมีความบริสุทธิ์ กระบวนการแรกที่จะต้องทำก่อนก็คือการทำ Pre-heat หรือ Heat treatment ณ ห้องอินโตรดักชัน



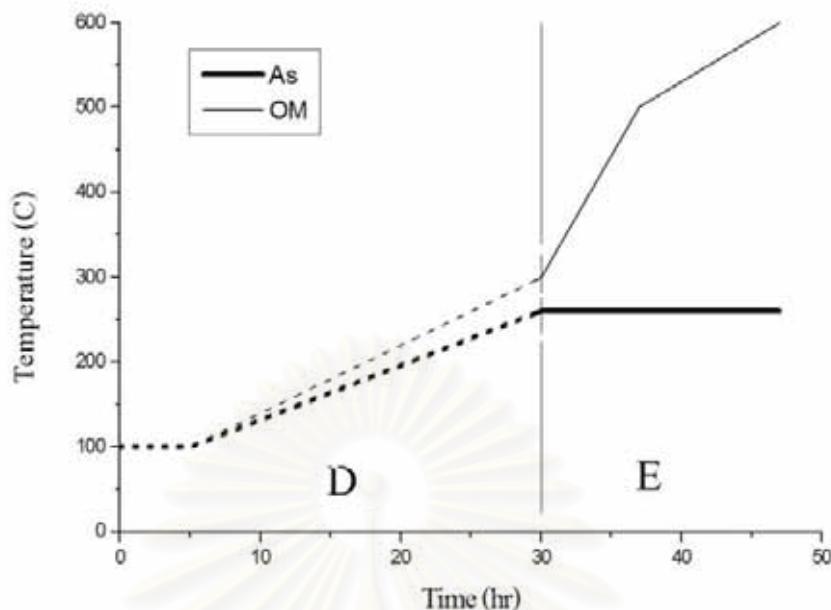
รูปที่ 3.11 Profile ของโปรแกรมอัตโนมัติของกระบวนการ Heat treatment (Pre-heat)

การทำ Heat treatment นั้นจะมีรูปแบบการปรับอุณหภูมิตามรูปที่ 3.11 ซึ่งอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมนี้ติดตั้งอยู่ห้องอินไทร์ดักชัน ก่อนที่จะเริ่มทำ Heat treatment ต้องแน่ใจก่อนว่าความดันภายในห้องอินไทร์ดักชันอยู่ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 5×10^{-8} Torr เพื่อป้องกันการล้มเหลวของระบบดูดอากาศออกเมื่อดำเนินการการทำ Heat treatment ไปแล้ว เมื่อความดันตรงเงื่อนไขแล้ว ก็เริ่มโปรแกรมอัตโนมัติโดยเริ่มขึ้นจากอุณหภูมิตั้งต้นที่ 30°C และใช้เวลา 1 ชั่วโมงในการเพิ่มอุณหภูมิขึ้นอย่างสม่ำเสมอด้วยอัตราการเพิ่มคงที่ ไปหยุดที่อุณหภูมิสูงสุด คือ 450°C และถ้าหากที่ค่านี้เป็นเวลา 1 ชั่วโมง หลังจากนั้นก็ทำการลดอุณหภูมิลงกลับสู่อุณหภูมิปกติ ด้วยเวลาและอัตราที่เท่ากับตอนที่เพิ่ม เมื่อผ่านกระบวนการนี้ไปแล้ว สิ่งแปรผลลัพธ์พิเศษของชิ้นงานจะหลุดออก ทั้งไอน้ำ และอนุภาคต่างๆที่เป็นสิ่งปลอมปน แล้วสิ่งแปรผลลัพธ์ที่หลุดออกมาก็ถูกดูดออกไปด้วยระบบดูดอากาศภายในห้องอินไทร์ดักชันที่ทำงานตลอดเวลา อย่างไรก็ตามชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการนี้จะยังไม่สามารถกำจัด Oxide ออกไปจากพิเศษได้ ซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการ De-ox (Oxide Desorption) ในห้องปฏิกริยาที่เป็นกระบวนการกำจัด Oxide ก่อนปฏิกริยาสร้างที่ต้องการ แต่ก่อนทำการ De-ox จะต้องทำการ De-gas เชลด์ก่อน



รูปที่ 3.12 Profile ของกระบวนการ De-gas เซลล์ In และ Ga

กระบวนการ De-gas เป็นการทำความสะอาดเซลล์เพื่อให้อุณภูมิสูงสุดของไปก่อนที่จะใช้งานเซลล์นั้นๆ โดย Profile ของการ De-gas เซลล์ In และ Ga (กล่าวเฉพาะที่ใช้ในการปลูกชิ้นงานสำหรับศึกษาภายในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้) ถูกแสดงในรูปที่ 3.12 โดยในช่วงเวลา A เซลล์ทั้งสองถูกปิดอยู่ และอุณหภูมิอยู่ที่อุณหภูมิกึ่งรักษา ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มีการปล่อยไนโตรเจนเหลวเข้าสู่ระบบเพื่อลดอุณหภูมิพังและส่วนต่างๆภายในห้องปลูก ทำให้อุณภูมิต่างๆ ไม่หลุดออกมากเมื่อเซลล์แต่ละช่องถูกเพิ่มอุณหภูมิ ช่วงเวลา B จะเริ่มเปิดม่านชัตเตอร์ของเซลล์และเริ่มเพิ่มอุณหภูมิขึ้นเรื่อยๆ ด้วยอัตรา $30^{\circ}\text{C}/\text{min}$ ไปจนมากกว่าค่าสูงสุดที่จะใช้จริง 50°C ต่อมาที่ช่วงเวลา C ที่ไว้ประมาณ 10 นาทีเพื่อให้อุณภูมิเปลกปลอมต่างๆ หลุดออก จากนั้นก็ลดอุณหภูมิลงสู่ค่าที่ต้องการใช้ และปิดม่านชัตเตอร์ของเซลล์ลง แล้ววัดแรงดันไออกของอัตราปลูกที่ใช้ทุกค่าของ In และ Ga ก่อนการ De-ox



รูปที่ 3.13 Profile ของกระบวนการ De-ox ที่รวมขั้นตอนการวัดแรงดันไอของ As_4 ด้วย

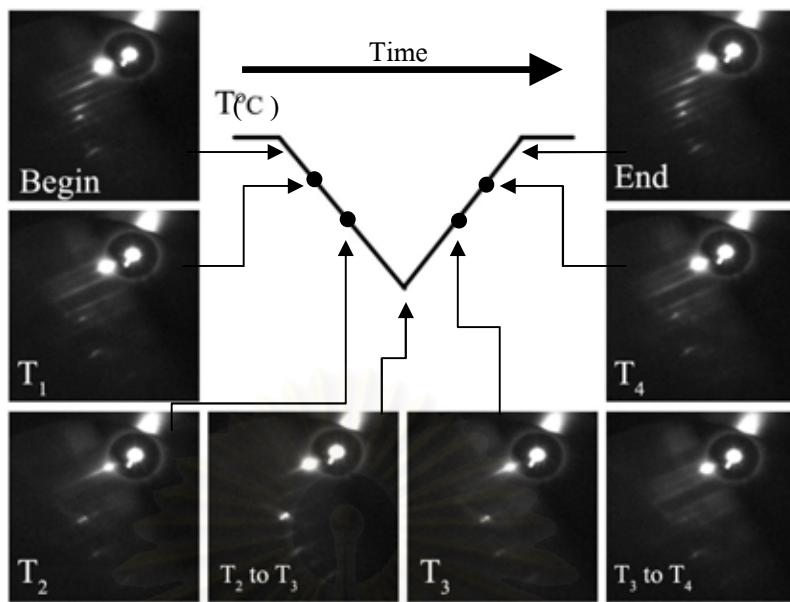
กระบวนการ De-ox ในห้องปั๊ก เริ่มจากการใส่ MO Block ที่ติดชิ้นงานแล้ว เข้าที่แท่นสำหรับใส่ส่วนล็อก ทำการ De-gas เชลด์ที่จะใช้ในการปั๊กโครงสร้างและทำการวัดแรงดันไอสำหรับการปั๊กทุกค่า รวมทั้ง As_4 ดังที่อธิบายไปข้างต้น จากนั้นสามารถเริ่มกระบวนการ De-ox ได้เลย เพราะว่าก่อนจะทำการ De-ox ชิ้นงานจะถูกให้ความร้อนสูงประมาณ 600°C (อุณหภูมิเทียบเท่าที่ผิวน้ำ ซึ่งจะแตกต่างจากที่วัดได้จากคู่ความความร้อน (Thermocouple)) หากไม่ทำให้สภาพแวดล้อมบริเวณนี้มีไอ As_4 กดไว้ ผิวน้ำของชิ้นงานจะเสียหายจากการหลุดออกของ As ไอออนไลน เมื่อเปิมม่านชัตเตอร์ของเชลด์ As ค่าความดันไอจะไม่เข็นสูงกว่าใช้งานทันที แต่จะเข็นมากกว่า เชลด์ In และ Ga รวมทั้งเวลาเปิมม่านชัตเตอร์ของเชลด์แล้ว ไอของ As_4 ก็จะยังฟุ้งอยู่ภายในห้องปั๊กอยู่ระยะหนึ่ง นี่เป็นเหตุผลที่ As_4 ถูกวัดแรงดันไอเป็นอันดับสุดท้าย และด้วยข้อจำกัดด้านอัตราการเพิ่มอุณหภูมิจากอุณหภูมิเก็บรักษา (Stand-by temperature) ของเชลด์ As_4 ที่อัตรา $5^\circ\text{C}/\text{min}$ (เทียบกับ $30^\circ\text{C}/\text{min}$ ของ In และ Ga) เพื่อเป็นการประหยัดเวลา จึงได้รวมเอากระบวนการวัดแรงดันไอ As_4 ควบคู่ไปกับกระบวนการ De-ox

รูปที่ 3.13 แสดงให้เห็นถึง Profile ของการเพิ่มอุณหภูมิของชิ้นงานจากอุณหภูมิเก็บรักษาที่ 100°C ไปจนถึง 300°C ตรงจุดนี้จะทำการหยุดโปรแกรมชั่วคราว (Hold) เพื่อวัดแรงดันไอ BEP (Beam Equivalent Pressure) As_4 ซึ่งจะต้องมีค่าระหว่าง 15 ถึง 25 เท่าของค่าแรงดันไอที่มากที่สุด

ของดำเนินการหลักของชาตุหมู่ III (ทั้ง In และ Ga รวมกัน) โดยแรงดันไออกซ์ของ Ga สูงสุดจะเกิดในขณะทำการปั๊กชั้น Buffer ที่อัตรา 0.6 ML/s ดังนั้นแรงดันไออกซ์ของ As_4 ที่วัดได้จึงต้องมีค่าอ้างอิงจากอัตราปั๊ก GaAs buffer ทุกรั้ง หลังจากนี้ก็ให้ปีกม่านชัตเตอร์ของเซลล์ของ As_4 ทิ้งไว้ตลอดจนจบการปั๊ก อันเนื่องมาจากชิ้นงานระหว่างทำการปั๊กมีอุณหภูมิสูงมากหากไม่มี As_4 อยู่ในบรรยายกาศตลอดเวลา มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ที่ As^{+3} ภายในผลึก GaAs ของสารตั้งต้น (แผ่นฐาน) หลุดระเหยออกจากผิวน้ำเป็น As_4 ทำให้ผลึก GaAs ที่ผิวน้ำเสียหาย เกิดเป็นฝ้าที่ผิวน้ำสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าเมื่อนำชิ้นงานออกจาก เรียกลักษณะผิวน้ำดังกล่าวว่า Gallium rich [28,31] เมื่อเพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปเกิน $500^{\circ}C$ ก็ให้เริ่มลดอัตราการเพิ่มอุณหภูมิลงเพื่อจะได้สามารถหาอุณหภูมิอ้างอิงของ T_{de-ox} (Oxide Desorption Temperature) ได้ทัน (เทียบเท่าอุณหภูมิผิวน้ำที่ $580^{\circ}C$) จากนั้นให้เพิ่มอุณหภูมิไปต่อจากค่า T_{de-ox} อีกประมาณ $30^{\circ}C$ แล้วทิ้งอุณหภูมิก้างไว้ที่ค่าดังกล่าวประมาณ 15-20 นาที แล้วร่องกระถังปริมาณ CO ลดลงจนกระถังอิ่มตัวที่ก่าพื้นหลัง โดยตรวจดูได้จาก QMS ที่ค่าจุดยอด 28 ซึ่งปริมาณ CO ที่วัดได้นั้นบ่งบอกถึงปริมาณ Oxide ภายในห้องปั๊กทั้งหมด ซึ่งก็รวมไปถึงที่หลุดออกจากผิวน้ำชิ้นงานด้วยเช่นกัน เมื่อผิวน้ำมีปริมาณ Oxide ลดลงจนแทบจะไม่เหลือแล้ว (ตรวจดูได้จาก QMS เช่นกัน) ก็ให้ทำการลดอุณหภูมิกลับมาที่ค่า T_{de-ox} เพื่อเตรียมทำการปั๊กชั้น Buffer layer ในขั้นต่อไป

ที่ต้องหาอุณหภูมิเทียบเท่าผิวน้ำนั้น ก็ เพราะว่าที่ผิวน้ำเป็นบริเวณของชิ้นงานที่เกิดการปั๊กชั้นผลึก ซึ่งอุณหภูมิผิวน้ำจะมีผลมากต่อเวลาปั๊กชั้นที่มี In เนื่องจาก In จะหลุดออกจากผิวน้ำเร็วกว่า Ga ที่อุณหภูมิเท่ากัน ดังนั้นจึงมีกระบวนการที่ใช้อ้างอิงอุณหภูมิผิวน้ำกับอุณหภูมิที่ได้จากคู่ควบอุณหภูมิ (Thermocouple) ระหว่างการปั๊กถึง 2 ครั้ง คือตอนหา T_{de-ox} จะเทียบเท่าอุณหภูมิผิวน้ำที่ $580^{\circ}C$ และตอนหา Pattern Transition อุณหภูมิ T_{trans} เทียบเท่าที่ผิวน้ำเป็น $500^{\circ}C$

หลังจากผ่านกระบวนการ De-ox แล้วและ Oxide ออกจากผิวน้ำชิ้นงานจนผิวน้ำมีปริมาณ Oxide ลดลงไปมาก แต่ละผิวน้ำจะมีจังหวะที่เรียบกว่าที่อุณหภูมิสูงกว่า T_{deox} ผิวน้ำจะเกิดความเสียหายบางส่วน ทำให้ไม่เรียบ ดังนั้นเพื่อให้ได้ผิวน้ำที่เรียบ ต้องทำการปั๊กชั้น Buffer ทับก่อน ซึ่ง Buffer ก็คือชั้นกลบทับที่เป็นสารชนิดเดียวกับแผ่นฐาน มีชั้น Buffer หนา $300 nm$ ที่ปั๊กที่อุณหภูมิผิวน้ำ $580^{\circ}C$ (เท่ากับ T_{de-ox})



รูปที่ 3.14 แผนภาพแสดง RHEED pattern ณ อุณหภูมิ T_1 - T_4 สำหรับการหา T_{trans}

อุณหภูมิผิวหน้าของขั้นงานที่วัดค้างคู่ความร้อนไม่สามารถใช้ระบุเป็นอุณหภูมิจิงที่ผิวหน้า ณ ขณะนี้ได้ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น T_{deox} ที่หาในขั้นตอนที่ผ่านมาอาจไว้เทียบเท่ากับอุณหภูมิผิวหน้าที่ 580°C สำหรับอุณหภูมิอิกค่าที่ใช้เทียบเท่ากับอุณหภูมิจิงที่ผิวหน้าคือ T_{trans} (Transition temperature) ซึ่งจะเทียบเท่ากับ 500°C ขั้นตอนการหา T_{trans} จะแทรกอยู่ระหว่างการปั๊กชั้น Buffer โดยให้ทำการแบ่ง Buffer เป็นสองช่วง (หรือสามช่วงหากมีการปรับเทียบอัตราปั๊กด้วย) Buffer ช่วงแรก (150 nm) จะใช้กลบทับผิวหน้าหลังจากกระบวนการ De-ox ให้เรียบก่อน จากนั้นให้เริ่มทำการหา T_{trans} โดยสังเกตสภาพผิวหน้าจาก RHEED pattern ก่อยาคดและเพิ่มอุณหภูมิจนเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลง RHEED pattern ตามลำดับในรูปที่ 3.14 จากนั้นนำค่า T_1 - T_4 มาหาค่าเฉลี่ย เป็นค่า T_{trans} ในที่สุด สุดท้ายก่อนไปปั๊กชั้นตอนต่อไปในการปั๊กโครงสร้าง ผิวหน้าจะถูกกลบด้วยชั้น Buffer อิกครั้งหนึ่ง (150 nm) เพื่อให้ได้ผิวหน้า GaAs ที่เรียบ

3.1.3.2 การปั๊กชั้นผลึก

ชั้นผลึกที่เกิดขึ้นจากการปั๊กโครงสร้างด้วยเครื่องปั๊กผลึกแบบล้ำโนเลกูลในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เน้นไปที่สารประกอบหมู่ III-V สามชนิด คือ Ga, In และ As ซึ่งสามารถสร้างเป็นชั้นสารประกอบ GaAs, InAs, และ InGaAs ได้ โดยจะจำแนกออกเป็นกลุ่มจากลักษณะการเกิดชั้นผลึกได้ 4 กลุ่ม ได้แก่ ก) ชั้นผลึกแบบก้อนผลึก ข) ชั้นควบคุมด้วย ค) ชั้นลายตาราง และ ง) ชั้นกลบทับด้วยรายละเอียดต่อไปนี้

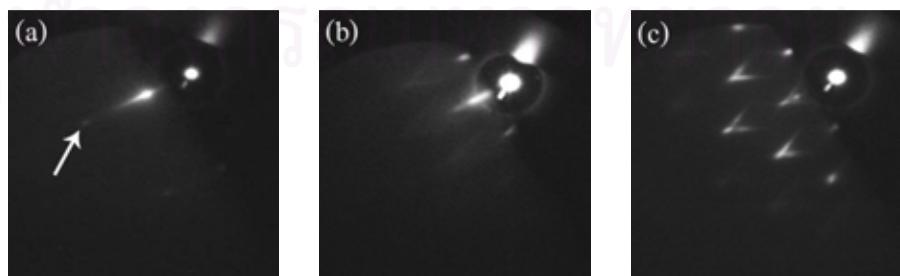
ก. ชั้นผลึกแบบก้อนผลึก

ชั้นผลึกแบบก้อนผลึก (Bulk) เป็นชั้นผลึกที่มีความหนาและมีการก่อตัวเป็นโครงผลึกที่ใหญ่ ชั้น Buffer ของ GaAs บนแผ่นฐาน GaAs สามารถจัดอยู่ในจำพวกก้อนผลึกได้ เนื่องจากมีความหนาถึง 300 nm ชั้นที่ปลูกจึงมีคุณสมบัติเหมือนกับก้อนผลึก GaAs การปลูกชั้น Buffer ของ GaAs บนแผ่นฐาน GaAs ทำได้โดยการปล่อยไอของ Ga ออกจากเชลล์ ภายใต้บรรยากาศของ As_4 เนื่องจากกระบวนการเกิดภายในเชลล์ที่มีผิวน้ำของชิ้นงานจะถูกกดด้วย As_4 เป็นสเมื่อนชั้นบนสุดของผิวน้ำขณะนี้ เมื่อ Ga ที่ปล่อยมาจากเชลล์มาถึงผิวน้ำชิ้นงาน ก็จะเกิดพันธะกันเป็น GaAs ใหม่เกาะกับผลึก GaAs เดิมบนแผ่นฐานอย่างไรก็ตาม ด้วย Mean free path ที่มาก ทำให้ไอสารที่ปล่อยออกมานั้นจะไม่ทำปฏิกิริยากันจนกว่าจะถึงผิวน้ำของชิ้นงาน ซึ่งหากอนุภาคยังคงมีพลังงานสูงอยู่ก็จะวิ่งไปชนกับอะตอมหรือไม่เลกูลอื่นๆบนผิวน้ำได้อีก จนกว่าจะหยุดและเกาะตัวกันเป็นผลึก

ข. ชั้นความตั้มดอต

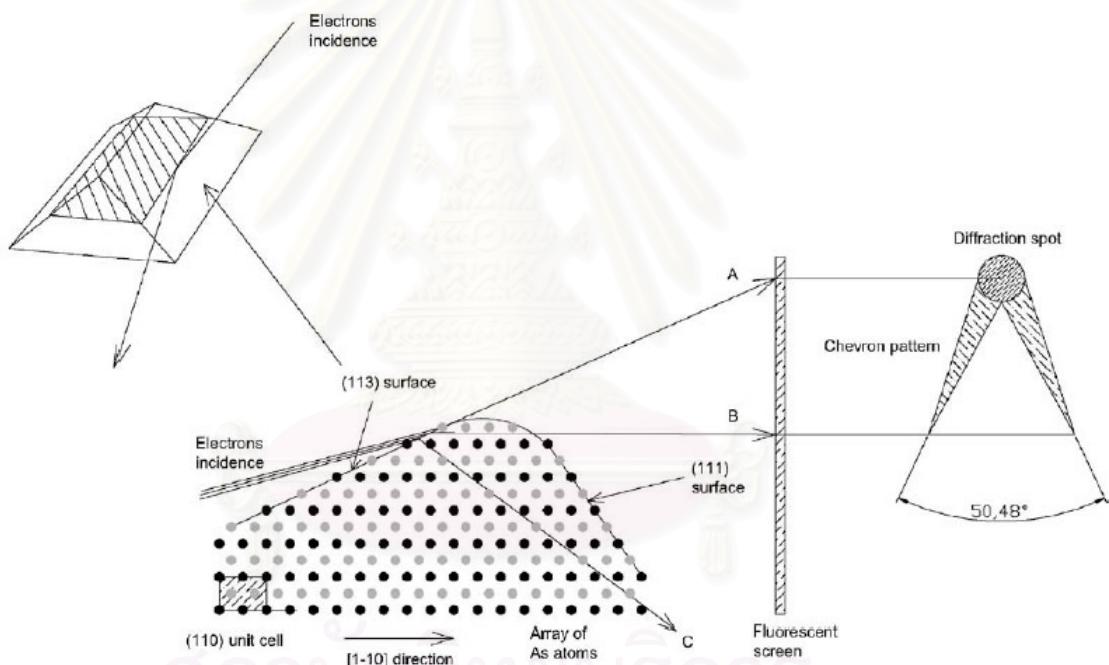
ชั้นความตั้มดอตสามารถเกิดขึ้นบนผิวน้ำที่ทำการปลูกได้ด้วยการทำหนดเรื่องในการปลูกที่ทำให้ E และ H อยู่ในช่วง SK_1 หรือ SK_2 ตามแผนภาพสภาวะสมดุลในรูปที่ 2.1 ซึ่งในที่นี่จะให้ความสำคัญกับรูปแบบการเกิดชั้นความตั้มดอตในโหมด SK_1

การเกิดความตั้มดอตแบบ SK_1 ต้องมี Wetting layer หนาประมาณหนึ่งก้อน ความตั้มดอตจะเริ่มก่อตัวตามขึ้นมา [1] ในแต่ละเรื่องของการปลูกแต่ละครั้ง จะมีความหนาของ Wetting layer ที่แน่นอนที่เป็นขอบเขตก่อนที่จะเกิดการก่อตัวเป็นความตั้มดอต กระบวนการหั่นหนดสามารถดีความได้จากภาพบน RHEED screen



รูปที่ 3.15 ภาพจาก RHEED screen ขณะปลูกความตั้มดอต InAs บนแผ่นฐานลายตาราง $In_{0.15}Ga_{0.85}As/GaAs$ (a) เมื่อเริ่มเกิดความตั้มดอต (b) เกิดความตั้มดอตแล้ว (c) Chevron pattern

การสังเกตุการเกิดความตั้มดอตบนลายตาราง InGaAs/GaAs และบนแผ่นฐาน GaAs นั้นคล้ายกัน คือให้สังเกตุการเปลี่ยนแปลง RHEED pattern จาก Streaky pattern ไปเป็น Spotty pattern โดยจุดที่บอกว่าความตั้มดอตกำลังก่อตัวขึ้นมาคือในรูปที่ 3.15 (a) ตรงที่ลูกศรชี้ ซึ่งอยู่ในแนวเดียวกับ Specular beam จะเริ่มมีจุดสว่างขึ้นมา แสดงว่าความตั้มดอตเริ่มเกิดขึ้นบนผิวน้ำแข็งงานแล้ว หากปลูกความตั้มดอตต่อไป ความตั้มดอตจะมีขนาดใหญ่ขึ้นและปริมาณเพิ่มขึ้นซึ่งมีผลต่อลักษณะ RHEED pattern รวมของผิวน้ำแข็งน้ำมากขึ้นในรูปที่ 3.15 (b) และ Chevron pattern จะขึ้นชัดดังในรูปที่ 3.15 (c) แสดงถึงการมีความตั้มดอตอยู่มากบนผิวน้ำ อย่างไรก็ตามการสังเกตุลักษณะของ Chevron pattern ยังสามารถออกถึงลักษณะทางกายภาพของความตั้มดอตได้ด้วยมุมหน้าจั่วของ Chevron pattern ดังแสดงในรูปที่ 3.16 [32,33]



รูปที่ 3.16 ความสัมพันธ์ของ Chevron pattern ต่อลักษณะทางกายภาพของความตั้มดอต [33]

ความตั้มดอตที่ปลูกในการทดลองภายใต้หัวข้อวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นความตั้มดอต InAs ทั้งหมด แต่ด้วยชั้นที่เป็นฐานแตกต่างกัน มีผลทำให้ความหนาเที่ยบท่าของ InAs มีความเปลี่ยนแปลง หากปลูกชั้นความตั้มดอต InAs ลงบนแผ่นฐาน GaAs ธรรมชาติ จะต้องปลูกด้วยความหนาเที่ยบท่า ~1.8 ML [1] จึงจะเกิดความตั้มดอต แต่หากปลูกบนแผ่นฐานลายตาราง $In_{0.15}Ga_{0.85}As$ หนา 50 nm จะต้องปลูกเพียงแค่ความหนาเที่ยบท่า ~0.9 ML [3] เท่านั้น

ค. ชั้นลายตราง

ชั้นลายตาราง (Cross-hatch layer) เป็นชั้นที่เกิดจากการปัลกชั้นผลึกซึ่งมีค่าคงที่ผลึกแตกต่างจากสารที่เป็นแผ่นฐานตั้งต้น (Substrate) ไม่มาก โดยค่าของ ϵ อยู่ในขอบเขตที่ทำให้เกิดเป็นชั้นผลึกแบบสองมิติ หรือรูปแบบ FM ดังนั้นชั้นผลึกที่เกิดขึ้นจึงยังคงรูปเป็นชั้นผลึกแบบสองมิติอยู่เหมือนเดิม

ความเครียดที่เกิดจากการเกาส์กันด้วยค่าคงที่ผลึกที่ต่างกันไม่มาก แม้ว่าจะไม่พอที่ทำให้เกิดการสามมิติได้ แต่ว่าความเครียดในชั้นผลึกที่สะสมมากขึ้นตามความหนาที่เพิ่มขึ้น เป็นผลให้ผลึกเกิด Dislocation เพื่อลดความเครียดสะสม โดยสำหรับผลึกตระกูล Zincblend จะเกิด Dislocation ง่ายที่สุดในทิศ [1-10] และ [110] เป็นต้นเหตุของการเกิดลายตาราง ดังรายละเอียดในบทที่ 2

กระบวนการปัลกูชั้นลายตารางของ InGaAs บน GaAs ใช้วิธีการปิดม่านชั้ตเตอร์ของเซลล์ In และ Ga พร้อมกันภายใต้บรรยายกาศของ As_4 ทำให้เกิดเป็นชั้น InGaAs ขึ้นมา แต่อัตราส่วนของ In ไม่ควรมีค่ามากเกินค่าวิกฤติค่าหนึ่งคือ 20 % ซึ่งจะทำให้ชั้น InGaAs ไม่เกิดอยู่ภายใต้เงื่อนไข Low lattice mismatch ซึ่งมี $\epsilon < 1.5 \%$ [24]

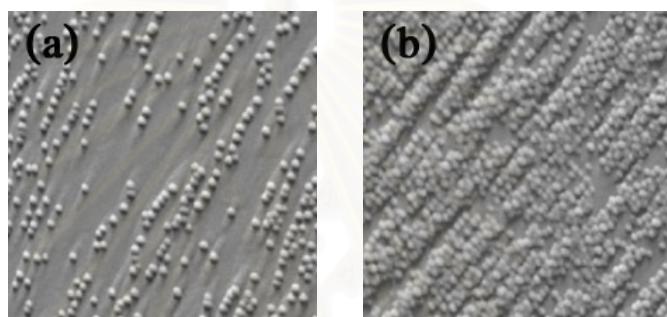
เมื่อได้ความหนาตามที่ต้องการแล้ว (จากการคำนวณ) ให้ปิดม่านชั้ตเตอร์ของเซลล์ In และ Ga ทันที ส่วน As ให้เปิดทิ้งไว้ตามปกติ ก็จะได้ผิวน้ำที่เป็นชั้นลายตารางตามที่คำนวณไว้

การสังเกตุชั้นลายตารางคุณภาพดู RHEED screen พบว่ามีความแตกต่างจาก Streaky pattern ของ GaAs ที่เรียบไม่นักนัก และเนื่องจากการปลูกชั้นลายตารางต้องคำนึงความหนาและเวลาการเผาต่อร่องเชลล์ In และ Ga ไว้แน่นอนแล้ว ดังนั้นการสังเกตุ RHEED ของแผ่นฐานลายตารางจึงไม่มีนัยสำคัญเท่ากับตอนปลูกควรต้มดอต

การปรับแต่งชั้นลายตารางสามารถกระทำได้หลายวิธี เช่น การปรับอัตราส่วน In / Ga [3], ความหนา [3], และอุณหภูมิแผ่นฐานของปัลกชั้นลายตาราง [12,16] ผลการปรับแต่งจะอธิบายในบทที่ 4

๔. ชั้นกลบทับ

ชั้นกลบทับ (Capping layer) ถูกใช้เพื่อจุดประสังค์สองอย่างคือ เพื่อกลบทับชั้นบนสุดของโครงสร้างเพื่อกำจัดสถานะที่ผิว (Surface states) ซึ่งคล้ายกับกับดัก (Trap) ที่ทำให้เกิดการรวมตัวของพาหะแบบไม่เปล่งแสง (Non-radiative recombination) ดังนั้นชั้นกลบทับจะจำเป็นสำหรับขั้นตอนที่ต้องการปลูกเพื่อวัดผลการเปล่งแสง อีกจุดประสังค์หนึ่งคือใช้สร้าง Nanohole สำหรับเป็น Template ในการปลูกโครงสร้างที่ซับซ้อนขึ้น เช่น โครงสร้างความตั้มดอตหนาแน่นสูง (High density quantum dots) หรือความตั้มดอตโมเลกุล (Quantum dots molecule) [9,34] เป็นต้น



รูปที่ 3.17 การกลบทับแบบบางสำหรับปลูกโครงสร้างความตั้มดอตหนาแน่นสูง (a) กลบทับแบบบางและปลูกชำ้ำด้วยความหนา 0.6 ML 3 ครั้ง (b) กลบทับแบบบางและปลูกชำ้ำด้วยความหนา 0.6 ML 4 ครั้งแรกและ 1.2 ML ครั้งสุดท้าย [34]

การกลบทับแบบบาง (Thin capping) ทำให้ความตั้มดอตที่ถูกกลบทับเกิดการเปลี่ยนรูปร่างโดยแนวโน้มคือ เป็นเนินขึ้นตัวยาวขึ้นไปในทิศ [1-10] มีรูปร่างคล้ายอูฐ (Camel-like shape) และมีหลุมขนาดเล็กตรงกลาง (Nanohole) เมื่อทำการปลูกความตั้มดอตทับอีกครั้งจะได้เป็น Nanopropeller เมื่อเพิ่มจำนวนชั้นไปอีก 3-5 ครั้ง และปลูกความตั้มดอตครั้งสุดท้ายที่ความหนามากกว่าชั้นอื่นๆ โครงสร้างที่ได้เป็นกลุ่มความตั้มดอตหนาแน่นสูงจะเป็นโมเลกุล

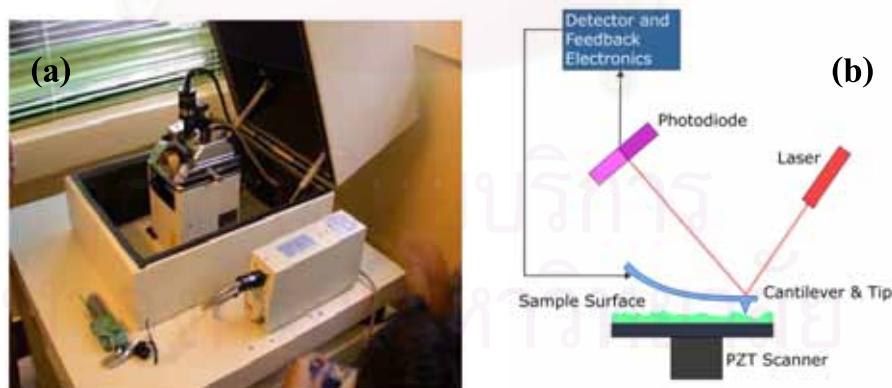
การทำลับกันหลายรอบของการกลบแบบบางกับการปลูกทับจะนำไปสู่การเกิดความตั้มดอตหนาแน่นสูง ซึ่งมีแนวในการเรียงตัวของกลุ่มความตั้มดอตไปในทิศทาง [1-10] [9]

3.2 การวัดลักษณะสมบัติด้วยระบบวัดติดตัวภายนอก (ex-situ)

เครื่องตรวจวัดภายในเครื่องปัจุกผลึกแบบลำไไมเลกูลมีจุดประสงค์เพื่อตรวจวัดขณะที่กำลังดำเนินการปัจจุบัน หรือใช้วัดค่าแรงดันไว้ในกระบวนการปัจจุบัน แต่เครื่องตรวจวัดแบบติดตัวภายนอก มีจุดประสงค์เพื่อวัดลักษณะสมบัติของชิ้นงานที่ผ่านการปัจจุบันสร้างมาแล้ว แต่ละเครื่องก็มีเป้าหมายในการวัดที่แตกต่างกันออกไป กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม (Atomic Force Microscope: AFM) ใช้สำหรับวัดลักษณะทางกายภาพของผิวน้ำของชิ้นงาน กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (Transmission Electron Microscopy: TEM) ใช้ดูรายละเอียดชิ้นงานแบบภาคตัดขวาง ระบบวัดการเปล่งแสง (Photoluminescence: PL) ใช้สำหรับวัดช่วงความยาวคลื่นและปริมาณโฟตอนที่ปล่อยออกมากจากชิ้นงานที่ถูกกระตุ้นด้วยพลังงานสูง

3.2.1 กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม (AFM)

การศึกษาผิวน้ำของโครงสร้างที่ผ่านกระบวนการปัจจุบันมาแล้ว เป็นการตรวจสอบผลที่ได้ทางกายภาพของผิวน้ำของโครงสร้าง ซึ่งสามารถถือถึงลักษณะสมบัติ้านอื่นๆได้ เช่น ลักษณะสมบัติทางแสง หรือ ลักษณะสมบัติทางไฟฟ้า โดยได้มีการใช้ผลที่ได้จากการวัดลักษณะโครงสร้างที่ผิวน้ำชิ้นงานด้วยกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม ไปเป็นข้อมูลการจำลองโครงสร้างเสมือนจริง (Simulation) เพื่อศึกษาลักษณะของผลการเปล่งแสง (Photoluminescence) ของโครงสร้างได้ [35]



รูปที่ 3.18 Seiko SPA-400 (a) ภาพจริงของเครื่องที่ห้องปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ (b) แผนภาพอย่างง่ายของการทำงานของกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม [3]

กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม (Atomic Force Microscope: AFM) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้สำหรับตรวจสอบผิวน้ำของชิ้นงานได้ลึกในระดับ Nanometer (ทางห้องวิจัยที่ผู้เขียนสังกัดอยู่ใช้

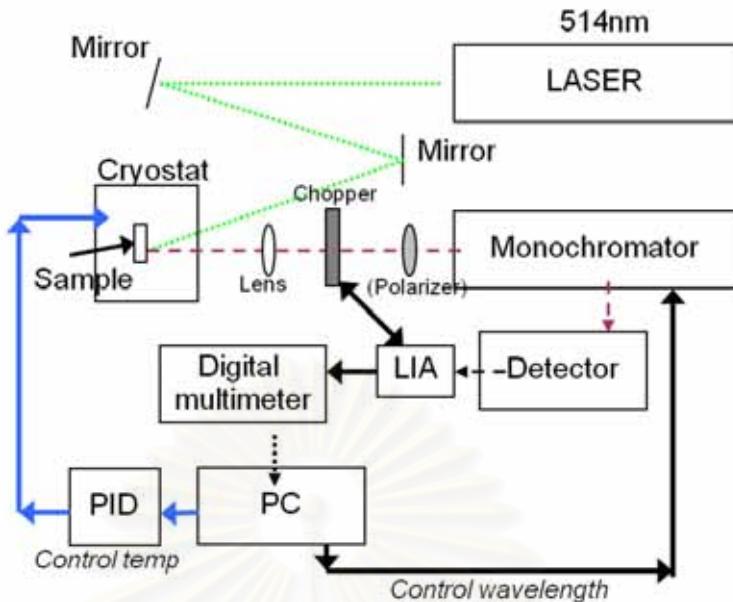
เครื่องของ Seiko รุ่น SPA-400 ดังแสดงในรูปที่ 3.18 (a) ลักษณะการทำงานของเครื่องแสดงไว้ในรูปที่ 3.18 (b) การทำงานของเครื่องนั้นทำโดยใช้หัวทิป (AFM tip, Cantilever) กวาดผ่าน (Scan) ผิวน้ำของชิ้นงาน เมื่อหัวทิปกวาดผ่านผิวน้ำชิ้นงานที่มีความขรุขระ หัวทิปจะมีการขับไปตามลักษณะของผิวน้ำที่ตำแหน่งนั้นๆ ดังนั้นการขับของหัวทิปจะสื่อถึงลักษณะทางกายภาพของผิวน้ำในบริเวณที่กวาดผ่าน ส่วนการแปลงมาเป็นข้อมูลลักษณะทางกายภาพของผิวน้ำนั้นจะใช้แสง LASER ยิงไปที่หัวทิปที่มีคุณสมบัติสะท้อนแสง LASER ได้ดี เมื่อหัวทิปมีการขับ ตัวตรวจจับแสง (Photodetector) จะตรวจจับการขับของหัวทิป ผลลัพธ์ที่ได้จากการล้องจุลทรรศน์แรงอะตอมคือการแปลงลักษณะทางกายภาพของผิวน้ำมาเป็นข้อมูลของพื้นผิวที่สามารถนำไปวิเคราะห์หรือแปลงเป็นภาพไปใช้ต่อได้

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สนใจผลทางกายภาพของผิวน้ำของชิ้นงาน เพราะว่าสามารถใช้ศึกษาถึงวิวัฒนาการของการเกิดอินเดียมาร์เซไนค์ตอนต้มดอตที่ปลูกบนแผ่นฐานลายตารางได้ ซึ่งผลการทดลองและการวิเคราะห์จากการล้องจุลทรรศน์แรงอะตอมถูกแสดงไว้ในบทที่ 4

3.2.2 ระบบวัดโฟโตคูมิเนสเซนส์ (PL)

ชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการปลูกมาแล้วและมีคุณสมบัติในการปล่อยพลังงานออกมายังรูปของโฟตอน (Radiative recombination) ด้วยการคูคูดลังงานโฟตอนจากกระตุนด้วยแสงสามารถนำมาวัดปริมาณโฟตอนและช่วงความยาวคลื่นของโฟตอนที่ถูกคายออกมายได้ด้วยระบบวัดโฟโตคูมิเนสเซนส์

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 3.19 ระบบวัดไฟฟอโตลูมิเนสเซนส์

ดังแสดงในรูปที่ 3.19 ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนหลักๆ ได้แก่ แหล่งกำเนิดไฟฟoton (Photon source), ชุดเลนส์สำหรับการไฟฟัก แยก และเปลี่ยนทิศทางไฟฟoton (Lens kit), เครื่องแยกแอบความยาวคลื่นไฟฟoton หรือ สเปกโตรมิเตอร์, โนโนโนกราเมเตอร์ (Spectrometer, Monochromater), ชิ้นงาน (Sample) และระบบคอมพิวเตอร์ (PC) สำหรับใช้ในการ คำนวณ, วิเคราะห์, แสดงผล และเก็บผล

การวัดไฟฟอโตลูมิเนสเซนส์เริ่มจากการยิงแสง LASER ที่มีพลังงานสูงกว่า Energy gap ของสารกึ่งตัวนำภายในได้การทดลอง แสงจะถูกยิงผ่านชุดเลนส์เพื่อไฟฟักลงไปที่พื้นผิวของชิ้นงานให้เข้มที่สุด เมื่อชิ้นงานได้รับไฟฟoton และเกิดการคุ้งคลื่นพลังงานไฟฟoton โดยอิเล็กตรอนภายในโครงสร้างของชิ้นงาน (พاหะจะไม่คุ้งคลื่นพลังงานไฟฟoton หากไฟฟoton มีพลังงานไม่พอที่จะกระตุ้นให้พาหะเกิดการเปลี่ยนสถานะพลังงาน (State)) อิเล็กตรอนที่ถูกกระตุ้นจะลดพลังงานออกมากเพื่อกลับสู่สถานะพื้น ในกรณีของสารกึ่งตัวนำชนิด Direct band gap ผลต่างของพลังงานจะอยู่ในรูปของไฟฟoton ไฟฟoton ที่ปล่อยออกมาก็ถูกไฟฟักโดยเลนส์เข้าสู่สเปกโตรมิเตอร์เพื่อจำกัดความยาวคลื่นที่สามารถเดินทางผ่านสเปกโตรมิเตอร์ได้ และทำการวัดความเข้มของช่วงความยาวคลื่นแคบๆ ดังกล่าวด้วยไฟฟอโตเดกเตอร์ ข้อมูลที่ได้จากการวัดความยาวคลื่นและวัดความเข้มแสงจากไฟฟอโตเดกเตอร์จะอยู่ในรูปคู่อันดับเรียกว่า Spectral response

การวัดทุกชนิดย่อมมีสัญญาณรบกวน ดังนี้ไฟตอนที่ปล่อยออกมานะและไฟตอนจากสิ่งแวดล้อม หรือ สัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า จะปนกัน ซึ่งบางครั้งไฟตอนที่ปล่อยออกมามีปริมาณไม่พอที่จะแยกจากสัญญาณรบกวนได้ ระบบวัดไฟโตลูมิเนสเซนส์จึงมักมีล็อกอินแอนป์ (Lock-in Amp, LIA) และชีอปเปอร์ (Chopper) เพื่อทำการแปลงสัญญาณเข้าให้อยู่ในปริภูมิความถี่ และแยกคัดความถี่ออกมานี้เพื่อตัดสัญญาณรบกวน นอกจากนี้ชิ้นงานที่มีโครงสร้างที่ແบนช่องว่างพลังงาน เป็นแบบ Indirect ทำให้พลังงานที่ปล่อยออกมาอาจจะไม่มีหรือมีไฟตอนน้อย ซึ่งพลังงานส่วนหนึ่งใช้ในการเปลี่ยนค่าโน้ม-men ตัมของพาหะและกายพลังงานออกมายังรูปการสั่นหรือไฟอน (Phonon) มักเสียไปในรูปความร้อน ดังนั้นชิ้นงานที่เหมาะสมต่อการวัดไฟโตลูมิเนสเซนส์ควรเป็นชิ้นงานที่โครงสร้างมีແบนช่องว่างพลังงานแบบ Direct

สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทที่ 4

ผลการทดลองและการวิเคราะห์

ความต้านทานต่อตัวของสารมีลักษณะที่การเรียงตัวเป็นเส้นตรงตามแนวของ Slip plane ที่เกิดจาก Misfit dislocation สองแนวตัดขวางกัน และปรากฏที่ผิวน้ำในรูป Surface step ซึ่งเป็นลักษณะทั่วไปของการปลูกค่อนต้านทานแผ่นฐานชนิดนี้ เช่นในระบบ Ge/SiGe [25] และ InAs/InGaAs [13,15] แต่สิ่งที่การศึกษาในอดีตไม่ได้มีการวิเคราะห์คือลำดับของการประกอบตัวเอง (Self-assembling) ของความต้านทานต่อตัวของสาร ผลการทดลองที่ได้จากการวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้ข้อสรุปที่สำคัญคือ ความต้านทานต่อตัวของสาร InAs ที่ถูกปลูกบนแผ่นฐานลายตาราง InGaAs มีลำดับการเกิดที่ตำแหน่งต่างๆไม่พร้อมกัน ซึ่งเป็นผลมาจากการสูงต่ำของพื้นผิวลายตารางที่ไม่เท่ากัน ทำให้ความหนาของตัวของสารเกิดความต้านทานต่อตัวของสารที่ตำแหน่งต่างๆไม่เท่ากันด้วยความเข้าใจในวิวัฒนาการของการเกิดความต้านทานต่อตัวของสาร ทำให้สามารถควบคุมการเกิดความต้านทานต่อตัวของสารได้และอาจนำไปสู่การปลูกค่อนต้านทานแบบ Deterministic [36] แทนที่จะเป็นแบบ Probabilistic (แบบ SK) ที่งานวิจัยส่วนใหญ่ใช้ในปัจจุบัน

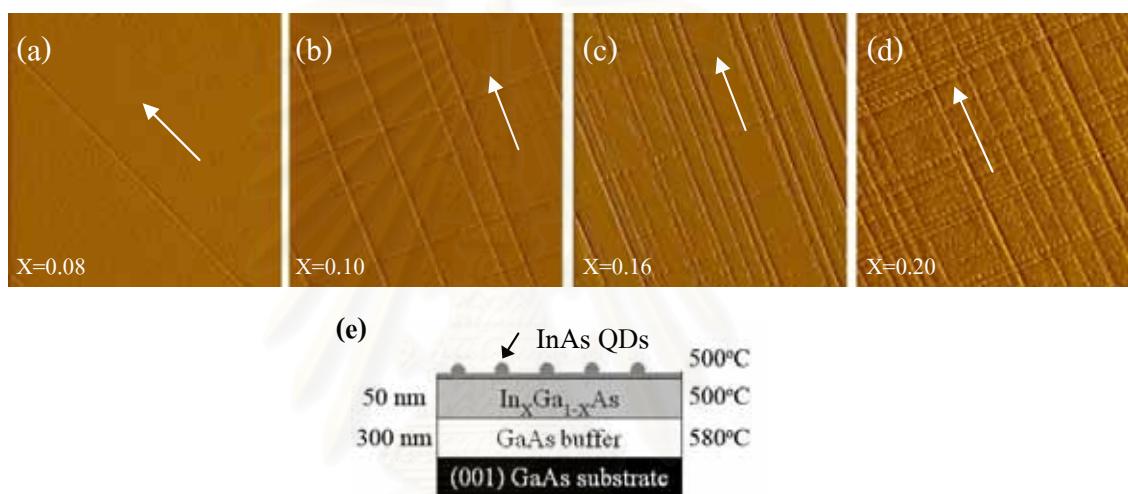
การทดลองที่นำมาสู่การวิเคราะห์วิวัฒนาการการเกิดความต้านทานต่อตัวของสาร InAs ที่ถูกบนแผ่นฐานลายตาราง $In_xGa_{1-x}As$ ($X < 0.2$) ถูกแบ่งออกเป็นหัวข้ออย่าง ได้แก่ ผลของการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนของ In ต่อ Ga ในชั้นลายตาราง การเปลี่ยนความหนาชั้นลายตาราง การทดลองปรับเปลี่ยนความหนา InAs ของชั้นความต้านทาน และการจำลอง Strain field ของผิวน้ำลายตารางด้วยรายละเอียดต่อไปนี้

4.1 ความต้านทานต่อตัวของสาร

การปรับเปลี่ยนชั้นลายตารางมีผลโดยตรงต่อการเรียงตัวของความต้านทานต่อตัวของสารที่ปลูกบนฐานลายตารางด้วย เพราะว่าการเรียงตัวของความต้านทานต่อตัวของสาร ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงผิวน้ำของลายตาราง ซึ่งขึ้นกับทั้งค่าของ X และความหนาของชั้น $In_xGa_{1-x}As$ ดังที่จะได้กล่าวต่อไป

4.1.1 การเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนอินเดียมต่อแกลเลียม (ค่าของ X ใน $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$)

แผ่นฐานลายตาราง InGaAs มีลักษณะสมบัติที่แตกต่างกันออกไป ตามอัตราส่วนของ In และ Ga ที่เป็นส่วนประกอบอยู่ เนื่องจากการปัลกชั้นแผ่นฐานลายตารางนี้ ใช้การเปิดชั้ตเตอร์เซลล์ As, In และ Ga พร้อมกัน โดยที่ As ที่เป็นหมู่ V ทำหน้าที่เป็นสารหลัก ขณะที่ In และ Ga ที่เป็นหมู่ III ต้องพยายามจับกับ As ให้ได้ทั้งคู่ เนื่องจากเป็นสารประกอบหมู่ III-V ดังนั้น In และ Ga จึงเป็นอัตราส่วนกันในสารประกอบหมู่ III-V แบบสามชาตุ (Ternary compound) ตามต้องการ เบี่ยงแบนด์ว่าง $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$



รูปที่ 4.1 ภาพจากกล้องจุลทรรศน์แรงดันตอนแสดง InAs ความตั้มดอตบนแผ่นฐานลายตาราง

$\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ เมื่อ X มีค่าเป็น (a) 0.08, (b) 0.10, (c) 0.16 และ (d) 0.20 โดยทุกภาพมีขนาด $10 \times 10 \mu\text{m}^2$ ลูกศรแสดงทิศ [1-10] (e) แบบจำลองของภาพตัดขวาง โครงสร้างของชิ้นงานในการ

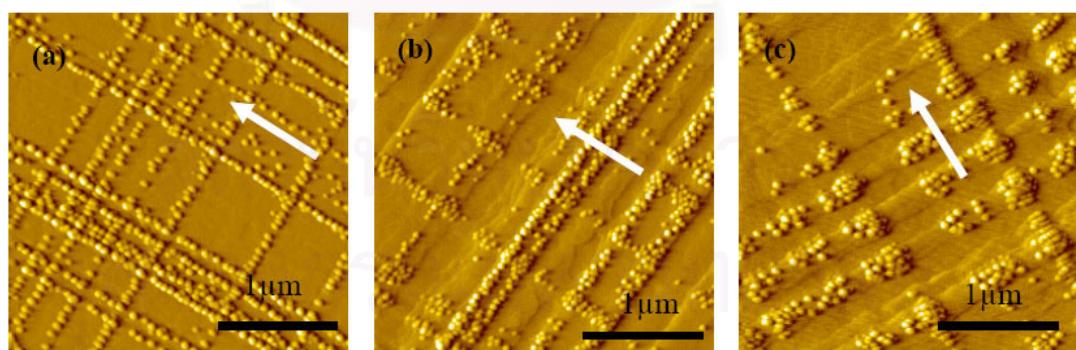
ทดลอง

ผลการทดลองการเปลี่ยนอัตราส่วน In ต่อ Ga (ปรับค่า X) โดยยังคงความหนาของชั้น InGaAs ไว้ที่ 50 nm ดังภาพตัดขวางในรูปที่ 4.1 (e) ได้ลูกศรแสดงในรูปที่ 4.1 (a) - (d) ซึ่งชี้ให้เห็นว่า เมื่อเพิ่มอัตราส่วนของ In ในชั้น InGaAs (ค่า X เพิ่มขึ้น) ปริมาณลายตารางก็เพิ่มขึ้นด้วย โดยการก่อตัวของความตั้มดอตบนผิวน้ำชิ้นงานนั้นมีลักษณะร่วมกันที่มีความต่างๆ กัน เช่น ความกว้างของช่องที่เพิ่มขึ้นตามที่เพิ่มขึ้นของค่า X ซึ่งสามารถอธิบายได้จากการผ่อนคลายความเครียดระหว่างการปัลกชั้น InGaAs เนื่องจากค่า ϵ นั้นคำนวณมาจากความต่างของค่าคงที่ผลึกของ $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ และ GaAs ดังข้อมูลในตารางที่ 2.1 โดยที่ยังปริมาณ In ใน InGaAs

มาก ค่าคงที่ผลลัพธ์ของ InGaAs ก็ยิ่งมาก ทำให้ ϵ มากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นหากคงความหนาชั้นลายตารางไว้ที่ 50 nm เมื่อปริมาณ In เพิ่มขึ้น ค่าความหนาวิกฤติของการเกิด Dislocations จะลดลงตามความสัมพันธ์ของ Matthews-Blakeslee [10] ซึ่งได้สร้างเป็นกราฟไว้ในรูปที่ 2.13 การที่ความเครียดในชั้นผลลัพธ์เพิ่มขึ้นตามปริมาณ In ผลลัพธ์จึงถือค่าวิกฤติที่ทำให้เกิด MD และ TD เริ่วขึ้น เป็นสาเหตุให้ชั้นลายตารางที่มีปริมาณ In น้อยจะมีลายตารางน้อยด้วย เพราะลายตารางเป็นผลมาจากการเกิดขึ้นของ MD และ TD ลิ่งที่น่าสนใจจากรูปที่ 4.1 (a) คือหากทำการควบคุมค่า X ให้เหมาะสม จะสามารถควบคุมการเกิด Dislocations ในทิศทางเดียวคือทิศ [1-10] ได้ และหากควบคุมการเบิด-ปิดชั้ตเตอร์ระหว่างการปลูกชั้นความอนตัมดอตและปรับเวลา GI (Growth interruption) และเทคนิคการปลูกให้เหมาะสมก็จะสามารถสร้างความอนตัมดอตที่เรียกว่าเป็นแนวเดียวในทิศ [1-10] ได้ เช่นกัน

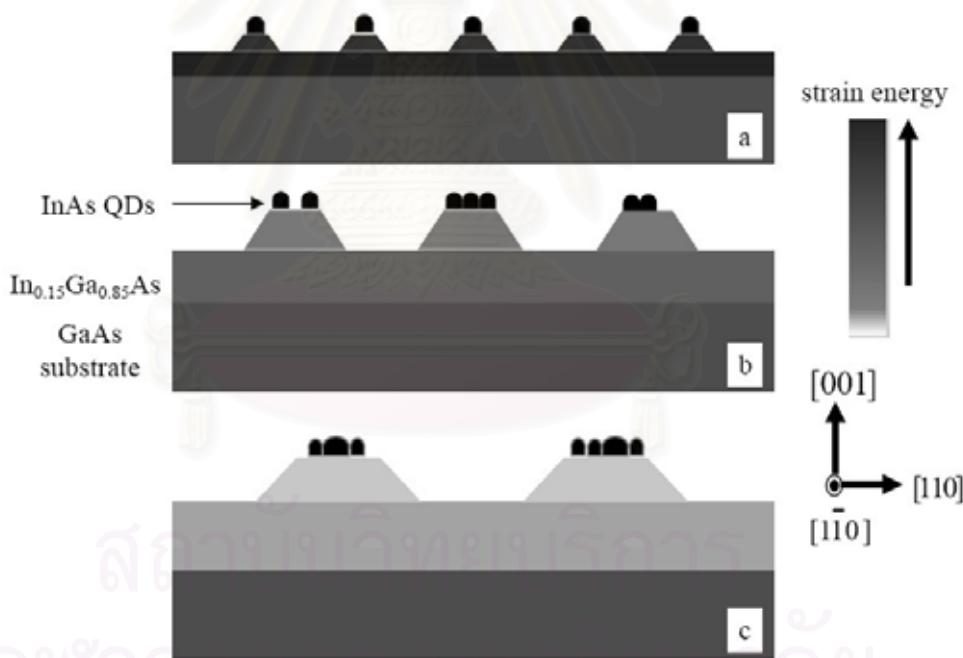
4.1.2 การเปลี่ยนแปลงความหนาชั้นลายตาราง

นอกจากปริมาณ In จะมีผลต่อลายตารางของชั้นลายตารางแล้ว ความหนา ก็มีผลต่อความเครียดสะสมและพื้นผิวของชั้นลายตารางเช่นกัน การเพิ่มความหนาไปเกินค่าวิกฤติการทวีคูณปริมาณ Dislocation (h_p) หรือ Dislocation multiplication [15,37,38] จะทำให้ความเครียดของชั้นฟิล์ม InGaAs ลดลงอย่างรวดเร็วพร้อมกับผิวน้ำที่มีความสูงต่ำเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งการทดลองเพิ่มความหนาได้ทำการศึกษามาแล้วโดย C. C. Thet et al. [15] ผลการทดลองถูกแสดงในรูปที่ 4.2



รูปที่ 4.2 ผิวน้ำของ InAs ความอนตัมดอตกลบทับบนแผ่นฐานลายตาราง $In_{0.15}Ga_{0.85}As$ ที่ความหนาของชั้นลายตาราง (a) 50 nm (b) 100 nm และ (c) 150 nm วัดจากกล้องจุลทรรศน์แรงดันลมทิศทางตามลูกศรคือทิศ [1-10] [15]

ความหนาของชั้นแผ่นฐานลายตารางก็มีผลต่อรูปแบบของลายตารางที่เกิดขึ้นที่ผิวน้ำด้วยการแปรค่าความหนาในช่วง 50-150 nm จะทำให้ผิวน้ำของแผ่นฐานลายตารางจะมีความสูงของลายตารางและลักษณะของลายตารางเป็นดังแสดงในรูปที่ 4.2 ความหนาของชั้น $In_{0.15}Ga_{0.85}As$ ที่มากกว่า $h_p = 76$ nm จะทำให้เกิด Dislocations multiplication [15,37,38] จากรูปที่ 4.2 (a) พบว่าความหนาชั้นผลึกที่ 50 nm เกินกว่าค่าความหนาวิกฤต (h_c) แต่ไม่มากไปกว่า h_p ที่ 76 nm หมายความว่าเกิด Dislocation แล้วและส่งผลไปยังผิวน้ำเดียวจำนวนลดลงที่ผิวน้ำนั้นซึ่งมีไม่มาก ในขณะที่รูปที่ 4.2 (b และ c) แผ่นฐานลายตารางหนากว่า h_p จึงมีการทวีคูณปริมาณ dislocation ทำให้มี MD (60° dislocation) ปริมาณมากที่เกิดขึ้นส่ง Slip plane มาที่ผิวน้ำมากจนผิวน้ำของแผ่นฐานลายตารางมีบางตำแหน่งที่เกิดการรวมกันของ MD ผลที่ได้คือระยะห่าง (Spacing) ระหว่างเส้นลายตารางของแผ่นฐานลายตารางที่นานกันในแต่ละแนว จะน้อยลงตามความหนาที่มากขึ้น และเส้นลายตารางจะมีความหนาและสูงมากขึ้นด้วย

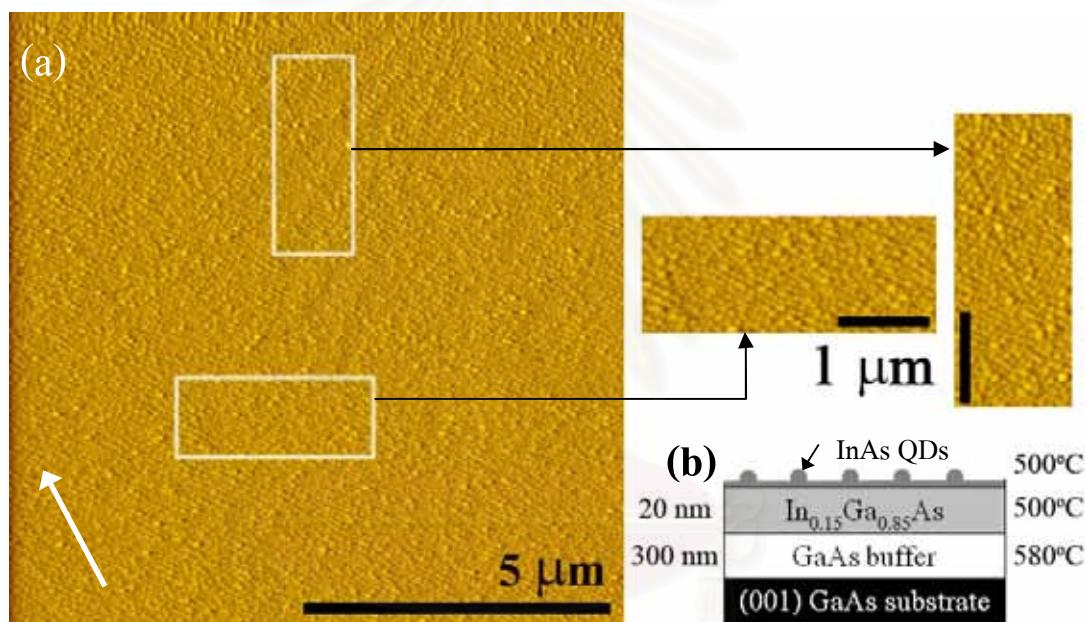


รูปที่ 4.3 แบบจำลองของภาพตัดขวางของ InAs ความตื้นดอตอนแผ่นฐานลายตาราง $In_{0.15}Ga_{0.85}As$ ที่ความหนา (a) 50 nm (b) 100 nm (c) 150 nm [15]

ที่ความหนามากกว่าค่า h_p ทำให้เกิด Dislocations จำนวนมาก และทำให้มี Surface steps จำนวนมากเช่นกันที่ผิวน้ำชั้นลายตาราง จึงมีกระบวนการ Surface step elimination ตามมา เมื่อทำการปลูกชั้นลายตารางต่อไปดังแสดงในรูปที่ 2.7 [39] จะเห็นจากรูปว่าหากมี Dislocation เพิ่มขึ้น

จะมีโอกาสที่จะเกิดเนินใหญ่ขึ้นสูง เนื่องมาจากการทับซ้อนของ 60° Dislocations ที่มากขึ้นตาม MD นั่นเอง เมื่อทับซ้อนกันมากขึ้นเรื่อยๆ เนินก์จะใหญ่ขึ้นตามความหนาของชั้นลายตารางและปริมาณของ Dislocations ดังแสดงในรูปที่ 4.3 [15,29,39]

การทดลองเพิ่มความหนาที่ได้อธิบายไปแล้วทำให้สามารถคาดเดาผลของการลดความหนาชั้นลายตารางได้ว่า หากเพิ่มความหนาแล้ว Dislocation เพิ่มมากขึ้นจนซ้อนทับกันทำให้เกิดเนินที่ผิวน้ำขนาดใหญ่ขึ้น ดังนั้นมีผลความหนาลงผลที่ได้จะตรงกันข้ามกัน จึงได้ปลูกชิ้นงาน n0842 เป็นโครงสร้างชั้นควอนตัมคอตที่อุณหภูมิผิวน้ำ 500°C ปลูกทับบนชั้น $\text{In}_{0.15}\text{Ga}_{0.85}\text{As}$ หนา 20 nm ที่ปลูกด้วยอุณหภูมิผิวน้ำ 500°C เช่นกัน ผลที่ได้ถูกแสดงในรูปที่ 4.4



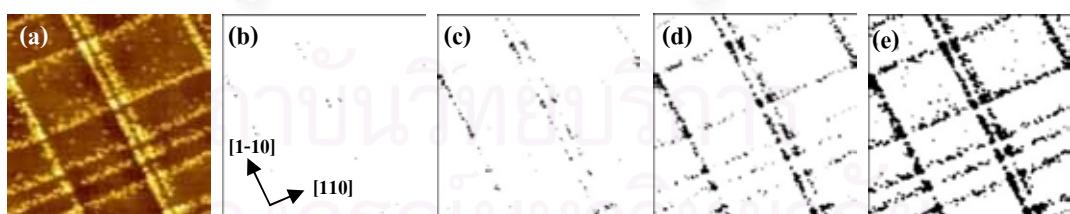
รูปที่ 4.4 (a) ภาพจากกล้องจุลทรรศน์แรงดึงดูดแสดงผิวน้ำขนาด $10 \times 10 \mu\text{m}^2$ โดยลูกศรแสดงทิศทาง [1-10] และ (b) แบบจำลองภาพตัดขวางโครงสร้างของชิ้นงาน n0842

เมื่อพิจารณาจากรูปที่ 4.4 พบร่วมกันว่าควอนตัมคอตบนผิวน้ำข้นงานแต่ก่อให้เกิดเนินที่ชั้น $\text{In}_{0.15}\text{Ga}_{0.85}\text{As}$ หนา 20 nm ไม่มีลายตารางเกิดขึ้นอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามหากพิจารณารูปที่ 4.4 โดยละเอียดแล้ว พบร่วมกันว่าควอนตัมคอตบางตำแหน่งมีลักษณะคล้ายกับว่าเรียงตัวเป็นเส้นตรงทั้งตามแนวลูกศร และแนวตั้งจากกับลูกศร เมื่อเทียบกับทิศทางกับ [1-10] และ [110] ดังที่แสดงไว้ในส่วนขยายของรูปที่ 4.4 (a) ที่ด้านขวา ซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจมีลายตารางเกิดขึ้นแล้ว เพราะว่าที่

ความหนา 20 nm นั้นมากกว่าค่าความหนาวิกฤติที่มีการเกิด Dislocation ของชั้น $In_{0.15}Ga_{0.85}As$ คือ $h_c = 6 \text{ nm}$ ไปแล้ว (ค่า h_c จากรูปที่ 2.13) แต่ว่าลายตารางยังไม่ยาวมากเนื่องมาจากต้นแรกๆของการเกิด Strain relaxation นั้น MD และ TD จะยังไม่เกิดเป็นแนวยาวมาก เพราะว่า MD จะขยายขึ้นเรื่อยๆตามความหนาชั้น InGaAs [14]

4.2 วิัฒนาการของการเกิดความตั้มดอตบนลายตาราง

ความคิดในการใช้ลายตารางเป็นแพ่นฐานแม่แบบ (Template) ในการจัดเรียงความตั้มดอตนั้นได้มีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997 [25] แต่ว่าตลอด 11 ปีที่ผ่านมาขึ้นไม่มีการศึกษาธรรมชาติของการเกิดความตั้มดอตบนแพ่นฐานลายตารางเลย ข้อมูลที่ถูกนำเสนอในหัวข้อนี้เป็นการพิสูจน์โดยการปลูกจริงและการจำลอง Strain filed ที่ผิวน้ำของลายตารางว่าความตั้มดอตบนลายตารางเกิดที่เวลาต่างกัน การทดลองในส่วนนี้เริ่มจากการศึกษาขนาดของความตั้มดอต InAs 0.8 ML ปลูกที่ 470°C มีเวลาขัดจังหวะหลังการปลูก (Growth interruption, GI) 30 วินาที [40] บนแพ่นฐานลายตาราง $In_{0.2}Ga_{0.8}As / GaAs (001)$ หนา 50 nm ปลูกที่ 500°C ชื่อชิ้นงาน n0702 ภาพจากกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอมดังแสดงในรูปที่ 4.5 (a) พบว่าความตั้มดอต InAs บนผิวน้ำชิ้นงานดังกล่าวสามารถจัดลำดับความสูงจากสูงไปต่ำได้เป็น 4 กลุ่มแสดงไว้ในรูปที่ 4.5 (b-e) ดังนี้ ก) กลุ่มความตั้มดอตบนจุดที่เส้นลายตารางตัดกัน (Intersection) ข) กลุ่มความตั้มดอตบนเส้นลายตารางที่บานกว้างที่สุด [1-10] ค) กลุ่มความตั้มดอตบนเส้นลายตารางที่บานกว้างที่สุด [110] และ ง) กลุ่มความตั้มดอตบนพื้นเรียบที่ไม่มีลายตาราง



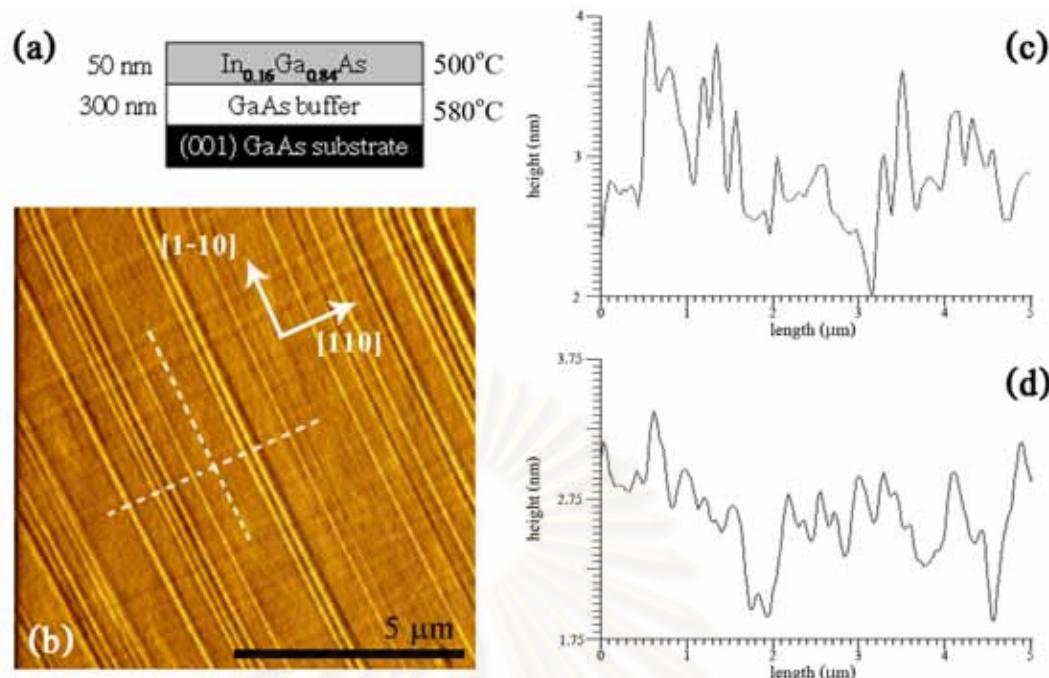
รูปที่ 4.5 (a) ภาพจากกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอมแสดงผิวน้ำชิ้นงานขนาด $2 \times 2 \mu\text{m}^2$ และภาพจากใช้ Image thresholding โดยมีระดับ Threshold ที่ (b) 5.5-, (c) 4.9-, (d) 4.0- และ (e) 3.0 nm โดยสีขาวหมายถึงบริเวณที่มีความสูงต่ำกว่า และสีดำหมายถึงบริเวณที่มีความสูงสูงกว่าค่า Threshold

ข้อมูลคืนในรูปที่ 4.5 (a) จึงได้ถูกนำมาผ่านกระบวนการจัดเรียงภาพ (Image processing) โดยผ่านการทำ Image thresholding เพื่อคัดกรองตำแหน่งที่มีความสูงมากกว่าค่าวิกฤติ (Threshold)

รูปที่ 4.5 (b) แสดงตำแหน่งของความตั้มดอตที่มีความสูงมากกว่า 5.5 nm ซึ่งพบว่าเป็นความตั้มดอตเฉพาะบนตำแหน่งจุดตัดของเส้นแนวที่ขนานกับทิศ [1-10] และ [110] เท่านั้น ส่วนรูปที่ 4.5 (c) นั้นแสดงตำแหน่งของความตั้มดอตที่มีความสูงมากกว่า 4.9 nm ซึ่งพบว่าเป็นตำแหน่งเดินที่ปรากฏในรูปที่ 4.5 (b) (เพราะ $5.5 > 4.9 \text{ nm}$) และตำแหน่งใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาจาก (b) ($4.9 < h < 5.5 \text{ nm}$) ซึ่งตำแหน่งใหม่ดังกล่าวเป็นความตั้มดอตบนเส้นลายตารางที่ขนานกับทิศ [1-10] เท่านั้น สำหรับรูปที่ 4.5 (d) แสดงตำแหน่งของความตั้มดอตที่มีความสูงมากกว่า 4.0 nm โดยส่วนที่เพิ่มมาจากรูปที่ 4.5 (c) ($4.0 < h < 4.9 \text{ nm}$) คือความตั้มดอตบนเส้นลายตารางที่ขนานกับทิศ [110] และสำหรับรูปที่ 4.5 (e) ซึ่งแสดงตำแหน่งของความตั้มดอตที่มีความสูงมากกว่า 3.0 nm มีส่วนที่เพิ่มมาจากรูปที่ 4.5 (d) ($3.0 < h < 4.0 \text{ nm}$) อยู่ในบริเวณพื้นเรียบที่ไม่มีลายตาราง

ข้อมูลข้างต้นเป็นตัวบ่งชี้สำคัญที่ทำให้สันนิษฐานได้ว่าการเกิดความตั้มดอตบนพื้นผิวลายตารางมีวัตถุการการเกิดจากบริเวณจุดตัดของลายตาราง ไปสู่เส้นลายตารางที่ขนานกับทิศทาง [1-10] จากนั้นไปสู่เส้นลายตารางที่ขนานกับทิศทาง [110] และสุดท้ายไปสู่บริเวณพื้นเรียบที่ไม่มีลายตาราง ทั้งหมดนี้เป็นลักษณะร่วมของชิ้นงานทุกชิ้นงานที่มี InAs ความตั้มดอตบนพื้นผิว $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As} / \text{GaAs}$ เมื่อ X มีค่ามากพอและชิ้น $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ สูงพอที่จะทำให้เกิดลายตารางแต่ไม่สูงเกินไปกว่าค่า h_p (คือ $h_c < h < h_p$)

ข้อมูลข้างต้นบ่งชี้ว่าเส้นแนวนานที่เกิดจาก MD ในทิศ [1-10] และ [110] มีความแตกต่างกัน จึงจำเป็นต้องทำการศึกษาธรรมชาติของพื้นผิวลายตารางในทิศทั้งสอง โดยละเอียด จึงได้ทำการปลูกชิ้นงาน บ0811 ซึ่งเป็นลายตารางเปล่าๆ ของ $\text{In}_{0.16}\text{Ga}_{0.84}\text{As}$ หนา 50 nm ปลูกที่ 500°C บนแผ่นฐาน GaAs (001) ดังรูปที่ 4.6 (a) โดยผิวน้ำของชิ้นงานถูกแสดงในรูปที่ 4.6 (b) และ Line scan ของผิวน้ำในทิศทาง [1-10] และ [110] ถูกแสดงในรูปที่ 4.6 (c) และ (d) ตามลำดับ จากรูปจะเห็นได้ว่าความสูงของลายตารางแนวที่ขนานกับทิศ [1-10] จะสูงกว่าแนวที่ขนานกับทิศ [110] ซึ่งไม่เหมือนกับลายตารางจากคู่สารประกอบหมู่ IV-IV ตัวยกันเอง เช่น SiGe / Si (100) [25] ซึ่งมีความสูงเท่ากัน ความแตกต่างนี้มาจากการที่เป็น Core ที่แตกต่างกันตั้งแต่แรกของแผ่นฐาน GaAs (001) [12] ทำให้ส่งผลมาถึงเวลาปลูกชิ้นลายตาราง โดยแสดงออกมาที่ผิวน้ำของชิ้นลายตาราง

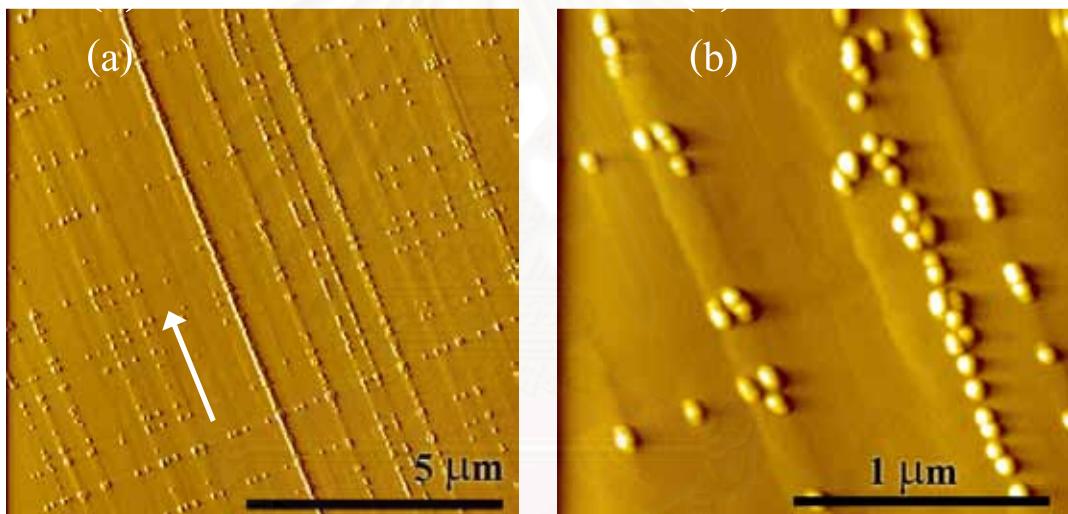


รูปที่ 4.6 ชิ้นงาน ս0811 : ชั้นลายตาราง In_{0.2}Ga_{0.8}As เป็นชั้นบนแผ่นฐาน GaAs (a) โครงสร้างชิ้นงาน (b) ผิวหน้าชิ้นงานที่วัดจากกล้องจุลทรรศน์แรงดันบนขนาด $10 \times 10 \mu\text{m}^2$ ทิศทางตามลูกศร (c) Line scan ผิวหน้าบนกับทิศ [110] เพื่อวัดความสูงของเส้นลายตารางทิศ [1-10] (d) Line scan ผิวหน้าบนกับทิศ [1-10] เพื่อวัดความสูงเส้นลายตารางทิศ [110]

เมื่อทราบเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าเส้นลายตารางในแนวที่บานกับทิศ [1-10] และ [110] มีความไม่สมมาตรกันทั้งค้านความสูงและจำนวนเส้นต่อระยะทาง (จากรูปที่ 4.6) และจากข้อสันนิษฐาน วิวัฒนาการการเกิดความตั้มดอตบนลายตาราง (จากรูปที่ 4.5) ทำให้ต้องทำการทดลองเพิ่มเติม โดยทำการปูลูก InAs ความตั้มดอตบนแผ่นฐานลายตารางแต่ต้องทำการหยุดการปูลูกก่อนที่ความตั้มดอตจะปูกคลุมทุกบริเวณ ซึ่งสามารถทำได้สองวิธีคือ 1) ทำการปูลูกชั้นความตั้มดอตให้มีความหนาสม่ำเสมอและหยุดการปูลูกก่อน RHEED pattern จะปรากฏเป็น Spotty pattern อย่างชัดเจน และ 2) ทำการปูลูกความตั้มดอตให้มีความไม่สม่ำเสมอบนชิ้นงานเดียว (ด้วยการหยุดมอเตอร์ขับ Manipulator ที่ใช้ในการหมุนแผ่นชิ้นงาน เนพะในระหว่างการปูลูกชั้นความตั้มดอต) และหยุดการปูลูกทันทีที่ RHEED pattern เปลี่ยนจาก Streaky pattern เป็น Spotty pattern ซึ่งทั้งสองวิธี ข้างต้นมีรายละเอียดการดำเนินการและผลการทดลองดังนี้

4.2.1 วิธีที่ 1 (ชิ้นงาน u0817 และ u0815)

รูปที่ 4.5 แสดงให้เห็นว่าหากปลูกชั้น InAs ความต้มดอตที่ความหนา 0.8 ML จะมีความต้มดอตปกคลุมไปทุกบริเวณทำให้การศึกษาวิวัฒนาการการเกิดความต้มดอตสามารถกระทำได้โดยการสันนิษฐานจากเทคนิค Image thresholding เท่านั้น หากต้องการพิสูจน์ข้อสันนิษฐานดังกล่าวจริง จะต้องทำการปลูกความต้มดอตที่ความหนาน้อยกว่า 0.8 ML จึงได้ทดลองปลูกชิ้นงานที่มีการลดปริมาณ InAs ในชั้นความต้มดอต โดยปรับลดปริมาณจาก 0.8 ML ไปที่ประมาณ 0.76 ML โดยเป็นชิ้นงาน u0817 (InAs ความต้มดอต 0.76 ML ที่ 500°C บนชั้นลายตาราง $\text{In}_{0.16}\text{Ga}_{0.84}\text{As}$ หนา 50 nm ใช้แผ่นฐาน GaAs (001)) ซึ่งมีลักษณะผิวน้ำดังแสดงในภาพจากกล้องจุลทรรศน์แรงดึงดูดในรูปที่ 4.7

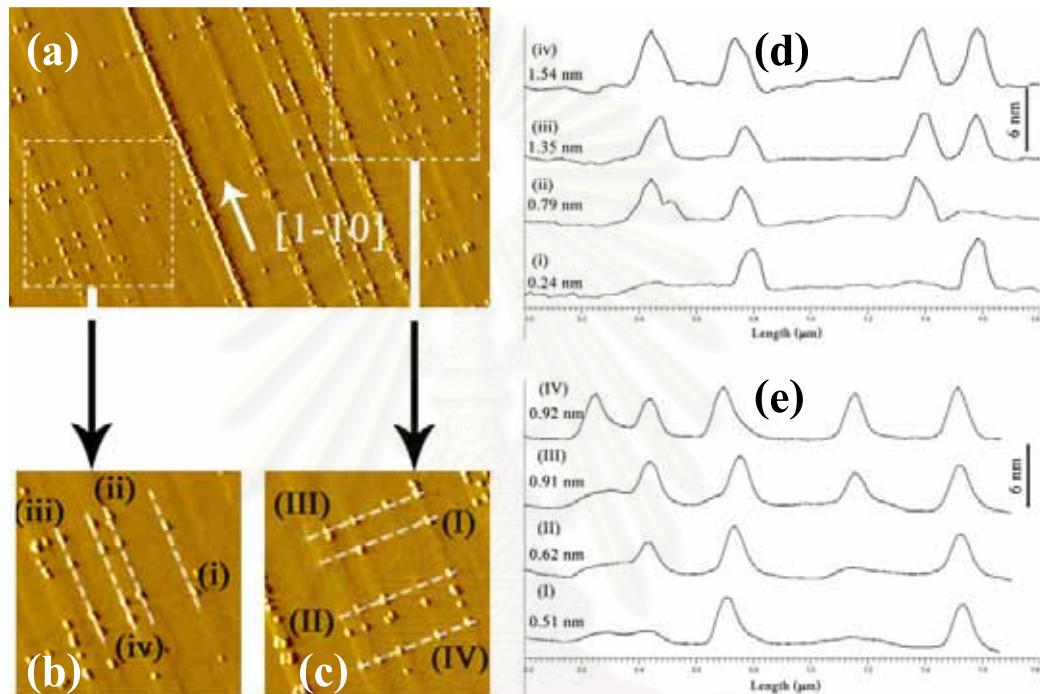


รูปที่ 4.7 ภาพจากกล้องจุลทรรศน์แรงดึงดูดแสดงผิวน้ำของชิ้นงาน u0817 ขนาด

(a) $10 \times 10 \mu\text{m}^2$ และ (b) $2 \times 2 \mu\text{m}^2$ โดยจุลทรรศน์แสดงทิศทาง [1-10]

เมื่อเปรียบเทียบผิวน้ำชิ้นงาน u0702 (InAs 0.8 ML) กับ u0817 (InAs 0.76 ML) ในรูปที่ 4.5 (a) กับ รูปที่ 4.7 (b) ตามลำดับพบว่าชิ้นงาน u0817 (InAs ปริมาณ 0.76 ML) จะเป็นสถานะที่อยู่ระหว่างรูปที่ 4.5 (c) และ (d) เนื่องจากบนพื้นเรียบไม่มีความต้มดอตเลย และมีความต้มดอตเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากบนเส้นลายตารางที่บานกว่าทิศ [1-10] แต่เกิดขึ้นเป็นจำนวนน้อยในแนวที่บานกับทิศ [110] การที่กลุ่มของความต้มดอตที่ก่อตัวบนเส้นลายตารางที่บานกับทิศ [1-10] มีความหนาแน่นมากกว่าที่ก่อตัวบนเส้นลายตารางที่บานกับทิศ [110] อย่างชัดเจน และกลุ่มความต้มดอตเกือบทั้งหมดที่ก่อตัวบนเส้นลายตารางที่บานกับทิศ [110] นั้นเป็นความต้มดอตที่

ก่อตัวบนเส้นลายตารางที่บานกว้างกับทิศ [1-10] ด้วย เป็นหลักฐานสำคัญที่ทำให้สรุปได้ว่าความตั้มดอตที่ก่อตัวบนเส้นลายตารางที่บานกว้างกับทิศ [1-10] เกิดขึ้นก่อนความตั้มดอตที่ก่อตัวบนเส้นลายตารางที่บานกว้างกับทิศ [110] ตามที่สันนิษฐานไว้อย่างไรก็ตามเพื่อให้ได้ข้อสรุปการเกิดก่อน-หลังของความตั้มดอตจึงต้องทำการวิเคราะห์ความสูงของความตั้มดอตน้ำเส้นลายตารางทั้งสองทิศทางโดยละเอียด



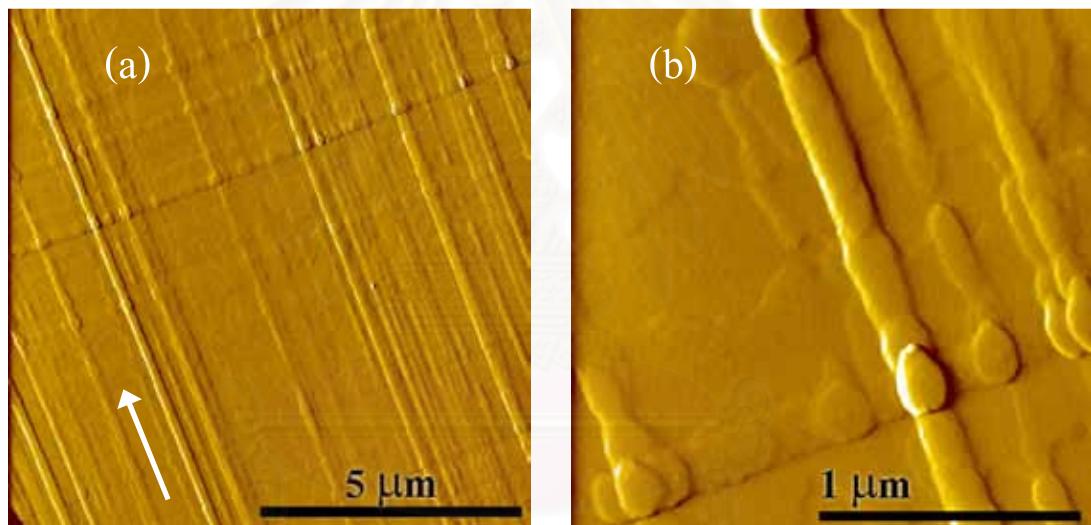
รูปที่ 4.8 ภาพจากกล้องจุลทรรศน์แรงดันต่ำแสดง (a) ผิวน้ำชีนงาน 0817 กับรูปที่ 4.7 ขนาด $8 \times 5 \mu\text{m}^2$ และ (b), (c) ส่วนขยายขนาด $2.5 \times 2.5 \mu\text{m}^2$ ของบริเวณที่ตีกรอบเส้นประใน (a) โดย Line scans ในทิศทางบานกว้าง [1-10] และ [110] ในรูป (b) และ (c) ถูกแสดงในรูป (d) และ (e) ตามลำดับ

เมื่อทำ Line scan ผิวน้ำของชิ้นงาน 0817 ดังรายละเอียดในรูปที่ 4.8 (b) และ (c) ได้ผลออกมาดังรูปที่ 4.8 (d) และ (e) ตามลำดับพบว่าเมื่อพิจารณารูปที่ 4.8 (b) และ (d) ในแฉว (i) มีความตั้มดอต 2 ตำแหน่ง และมีความสูงของลายตารางที่ความตั้มดอตก่อตัวอยู่ข้างบน 0.24 nm (วัดเทียบขึ้นมาจากบริเวณพื้นเรียบ), ในแฉว (ii) มีความตั้มดอต 3 ตำแหน่ง และมีความสูงของลายตารางที่ความตั้มดอตก่อตัวอยู่ข้างบน 0.79 nm , ในแฉว (iii) มีความตั้มดอต 4 ตำแหน่ง และมีความ

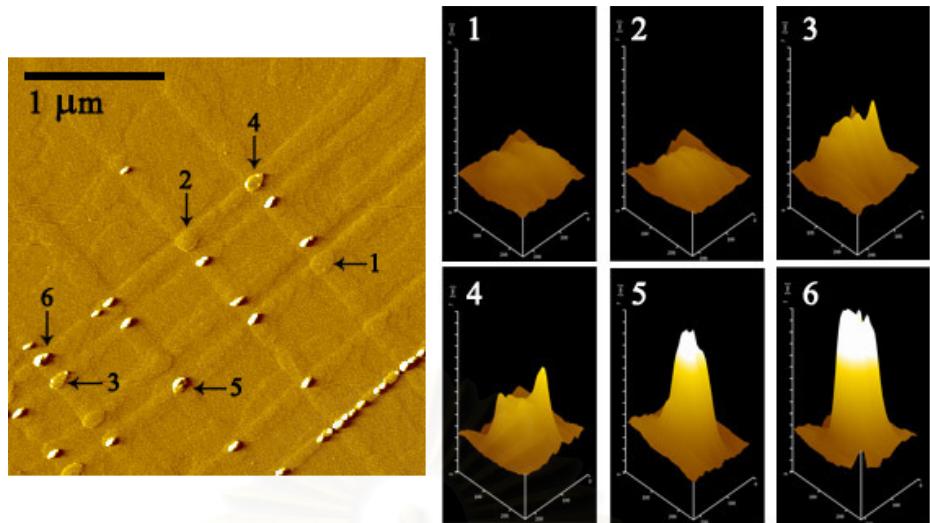
สูงของลายตารางที่ความตั้นดอตก่อตัวอยู่ข้างบน 1.35 nm , ในขณะ (iv) มีความตั้นดอต 4 ตำแหน่ง และมีความสูงของลายตารางที่ความตั้นดอตก่อตัวอยู่ข้างบน 1.54 nm

แม้ว่าที่แสดง (iii) และ (iv) จะมีจำนวนความตั้นดอตเท่ากัน แต่ความสูงของความตั้นดอตบนແຄວ (iv) มีความสูงมากกว่าແຄວ (iii) ซึ่งบ่งชี้ได้ว่าความตั้นดอตบนແຄວ (iv) นั้นก่อตัวขึ้นมา ก่อน

ผลการวิเคราะห์ Line scan ในแนวทิศ [110] จากรูปที่ 4.8 (c) และ (e) พบว่าให้ผลในลักษณะเดียวกันกับแนวทิศ [1-10] นั่นคือที่ความสูงของลายตาราง 0.51 nm ของແຄວ (I), 0.62 nm ของແຄວ (II), 0.91 nm ของແຄວ (III) และ 0.92 nm ของແຄວ (IV) มีจำนวนความตั้นดอตอยู่ 2, 3, 4 และ 5 ดอตตามลำดับ [16]



รูปที่ 4.9 ภาพของผิวน้ำของชิ้นงานที่ลดปริมาณ InAs ลงไปเป็นก้อนที่จะก่อตัวเป็นความตั้นดอตจาก 0.8 ML เหลือ 0.72 ML วัดจากกล้องจุลทรรศน์แรงดึงตอนที่ (a) $10 \times 10 \mu\text{m}^2$ และ (b) $2 \times 2 \mu\text{m}^2$ ลูกศรแสดงทิศ [1-10]



รูปที่ 4.10 ภาพจากกล้องจุลทรรศน์แรงดึงดูดบนขนาด $3 \times 3 \mu\text{m}^2$ ของชิ้นงาน 27n (InAs ควบคุมต้ม คือต้มความหนา ต่ำกว่า 0.8 ML บน $\text{In}_{0.13}\text{Ga}_{0.87}\text{As}$ หนา 50 nm) และภาพแสดงวิวัฒนาการการเกิด ควบคุมต้มคือตั้งของดัดลายตาราง จากทั้ง 6 จุดที่ทำเครื่องหมายไว้

ข้อมูลข้างต้นที่ได้จากชิ้นงาน n0817 เป็นการยืนยันข้อสันนิษฐานของวิวัฒนาการระหว่าง รูปที่ 4.5 (c) และ (d) ซึ่งควบคุมต้มคือตั้งได้เกิดบนเส้นแนววนนาในทั้งสองทิศแล้วเท่านั้น จึงยังไม่ สามารถพิสูจน์เงื่อนไขการเกิดควบคุมต้มคือตั้งแต่ต้นคือในรูปที่ 4.5 (b) ได้ เพื่อให้ข้อสรุป วิวัฒนาการของควบคุมต้มคือตั้งบนลายตารางเป็นไปอย่างสมบูรณ์ จึงได้ทำการปลูกชิ้นงานเพิ่มเติม คือ n0815 โดยทำการปลูกชิ้น InAs ควบคุมต้มคือตั้งที่มีความหนาต่ำกว่าชิ้นงาน n0817 ลงไปอีกคือ ปลูกเพียง 0.72 ML เท่านั้นและเนื่องจากที่ความหนาในระดับนี้ยังต่ำกว่าความหนาปกติของการ เกิดควบคุมต้มคือตั้งต้องหยุดปลูกโดยการจับเวลา (ไม่สามารถสังเกตจาก RHEED ดังเช่นชิ้นงาน n0702 ได้) โดยขณะที่ทำการปลูกนี้ RHEED pattern ยังไม่ทันปรากฏเป็น Spotty pattern ก็ต้อง หยุดการปลูกชิ้นควบคุมต้มคือตั้งก่อน หาก RHEED pattern ยังไม่เป็น Spotty pattern หมายความว่า ควบคุมต้มคือตั้งแบบ SK นี้ยังไม่ก่อตัวเป็นควบคุมต้มคือตั้งสมบูรณ์ ผลจากการหยุดเวลาที่ความหนา ของชิ้น InAs เพียงเท่า 0.72 ML ทำให้ได้ผิวน้ำชิ้นงานดังแสดงในรูปที่ 4.9 ซึ่งพบว่าผิวน้ำ ชิ้นงานนี้อยู่ในสถานะที่กำลังจะเกิดการก่อตัวเป็นควบคุมต้มคือต จุดที่มีลักษณะที่กำลังจะเป็น ควบคุมต้มคือตและมีความสูงมากที่สุด คือจุดที่เป็นจุดตัดของเส้นลายตารางที่บานานกับทิศ [1-10] และ [110] ส่วนบริเวณอื่นๆ ไม่มีบริเวณใดเลยที่มีลักษณะเข้าใกล้ลักษณะของควบคุมต้มคือต หากพิจารณาเส้นลายตารางทั้งสองแนว พบร่วมแนวที่บานานกับทิศ [1-10] มีแนวโน้มจะเกิดการก่อตัว ของควบคุมต้มคือตก่อนแนวที่บานานกับทิศ [110] และเมื่อวิเคราะห์บริเวณที่เป็นจุดตัดลายบนบริเวณ

ที่มีความสูงแตกต่างกันเล็กน้อยดังแสดงในรูปที่ 4.10 ซึ่งเป็นของชิ้นงาน 27n [41] วิเคราะห์จากภาพจากกล้องจุลทรรศน์แรงดันโดยผู้เขียน พบว่าการเกิดความตั้มดอตจะเกิดที่จุดตัดที่มีความสูงมากกว่าก่อนจุดตัดที่มีความสูงน้อยกว่า (เรียงต่ำไปสูงจาก 1 ถึง 6) ซึ่งเป็นข้อมูลที่สามารถยืนยันข้อสันนิษฐานวิวัฒนาการดังที่ปรากฏในรูปที่ 4.5 (b) ได้อย่างชัดเจน

จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นนั้นทั้งชิ้นงาน n0815 และ n0817 สามารถยืนยันวิวัฒนาการการเกิดความตั้มดอตบนลายตารางตามข้อสันนิษฐานในรูปที่ 4.5 ได้จริง อย่างไรก็ตามวิธีดังกล่าวมีข้อด้อยคือในหนึ่งชิ้นงานสามารถพิสูจน์สถานะและวิวัฒนาการการเกิดความตั้มดอตบนลายตารางเพียงหนึ่งสถานะจากทั้งหมดสี่สถานะ (ดังรูปที่ 4.5 (b) ถึง (e)) เท่านั้น เพื่อให้สามารถศึกษาวิวัฒนาการของสถานะทั้งสี่ได้อย่างต่อเนื่องในชิ้นงานเดียวกัน จึงต้องทำการทดลองเพิ่มเติมโดยใช้วิธีที่ 2 ดังรายละเอียดในลำดับต่อไป

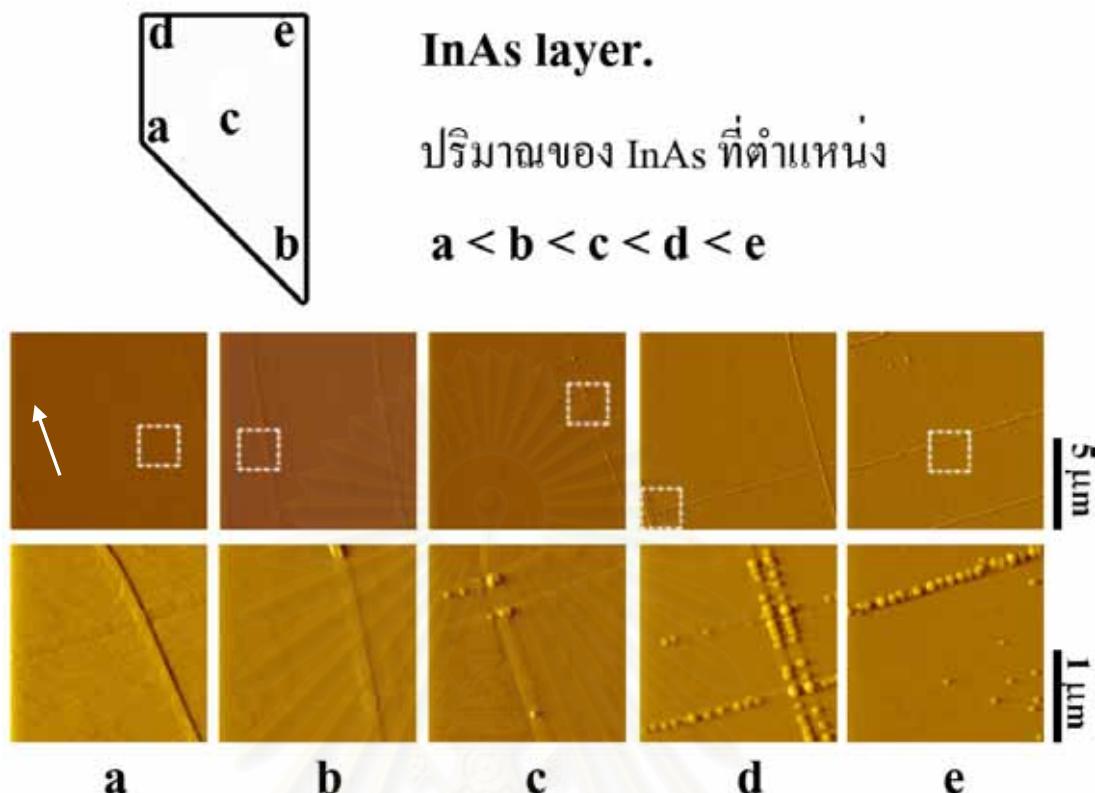
4.2.2 วิธีที่ 2 (ชิ้นงาน n0840)

การปักชิ้นงานในหัวข้อนี้ (n0840) จะใช้วิธีการหยุดมอเตอร์ในขณะปัก (Motor-stop growth) โดยปกติแล้วคำว่าโมเลกุลที่ออกมายากจะหล่อสารปักปล่อยออกมารโคนผิวน้ำอย่างไม่สม่ำเสมอทั้งแผ่นชิ้นงาน [29] เพื่อให้การปักมีความสม่ำเสมอทั่วทั้งแผ่นฐานจึงต้องมีมอเตอร์มาหมุนแทนชิ้นงานเพื่อให้ได้รับ Flux อย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นหากหยุดมอเตอร์ขณะปักอย่างคำว่าโมเลกุลสารใดๆ จะทำให้ชิ้นงานที่หยุดมอเตอร์ระหว่างปักมีอัตราปักไม่สม่ำเสมอทั้งชิ้นงาน เมื่อนำวิธีนี้มาใช้กับการปรับปริมาณ InAs ในชั้นความตั้มดอตที่มีข้อดีคือสามารถปักชิ้นงานเดียวแต่ศึกษาผลของปริมาณ InAs ได้หลายค่าจากตำแหน่งต่างๆ กันบนชิ้นงาน เพราะแต่ละตำแหน่งได้รับอัตราการปักไม่เท่ากันในเวลาเท่ากัน ทำให้ปริมาณ InAs ไม่เท่ากันด้วย ข้อเสียคือการจะหาปริมาณที่แน่นอนของแต่ละตำแหน่งทำได้ยาก เนื่องจากว่ามีโอกาสผิดพลาดจากความไม่แน่นอนของจุดศูนย์กลางของคำว่าโมเลกุลแต่ละคำและความไม่เป็นอุบัติจากอีกหลายตัวแปร

ชิ้นงาน n0840 คือชิ้นงานที่หยุดมอเตอร์ในขณะปักชั้นความตั้มดอตในขณะที่ชิ้นอื่นๆ ยังคงหมุนอยู่ตามปกติ เพราะว่าต้องการแปรค่าเฉพาะปริมาณ InAs ในชั้นความตั้มดอตเท่านั้น โครงสร้างชิ้นนี้ยังคงคล้ายกับชิ้นอื่นๆ ที่ผ่านมา คือเป็นความตั้มดอตทับบนชิ้นลายตาราง $In_{0.1}Ga_{0.9}As$ หนา 50 nm บนแผ่นฐาน GaAs (001) ซึ่งในระหว่างปักชั้น InAs ความตั้มดอตได้ทำการหยุดมอเตอร์และหยุดการปักเมื่อ RHEED pattern เปลี่ยนจาก Streaky เป็น Spotty pattern

ผลจากการปลูกด้วยวิธีนี้ทำให้ผิวน้ำชี้งงานอาจมีหรือไม่มีความตั้มดอต์ได้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งดังแสดงในรูปที่ 4.11 ซึ่งผลที่ได้ก็สนับสนุนข้อสรุปที่ได้จากวิธีที่ 1 พิจารณาจากจุด c ซึ่งเป็นจุดที่ได้รับ Flux สูงที่สุด หมายถึงมีปริมาณ InAs ในชั้นความตั้มดอตมากที่สุด จึงมีความตั้มดอตบนพื้นเรียบและบนเส้น ในขณะที่จุด d มีปริมาณ InAs น้อยกว่าจุด e อよู่ 1 ขึ้น มีผลพากล่าวความตั้มดอตบนเส้น ซึ่งบนเส้นลายตารางที่นานกับทิศ [1-10] มีความตั้มดอตหนาแน่นมากกว่าบนเส้นลายตารางที่นานกับทิศ [110] สำหรับจุด c ซึ่งมีปริมาณ InAs น้อยกว่าที่จุด d อีก 1 ขึ้น พบว่าความตั้มดอตบนจุดตัดของเส้นลายตารางทึ้งสองแนวมีขนาดใหญ่กว่าบนแต่ละเส้น ในขณะที่จุด b พบรุ่นที่กำลังจะก่อตัวเป็นความตั้มดอตบนจุดตัดเส้นลายตารางทึ้งสองแนว และได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าในตำแหน่งสีน้ำเงินของเส้นลายตารางมีลักษณะคล้ายความตั้มดอต และจุดที่ได้รับ InAs น้อยที่สุดในชั้นงานคือจุด a ซึ่งที่จุดนี้ แม้แต่ที่จุดตัดของเส้นลายตารางทึ้งสองแนว ก็ไม่มีลักษณะที่ความตั้มดอตกำลังก่อตัวอยู่เลย อย่างไรก็ตาม พบว่าจุดที่ TD ที่เป็นส่วนปลายของ MD ซึ่งมาปรากฏที่ผิวน้ำกลับมีลักษณะที่คล้ายกับว่ากำลังจะก่อตัวเป็นความตั้มดอต คล้ายกับผลที่ได้จากจุด b จึงสรุปได้ว่าความตั้มดอตจะก่อตัวที่ TD ก่อน หลังจากนั้นจึงก่อตัวที่จุดตัดของเส้นลายตารางทึ้งสองแนว

จากผลการทดลองทึ้งสองวิธีในหัวข้อ 4.2.1 และ 4.2.2 ข้างต้น ทำให้ได้ข้อสรุปชัดเจนถึงวิวัฒนาการการก่อตัวของความตั้มดอตบนพื้นผิวลายตารางว่า ความตั้มดอตจะก่อตัวที่ TD ก่อน ตามด้วยที่จุดตัดของเส้นลายตารางทึ้งสองแนว ตามด้วยบนเส้นลายตารางที่นานกับทิศ [1-10] ตามด้วยบนเส้นลายตารางที่นานกับทิศ [110] และบนพื้นเรียบตามลำดับ สำหรับเหตุผลของการเกิดวิวัฒนาการเช่นนี้มาจากการที่ Strain field ที่ไม่เท่ากันของแต่ละตำแหน่งบนพื้นผิวลายตารางดังรายละเอียดในหัวข้อด้านไป

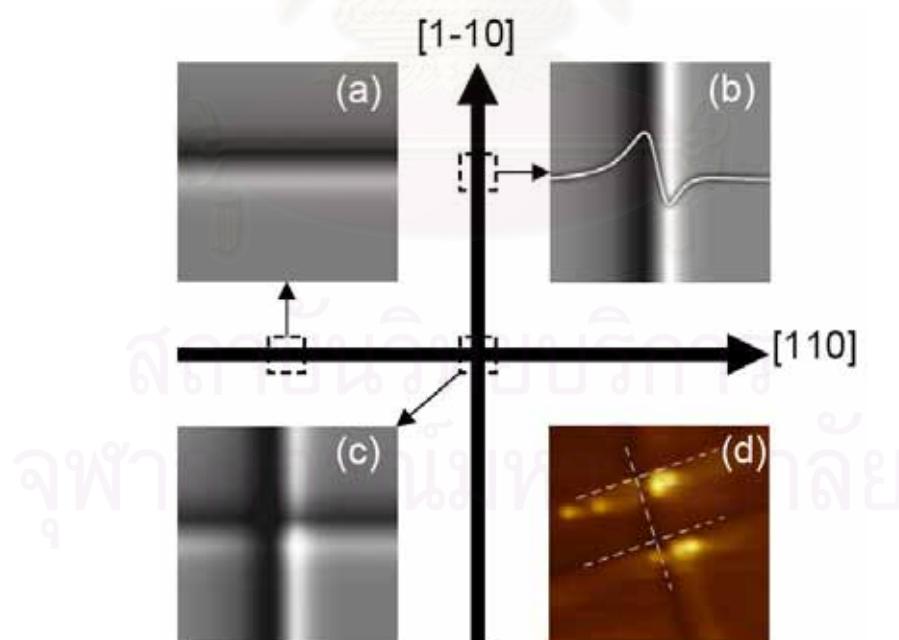


รูปที่ 4.11 ผิวน้ำชีนงาน n0840 ที่ตำแหน่งต่างๆ กันแสดงถึง InAs ความตั้มดอตบนชั้นลายตารางที่ปริมาณ InAs ต่างๆ กัน ลูกศรแสดงทิศ [1-10] ภาพจากกล้องจุลทรรศน์แรงดันแม่บานเป็นภาพขนาด $10 \times 10 \mu\text{m}^2$ และแควรล่ามีขนาด $2 \times 2 \mu\text{m}^2$ เป็นส่วนขยายจากบริเวณที่ตีกรอบในภาพบน

4.3 สาเหตุการเกิดความตั้มดอตบนพื้นผิวลายตาราง

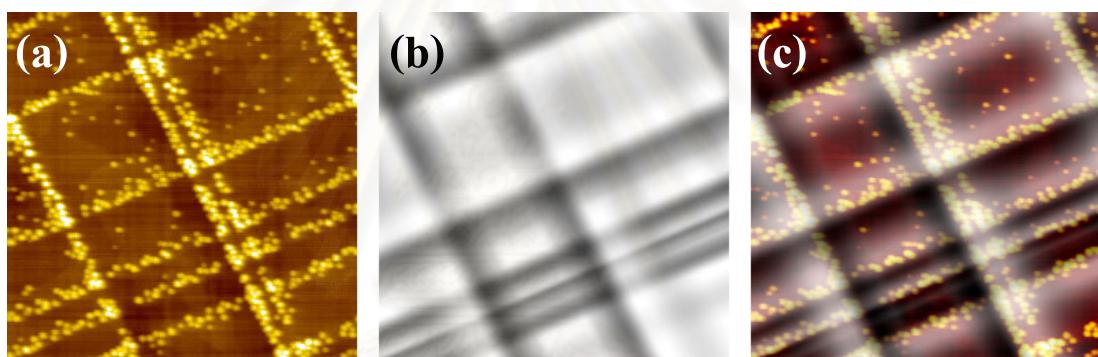
แบบจำลองที่นำมาอธิบายวิวัฒนาการการเกิดความตั้มดอตบนลายตารางนั้นอาศัยหลักการของการกระจายตัวของความเค้นที่ผิวน้ำของฟิล์ม (Stress distribution, σ_{xx}^{MD}) ของ Surface step ที่ผิวน้ำที่เกิดจาก MD [13,42] ทั้งของลายตารางแนวทิศ [1-10] และ [110] ดังรูปที่ 4.12 ซึ่งแสดงแบบจำลองการกระจายตัวของความเค้นที่ผิวน้ำของฟิล์มแบบสองมิติ (รูปที่ 4.12 (c)) จากการซ้อนกัน (Superimpose) ของการกระจายตัวในหนึ่งมิติของแนว [110] (รูปที่ 4.12 (a)) และ [1-10] (รูปที่ 4.12 (b)) ซึ่งสืบถึงด้วยระดับความเข้มของสีใน (a), (b) และ (c) โดยสีดำหมายถึงบริเวณที่มีความเค้นมาก สีขาวหมายถึงบริเวณที่มีความเค้นน้อย จะเห็นว่าความเค้นจากทั้งสองแนวมีลักษณะคล้ายกัน แต่การกระจายตัวและปริมาณความเค้นที่ต่างกันจากเส้นลายตารางชนิด α -type และ β -type จากเส้นแนว [1-10] และ [110] ตามลำดับที่มีคุณสมบัติต่างกัน [3,43] ในแบบจำลองนี้ให้

เส้นลายตารางในแนวขานานกับทิศ [1-10] มีลักษณะการกระจายตัวของความเคี้ยวที่ผิวน้ำพิล์มที่หมายแก่การก่อตัวของ InAs ความตั้มดอตมากกว่าแนว [110] สังเกตุได้จากสี โดยที่ InAs มีโอกาสก่อตัวบนสีอ่อนมากกว่าสีเข้ม (หรือมีโอกาสก่อตัว ณ บริเวณที่มีสีอ่อนกว่าก่อนหากทำการปูกรพร้อมกัน) ดังนั้นมีอิจารณาว่าความเคี้ยวสามารถรวมกันแบบเชิงเส้นได้ จึงสามารถทำการซ้อนทับภาพ Grayscale ในรูปที่ 4.12 (a) และ (b) โดยตรงให้ผลดังในรูปที่ 4.12 (c) โดยส่วนที่เป็นสีอ่อนที่สุดจึงเกิด ณ จุดที่แยกสีอ่อนของทั้งสองแนวพาดผ่านกัน ซึ่งบริเวณที่สีอ่อนที่สุดในรูปที่ 4.12 (c) จะอ่อนมากกว่าบริเวณແບสีอ่อนจากแต่ละแนวในรูปที่ 4.12 (a) และ (b) ด้วย เมื่อพิจารณาความเคี้ยวของพื้นผิวนี้จะเห็นได้จากความเข้มของระดับ Grayscale ในรูปที่ 4.12 (c) แล้วพบว่า บริเวณที่ความเคี้ยวอัดต่ำที่สุด (สีอ่อน) คือจุดตัดของແບความเคี้ยวอัดต่ำที่สุดจากทั้งสองแนว ส่วนที่มีความเคี้ยวอัดสูงขึ้นมาอีกระดับคือบริเวณที่ความเคี้ยวอัดต่ำที่สุดบนแนวเส้นที่ขนานกับทิศ [1-10] ความเคี้ยวอัดมากขึ้นในระดับต่อมากที่คือบริเวณที่ความเคี้ยวอัดต่ำที่สุดบนแนวเส้นที่ขนานกับทิศ [110] ส่วนที่ความเคี้ยวอัดมากจนเป็นสีเทาคือบนพื้นเรียบ ซึ่งแบบจำลองนี้ อธิบายได้ตรงตามผลการทดลองที่นำมาข้างต้น เนื่องจากลำดับการเกิดความตั้มดอตของการทดลองเรียงจากก่อนไปหลัง สอดคล้องกับแบบจำลองที่เรียงความเคี้ยวอัดจากน้อยไปมาก



รูปที่ 4.12 ภาพแสดงแบบจำลองของการกระจายตัวของความเครียดบนผิวน้ำสองมิติของชั้นลายตาราง (a) ของแนว [110] (b) ของแนว [1-10] และ (c) ของจุดตัดของทั้งสองแนว (d) ภาพจากกล้องจุลทรรศน์ขนาด $1 \times 1 \mu\text{m}^2$ แสดงผิวน้ำและเส้นประหมายถึงบริเวณที่แบบจำลองเป็นสีเข้มที่สุด

อย่างไรก็ตามจากแบบจำลองพบว่าขั้นมีบริเวณที่ความตั้มดอตมีโอกาสก่อตัวขึ้นอยกว่าหรือก่อตัวขึ้นช้ากว่าบริเวณพื้นเรียบ (สีเทาคลาย) คือบริเวณอิกด้านหนึ่งของลายตาราง (สีเข้มที่สุด) ดังแสดงในรูปที่ 4.12 (d) บริเวณที่เป็นเส้นประคือบริเวณที่ความตั้มดอตมีโอกาสก่อตัวขึ้นน้อยที่สุดหรืออิกนัยหนึ่งคือหากทำการปลูกความคัมดอตพร้อมกันทั่วทั้งผิวน้ำ บริเวณดังกล่าวจะเกิดความตั้มดอตเป็นบริเวณสุดท้าย ข้อสันนิษฐานนี้สามารถยืนยันได้จากผิวน้ำของชิ้นงาน n0702 ดังแสดงในรูปที่ 4.5 (a) เมื่อพิจารณาร่วมกับแบบจำลองแบบเดียวกับรูปที่ 4.12 โดยการทับซ้อนกันเพื่อให้เห็นชัดเจนดังแสดงไว้ในรูปที่ 4.13 (c) บริเวณสีอ่อนจะมีความตั้มดอตก่อตัวอยู่และจะลดหลั่นกันไปตามสีที่เข้มขึ้น และบริเวณที่เป็นสีเข้มที่สุดจะไม่มีความตั้มดอตอยู่เลย ซึ่งสรุปได้ว่าแบบจำลองการกระจายตัวของความเค้นที่ผิวน้ำฟิล์มสามารถใช้พิจารณาวิวัฒนาการการเกิดความตั้มดอตบนลายตารางได้จริง



รูปที่ 4.13 (a)ภาพจากกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอมขนาด $2 \times 2 \text{ } \mu\text{m}^2$ แสดงผิวน้ำชิ้นงาน n0702 (b) การกระจายตัวของความเค้นอัดที่ผิวน้ำฟิล์มจาก Surface step แต่ละเส้นของ n0702 ทับซ้อนกัน ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับที่ใช้ในรูปที่ 4.12 โดยสีอ่อนหมายถึงความเค้นอัดต่ำ สีเข้มหมายถึงความเค้นอัดสูง (c) นำ b ไปซ้อนทับบน a และถึงโอกาสที่แต่ละบริเวณจะมีการก่อตัวของความตั้มดอต

แบบจำลองในรูปที่ 4.12 (a), (b) และ (c) สามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีของความเค้นอัด (Compressive stress) ความเค้นยืด (Tensile stress) และการอพยพของอะตอมที่ผิวน้ำ (Surface atom migration) เมื่อเริ่มแรกการปลูกชั้นลายตาราง InGaAs ถูกปลูกขึ้นบน GaAs ระนาบ (001) ชั้นอะตอมชั้นแรกๆ ของ InGaAs บน GaAs ก่อตัวอย่างนีบอัดกันอยู่ โดยก่อตัวด้วยค่าคงที่ผลึกแนวนานกับผิวน้ำ ($a_{//}$) ที่เท่ากันกับ GaAs และค่าคงที่ผลึกแนวด้านกับผิวน้ำ (a_{\perp}) จะสูงกว่าของ InGaAs ทำให้เกิดความเครียดสะสม เมื่อก่อตัวไปนานขึ้นเรื่อยๆ จะนิ่งค่าความหนาวิกฤติ (h_c)

ความเครียดสะสมถูกผ่อนคลายลง (Strain relaxation) ด้วยการเกิดของ MD และ TD แม้ว่า ความเครียดจะถูกลดโดย Dislocation ที่เกิดขึ้นดังที่อธิบายไว้ที่หัวข้อ 2.2 แต่ความความกึ่นตามแนว MD นั้นสูงมาก [13] โดยด้านหนึ่งของ MD จะเป็นความกึ่นอัด อีกด้านจะเป็นความกึ่นยืด เมื่อความกึ่นทั้งสองชนิดดังกล่าวเกิดขึ้นในสองฝั่งของ MD ทำให้เกิดการอพยพของอะตอม In เมื่อ การปลูกชั้น InGaAs ดำเนินต่อไป การอพยพของอะตอม In จะเกิดขึ้นในลักษณะที่ทำให้พลังงานรวมของระบบต่ำที่สุด ดังนั้นอะตอม In จึงพยายามอพยพไปด้านที่มีการเกาะกันของ In ให้มี ความเครียดน้อยที่สุด ก็คือด้านที่มีค่าคงที่ผลึกใหญ่ (เนื่องจาก InAs มีค่าคงที่ผลึกที่สูงกว่า GaAs) หรือด้านที่เป็นความกึ่นยืดนั่นเอง จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่สนับสนุนว่า ลายตารางที่ผิวน้ำเจิng มีด้านหนึ่งที่ InAs ความตั้มดอตสามารถก่อตัวได้เร็วกว่าอีกด้านหนึ่ง และเร็วกว่าบริเวณอื่น ซึ่งเป็นที่มาของรูปแบบความกึ่นที่ผิว (σ_{xx}) ที่สัมพันธ์กับระบบระนาบผิวน้ำดังแสดงในรูปที่ 4.12 (b)

ความตั้มดอต InAs มีเอกลักษณ์ของว่างพลังงานแบบ Direct ดังนั้นหากมีการกระตุ้นพาหะภายในความตั้มดอตให้มีพลังงานมากขึ้นจนเปลี่ยนสถานะจากสถานะพื้น (Ground state) ไปอยู่ใน สถานะกระตุ้น (Excited state) ได้ เมื่อพาหะคายพลังงานออกมานี้เพื่อกลับสู่สถานะพื้น พลังงานที่ ออกมานี้จะอยู่ในรูปไฟฟoton ซึ่งการเปล่งแสงเมื่อมีการกระตุ้นพาหะนี้สามารถวัดได้ด้วยระบบวัด การเปล่งแสงไฟฟoton ที่มีชื่อว่าphotoluminescence (Photoluminescence) ซึ่งได้กล่าวถึงในหัวข้อ 3.2.2 การเปล่งแสง ของความตั้มดอตที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อนกว่าปกติ เช่นความตั้มดอตโมเลกุล จะให้ผลการเปล่งแสงออกมามีค่ายอดคลายค่าและยังแปรตามพลังงานที่ใช้กระตุ้นด้วย (Power dependence) [2,34] การพิจารณาหาต้นตอของค่ายอดแต่ละค่าและระดับพลังงานของสถานะภายในโครงสร้าง ความตั้มดอตโมเลกุลจึงต้องอาศัยการจำลองโครงสร้างเสมือนจริงด้วยคอมพิวเตอร์ช่วย ดังที่จะกล่าวในหัวข้อต่อไป

4.4 คุณสมบัติเชิงแสงของความตั้มดอตโมเลกุล

ความตั้มดอตโมเลกุล (Quantum Dot Molecules: QDMs) เป็นผลมาจากการพยากรณ์ใน การปลูกความตั้มดอตความหนาแน่นสูง (High density) ซึ่งปลูกได้ด้วยวิธีการกลบทับแบบบาง- ปลูกทับช้ำ (Thin-capped-and-regrowth) บนแผ่นฐานเรียบคือ GaAs (100) [34] แต่ก็ยังสามารถปลูกบนแผ่นฐานลายตารางได้ด้วย ความตั้มดอตโมเลกุลมีลักษณะเฉพาะของการเรียงตัว กล่าวคือ ความตั้มดอตโมเลกุลประกอบด้วยความตั้มดอตสองขนาด คือขนาดใหญ่ที่เป็นศูนย์กลาง (Center

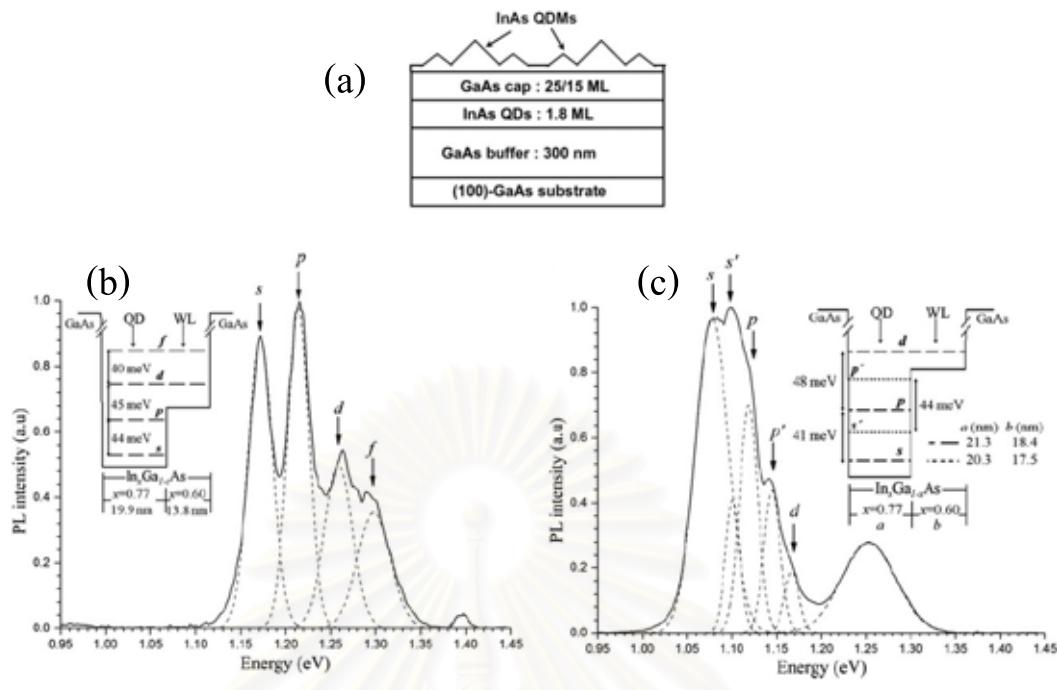
dot) และความตั้มดอตขนาดเล็กที่ล้อมรอบ (Satellite dot) ในปริมาณที่มากกว่า ซึ่งความตั้มดอตไม่เลกุลนี้ถูกใช้ในโครงสร้าง Photovoltaic เพื่อเพิ่มปริมาณการดูดซับแสง

คุณสมบัติในการซับแสงและเปล่งแสงเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของความตั้มดอตและถูกใช้ในสิ่งประดิษฐ์ทางแสงมากmany การปรับคุณสมบัติเกี่ยวกับแสงนี้สามารถทำการปรับปรุงได้โดยเพิ่มความหนาแน่นของความตั้มดอตและให้ความตั้มดอตทั้งหมดมีขนาดที่เป็นขนาดเดียวกันหรือใกล้เคียงที่สุด (Uniformity)

การศึกษาถึงผลการเปล่งแสงของชิ้นงานที่มีโครงสร้างความตั้มดอตไม่เลกุลในอัตราที่ผ่านมาซึ่งไม่ได้มีการศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เท่าไรนัก จึงได้มีการทดลองเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปล่งแสงของโครงสร้างความตั้มดอตไม่เลกุล โดยการใช้การจำลอง (Simulation) โครงสร้างเสมือนจริงและการคำนวณทางฟิสิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้สมการ Schrödinger-Poisson แบบหนึ่งมิติเป็นพื้นฐานในการจำลอง (ใช้โปรแกรม 1D-Poisson ในการจำลองโครงสร้างและระดับพลังงาน)

การจำลองโครงสร้างเสมือนจริงภายในคอมพิวเตอร์นี้ใช้ข้อมูลทางกายภาพจากกล้องจุลทรรศน์และตอนของชิ้นงานจริงที่นำมาวัด ซึ่งผลที่ได้จากการจำลองโครงสร้างเสมือนจริงของโครงสร้างความตั้มดอตไม่เลกุลได้ออกมาในรูปของระดับพลังงานทั้งหมดที่เป็นไปได้ที่พำนัชทั้งอิเล็กตรอนและไอออนสามารถอยู่ได้ ตรงนี้จะนำไปสู่ผลการเปล่งแสงด้วยเช่นกัน

นอกจากข้อมูลทางกายภาพของชิ้นงานแล้วยังต้องใช้ผลการเปล่งแสงที่วัดได้จากชิ้นงานด้วยเพื่อให้การศึกษาผลการเปล่งแสงของโครงสร้างความตั้มดอตไม่เลกุลจากการจำลองโครงสร้างเสมือนจริงแบบหนึ่งมิติเป็นไปอย่างสมบูรณ์ สำหรับผลการเปล่งแสงที่วัดได้จากชิ้นงานนี้จะออกมารูปของ Spectral response ซึ่งสามารถนำผลการเปล่งแสงจริงไปผ่านเครื่องมือที่สร้างขึ้นมาเอง เพื่อให้ได้ผลออกมารูปของผลบวกของ Gaussian function ที่ค่ายอด (Peak) และความกว้างแอบที่ค่ายอด (Full-width-at-half-maximum: FWHM) ต่างๆกัน ทำให้สามารถจำแนกผลการเปล่งแสงของชิ้นงานจริงได้เป็น Peak และ FWHM หลายๆค่า ซึ่งสามารถนำค่าที่ได้ดังกล่าวทำการปรับแต่งโครงสร้างเสมือนจริงให้สามารถอธิบายผลการเปล่งแสงดังกล่าวได้



รูปที่ 4.14 (a) ภาพตัดขวางของโครงสร้างความตั้มดอตโมเลกุลผลและผลการเปล่งแสงที่วัดได้จากชิ้นงานจริง (เส้นทึบ) และผลจากการใช้เครื่องมือเพื่อจำแนกออกเป็น Gaussian functions (เส้นประ) ของชิ้นงานที่มีการกลบทับแบบบาง (a) 15 และ (b) 25 ML รูปเด็กที่แทรกอยู่แสดงถึงโครงสร้างที่สามารถอธิบายผลการเปล่งแสงที่แสดงไว้ได้ [35]

ประโยชน์ที่ได้รับจากการทดลองนี้คือสามารถขยายผลจากความตั้มดอตโมเลกุลไปเป็นผลสำหรับความตั้มดอตบนลายตารางได้ เพราะว่าความตั้มดอตบนลายตารางนั้นแต่ละตำแหน่งจะมีความตั้มดอตที่มีความสูงไม่เท่ากัน ซึ่งเหมือนกับกรณีความตั้มดอตโมเลกุล แต่ความความตั้มดอตบนลายตารางมีความซับซ้อนในการจำลองโครงสร้างมากกว่า การจำลองโครงสร้างเสมือนจริงจึงทำได้ยากกว่า การทดลองในส่วนนี้จึงเป็นเหมือนการเก็บข้อมูลเพื่อวัดผลการเปล่งแสงจริงๆของโครงสร้างความตั้มดอตบนลายตารางด้วย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทที่ 5

สรุป

วิจัยการของการเกิดความตั้มดอต InAs ที่ปัจจุบันแผ่นฐานลายตาราง InGaAs เป็นปัจจุบัน บทสู่การพัฒนาการศึกษาด้านการเกิดของความตั้มดอต และแผ่นฐานลายตาราง ความตั้มดอตที่ปัจจุบันชั้นลายตารางมีความแตกต่างจากความตั้มดอตบนแผ่นฐานธรรมชาติเห็นได้ชัดที่สุดคือ ปริมาณของ InAs ที่ใช้ในการก่อตัวขึ้นเป็นความตั้มดอตบนแผ่นฐานลายตารางนั้นใช้เพียง 0.8 ML ต่างจาก 1.8 ML ของการปัจจุบันแผ่นฐาน GaAs ปกติ นอกจากนี้ความตั้มดอตที่ปัจจุบันแผ่นฐานลายตารางยังถูกก่อตัวขึ้นในเวลาที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนด้วย

หัวข้อวิทยานิพนธ์นี้เกิดขึ้นมาจากการสังเกตุลักษณะทางกายภาพของพื้นผิวของความตั้มดอตบนแผ่นฐานลายตารางที่มีลักษณะร่วมคือ ความตั้มดอตบนแผ่นฐานลายตารางสามารถแบ่งตามเกณฑ์ความสูงได้เป็นสี่กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มความตั้มดอตที่ก่อตัวบนจุดตัดของเส้นลายตารางทั้งสองแนว 2) กลุ่มความตั้มดอตที่ก่อตัวบนเส้นลายตารางที่ขนานกับทิศ [1-10] 3) กลุ่มความตั้มดอตที่ก่อตัวบนเส้นลายตารางที่ขนานกับทิศ [110] และ 4) กลุ่มความตั้มดอตที่ไม่ได้ก่อตัวบนเส้นลายตาราง ความสูงที่ต่างกันดังกล่าวบ่งชี้ได้ว่าความตั้มดอตถูกก่อตัว ณ เวลาที่ต่างกัน ซึ่งข้อมูลด้านวิจัยการการเกิดความตั้มดอตบนแผ่นฐานลายตารางยังไม่เคยปรากฏมาก่อน

การทดลองเพื่อหาวิจัยการของการเกิด InAs ความตั้มดอตบนแผ่นฐานลายตาราง นำไปสู่การปัจจุบันสร้างที่มีการปรับค่าตัวแปรต่างๆ แบ่งออกเป็นการปรับตัวแปรในการปัจจุบันชั้นลายตารางและการปรับตัวแปรในการปัจจุบันความตั้มดอต สำหรับการปรับตัวแปรในการปัจจุบันชั้นลายตาราง ได้ศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของ In ในชั้นลายตาราง InGaAs ตั้งแต่ 8% ไปถึง 20% ทำให้ทราบจากผลการวัดผิวหน้าว่าสัดส่วนของ In ที่น้อยลงมีผลให้ลายตารางทั้งสองแนวมีปริมาณน้อยลง ไปด้วย ส่วนการปรับตัวแปรในชั้นความตั้มดอตเพื่อสังเกตและวิเคราะห์วิจัยการการเกิดความตั้มดอตบนลายตารางทำได้สองวิธี วิธีแรกคือการลดปริมาณการปัจจุบัน InAs ในชั้นความตั้มดอต ซึ่งได้ทำการปัจจุบันงานอีกสองชั้นที่ลดความหนาของชั้น InAs ลงจาก 0.8 ML เหลือ 0.76 และ 0.72 ML และวิธีที่สองคือการหยุดมอเตอร์ขณะปัจจุบันชั้นความตั้มดอต ซึ่งสามารถปรับปริมาณ InAs ให้นำากหรือน้อยได้ในชั้นงานเดียวกัน โดยแต่ละตำแหน่งบนชั้นงานจะได้รับ InAs ไม่เท่ากัน เมื่อวัดผิวหน้าที่ตำแหน่งต่างกันก็จะได้ผลของ InAs ความตั้มดอตในปริมาณ

ต่างกัน ผลที่ได้จากการทดลองทั้งสองวิธีสามารถขึ้นยั่นข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับดำเนินการเกิดก่อนหลังได้และสามารถสรุปวิวัฒนาการของการเกิดความตั้มดอตบนผิวน้ำลายตารางได้ดังนี้ คือ InAs ความตั้มดอตจะเกิดที่ Threading dislocation ก่อน, ตามด้วยตำแหน่งที่เป็นจุดตัดของเส้นลายตารางทั้งสองแนว, ตามด้วยบนแนวเส้นลายตารางที่ขานานกับทิศ [1-10], ตามด้วยบนแนวเส้นลายตารางที่ขานานกับทิศ [110] และตามด้วยบนบริเวณพื้นเรียบ โดยปัจจัยที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดวิวัฒนาการดังกล่าวคือ ความเก็บอัด, ความเก็บยึด และการอพยพของอะตอม In ที่ผิวน้ำ ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นโดยการ Simulation ระดับความคืบหน้าลายตารางและเปรียบเทียบกับผลจริงจากภาพจากกล้องจุลทรรศน์แรงดึงดูด

ผลที่ได้จากการศึกษาวิวัฒนาการและเทคนิคที่ใช้ในการศึกษาวิวัฒนาการการเกิดความตั้มดอตบนลายตารางที่นำเสนอไว้ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของโครงสร้างนาโนชนิดอื่นได้ไม่ว่าจะเป็น ความตั้มดอตโมเลกุลหรือความตั้มริง เป็นต้น โดยไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นวัสดุในตระกูล InGaAs / GaAs เท่านั้น นอกจากนี้ ข้อมูลด้านวิวัฒนาการของความตั้มดอตบนผิวน้ำลายตารางนี้ ยังมีประโยชน์ต่อความเข้าใจในโครงสร้างทางกายภาพของความตั้มดอตที่ถูกปลูกบนผิวที่ไม่ใช่รูบแบบ (100) หรือบนแผ่นฐานชนิด offcut ซึ่งจะส่งผลกระทบถึงการตีความผลการเปลี่ยนแปลงแสงของโครงสร้างดังกล่าว

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการอ้างอิง

- [1] D. Bimberg, M. Grundmann, and N. N. Ledentsov. Quantum Dot Heterostructure. Chichester : Wiley, 1998.
- [2] N. Siripitakchai, Control of The Number of Dots In InAs Quantum Dot Molecules for Quantum Computing. Master's thesis. Department of Electrical Engineering. Faculty of Engineering, Chulalongkorn University, 2006.
- [3] C. C. Thet. Growth and Characterisation of Ordered InAs Quantum Dots on Cross-hatch Virtual Substrate. Ph. D.'s thesis. Department of Electrical Engineering. Faculty of Engineering, Chulalongkorn University, 2006.
- [4] S. Kiravittaya. Homogeneity Improvement of InGaAs/GaAs Self-assembled Quantum Dots Grown by Molecular Beam Epitaxy. Ph. D.'s thesis. Department of Electrical Engineering. Faculty of Engineering, Chulalongkorn University, 2002.
- [5] S. Suraprapapich. Self-assembled Quantum Dot Molecules by Molecular Beam Epitaxy and Their Potential Applications. Ph. D.'s thesis. Department of Electrical Engineering. Faculty of Engineering, Chulalongkorn University, 2003.
- [6] L. Jacak, P. Hawrylak, and A. Wójs. Quantum Dots. Berlin, Germany : Springer-Verlag, 1998.
- [7] S. Suhikonen, O. Svensk, T. Lang, H. Lipsanen, et al. The Effect of InGaN/GaN MQW Hydrogen Threading Dislocation Optimization on GaN LED Efficiency. Journal of Crystal Growth 298 (2007) : 740-743.
- [8] C. Huh, W. J. Schaff, L. F. Eastman, and S. J. Park. Temperature Dependence of Performance of InGaN/GaN MQW LEDs With Different Indium Compositions. IEEE Electron Device Letter 25 (2004) : 61-63.

- [9] S. Suraprapapich, S. Kanjanachuchai, S. Thainoi, and S. Panyakeow. Self-assembled lateral InAs Quantum Dot Molecules: Dot ensemble control and polarization dependent photoluminescence. Microelectronic engineering 83 (2006) : 1526-1529.
- [10] P. Bhattacharya, et al. Properties of Lattice matched and Strained Indium Gallium Arsenide. London : INSPEC, 1993.
- [11] A. M. Andrews, J. S. Speck, A. E. Romanov, M. Bobeth, and W. Pompe. Modeling Cross-hatch Surface Morphology in Growing Mismatched Layer. Journal of Applied Physics 91 (2002) : 1933-1943.
- [12] K. Samonji, H. Yonezu, Y. Takagi, and N. Ohshinma. Evolution Process of Cross-hatch Patterns and Reduction of Surface Roughness in $(\text{InAs})_m(\text{GaAs})_n$ Strained Short-period Superlattices and InGaAs Alloy Layers Grown on GaAs. Journal of Applied Physics 86 (1999) : 1331-1339.
- [13] A. M. Andrews, J. S. Speck, A. E. Romanov, M. Bobeth, and W. Pompe. Modeling Cross-hatch Surface Morphology in Growing Mismatched Layer. Journal of Applied Physics 91 (2002) : 1933-1943.
- [14] A. E. Romanov, W. Pompe, S. Mahtis, G. E. Beltz, and J. S. Speck. Threading Dislocation Reduction in Strained Layers. Journal of Applied Physics 85 (1999) : 182-192.
- [15] C. C. Thet, S. Sanorpim, S. Panyakeow, and S. Kanjanachuchai. The Effect of Relaxed InGaAs Virtual Substrates on the Formation of Self-Assembled InAs Quantum Dots. Semiconductor Science and Technology 23 (2008) : 055007.
- [16] T. Limwongse, S. Panyakeow, and S. Kanjanachuchai. Evolution of InAs Quantum Dots Grown on Cross-Hatch Substrates. Physica Status Solidi. (Submitted).

- [17] S. J. Ahn, K. H. Kim, and K. H. Yoon. Cu(In,Ga)Se₂ Thin Film Solar Cell from Nanoparticle Precursors. Current Applied Physics 8 (2008) : 766-769.
- [18] I. Daruka and A. L. Barabasi. Dislocation-free island formation in heteroepitaxial growth: A study at equilibrium. Physical Review Letters 79 (1997) : 3708-3711.
- [19] B. G. Streetman, and S. Banerjee. Solid State Electronic Devices. : 5th edition Prentice hall, 2000.
- [20] S. Kayali, G. Ponchak, and R. Shaw. GaAs MMIC Reliability Assurance Guideline for Space Application : Jet Propulsion Laboratory, 1996.
- [21] S. Adachi. Physical Properties of III-V Semiconductor Compounds. Canada : Wiley, 1992.
- [22] O. G. Schmidt, S. Kiravittaya, Y. Nakamura, et al. Self-assembled Semiconductor Nanostructures : Climbing up The Ladder of Order. Surface Science 514 (2002) : 10-18.
- [23] S. Franchi, G. Trevisi, L. Seravalli, and P. Frigeri. Quantum Dot Nanostructures and Molecular Beam Epitaxy. Progress in Crystal Growth and Characterization of Materials 47 (2003) : 166-195.
- [24] E. A. Fitzgerald, S. B. Samavedam, Y. H. Xie, and L. M. Giovane. Influence of Strain on Semiconductor Thin Film Epitaxy. Journal of Vacuum Science Technology A 15 (1997) : 1048-1056.
- [25] Y. H. Xie, S. B. Samavedam, M. Bulsara, T. A. Lango, and E. A. Fitzgerald. Relaxed Template of Fabricating Regularly Disturbed Quantum Dot Arrays. Applied Physics Letter 71 (1997) : 3567-3568.

- [26] C. Ferrari, G. Rossetto, and E. A. Fitzgerald. Misfit Dislocation and Threading Dislocation Distributions in InGaAs and GeSi/Si Partially Relaxed Heterostructure. Material Science and Engineering B 91-92 (2002) : 437-440.
- [27] W. Braun. Applied RHEED : Reflection High-Energy Electron Diffraction During Crystal Growth. Berlin, Germany : Springer-Verlag, 1999.
- [28] A. Ichimiya, and Philip, I. Cohen. Reflection High-Energy Electron Diffraction. Cambridge : University of Cambridge, 2004.
- [29] M. B. Panish, and H. Temkin. Gas Source Molecular Beam Epitaxy. Berlin, Germany : Springer-Verlag, 1993.
- [30] Paul. Apparatus For Separating Charged Particles Of Different Specific Charges, Patent number: 2939952 : 1960.
- [31] M. Luysberg, H. Sohn, A. Prasad, et al. Effect of The Growth Temperature and As/Ga Flux Ratio on The Incorporation of Excess As into Low Temperature Grown GaAs. Journal of Applied Physics 83 (2008) : 561-566.
- [32] P. B. Joyce, T. J. Krzyzewski, P. H. Steans, et al. Shape and Surface Morphology Changes During The Initial Stages of Encapsulation of InAs/GaAs Quantum Dots. Surface Science 492 (2001) : 345-353.
- [33] J. W. Lee, D. Schuh, M. Bichler, and G. Abstreiter. Advanced Study of Various Characteristics Found in RHEED Patterns During The Growth of InAs Quantum Dots on GaAs (001) Substrate by Molecular Beam Epitaxy. Applied Surface Science 228 (2004) : 306-312.
- [34] S. Suraprapapich, S. Thainoi, S. Kanjanachuchai, and S. Panyakeow. Self-Assembled Quantum Dot Molecules by Molecular-Beam Epitaxy. Journal of Vacuum Science Technology B 23 (2005) : 1217-1220.

- [35] N. Thudsalingkarnsakul, T. Limwongse, N. Siripitakchai, S. Panyakoew, and S. Kanjanachuchai. Effective One-dimensional Electronic Structure of InGaAs Quantum Dot Molecule. Microelectronic Engineering 85 (2008) : 1225-1228.
- [36] O. G. Schmidt, Efforts toward a Deterministic Quantum Dot Technology. The 5th International Conference on Semiconductor Quantum Dots, pp 47. South Korea : 2008.
- [37] B. Pérez, Rodríguez, J. Mirecki Millunchick. The Role of Morphology in The Relaxation of Strain in InGaAs/GaAs. Journal of Crystal Growth 264 (2004) 64-69.
- [38] P. I. Gaiduk, A. N. Larsen, and J. L. Hansen. Strained-relaxed SiGe/Si Heteroepitaxial Structures of Low Threading-dislocation Density. Thin Solid Film 367 (2000) : 120-125.
- [39] A. M. Andrew, A. E. Romanov, J. S. Speck, et al. Development of Cross-hatch Morphology During Growth of Lattice Mismatched Layer. Applied Physics Letter 77 (2000) : 3740-3742.
- [40] C. C. Thet, S. Panyakeow, and S. Kanjanachuchai. Growth of InAs Quantum-dot Hatches on InGaAs/GaAs Cross-hatch Virtual Substrates. Microelectronic Engineering 84 (2007) : 1562-1565.
- [41] ชิ้นงานที่ปลูกโภคโดย Cho Cho Thet มีโครงสร้างคือ InAs ความตัมดอต < 0.8 ML บน $\text{In}_{0.13}\text{Ga}_{0.87}\text{As} / \text{GaAs}$ (001)
- [42] C. L. Zhang, L. Tang, Y. L. Wang, et al. Influence of Dislocation Stress Filed on Distribution of Quantum Dots. Physica E 33 (2006) : 130-133.
- [43] J. Wu, W. Li, T. W. Fan, et al. Breaking up of Misfit Dislocation in GaAs/ $\text{In}_{0.3}\text{Ga}_{0.7}\text{As}/\text{GaAs}$ Heterostructure. Applied Physics Letter 67 (1995) : 846-847.



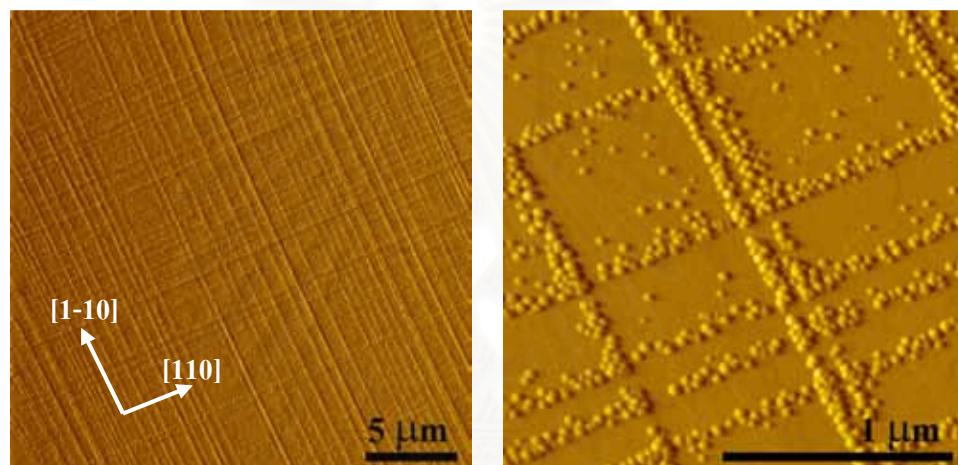
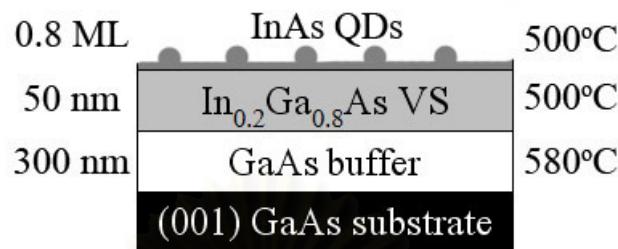
ภาคพนวก

สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

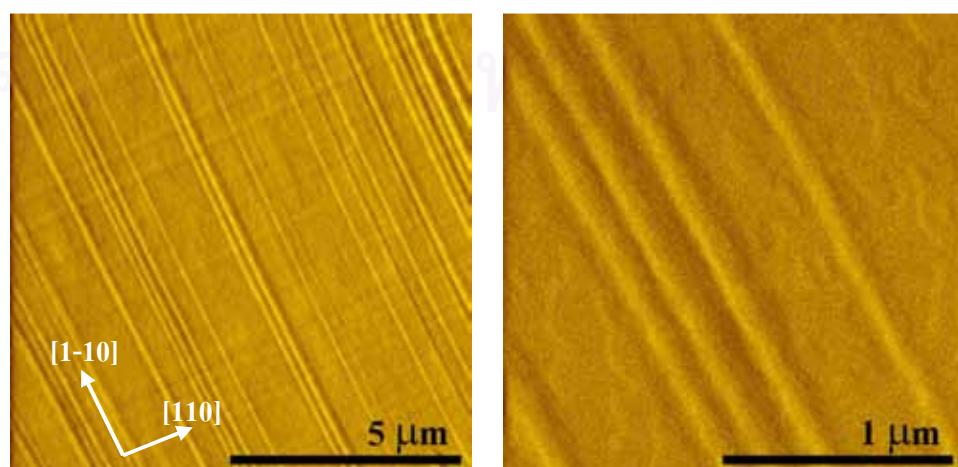
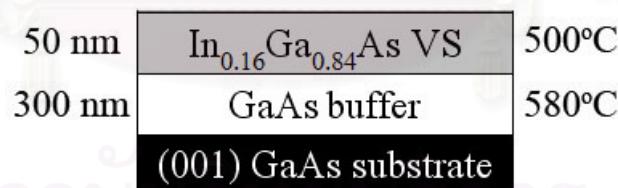
ภาคผนวก ก

รายละเอียดโครงสร้างและขั้นตอน

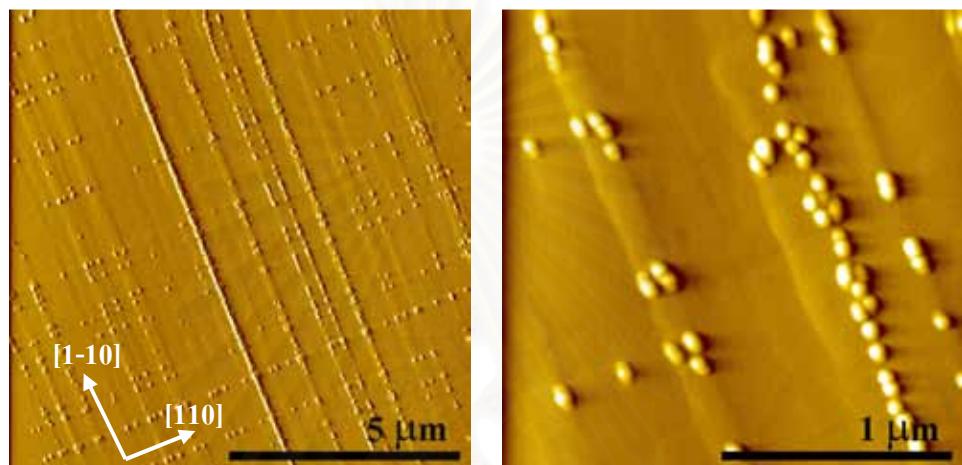
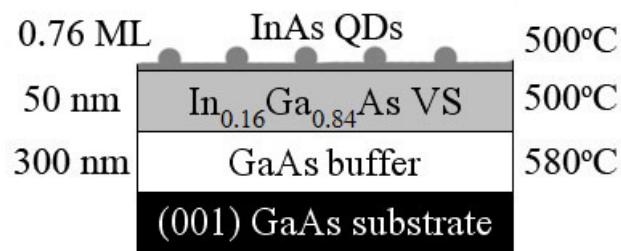
ชิ้นงาน u0702



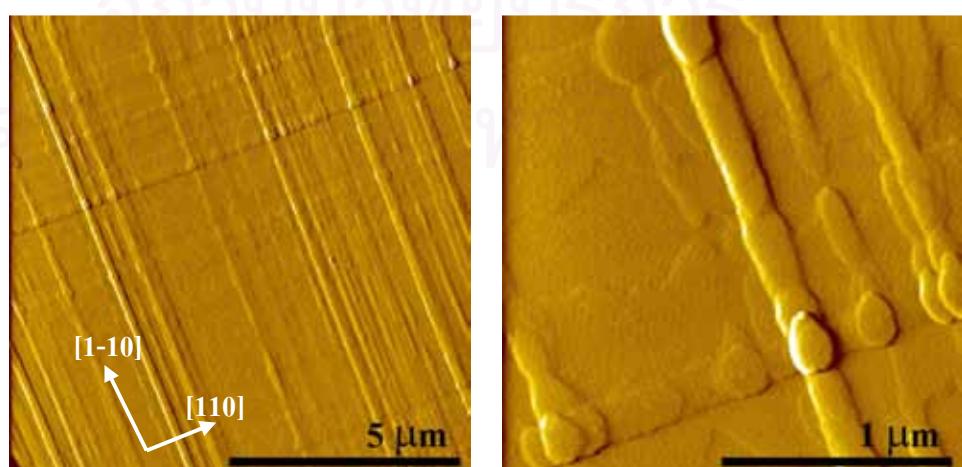
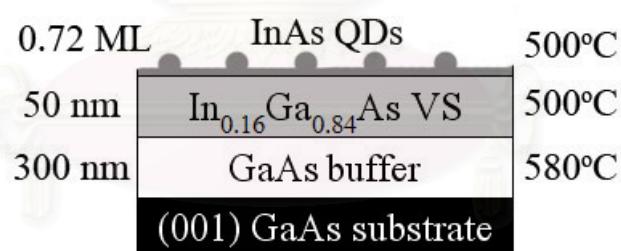
ชิ้นงาน u0811



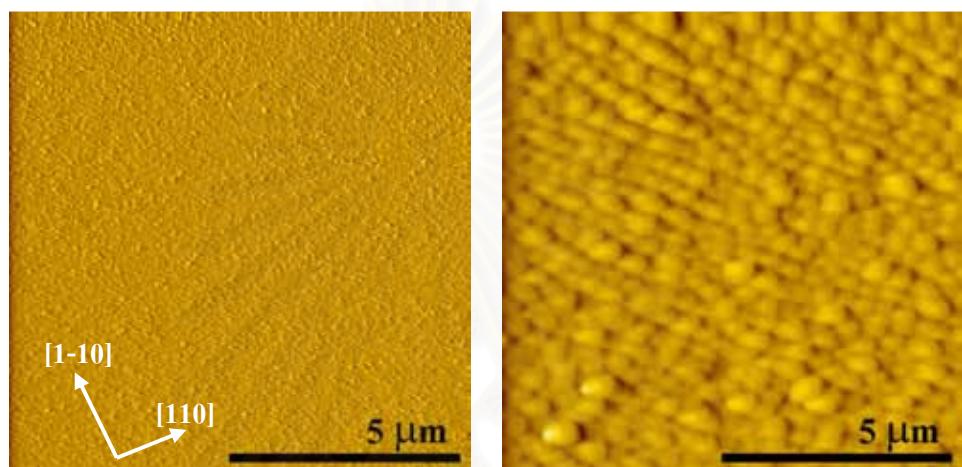
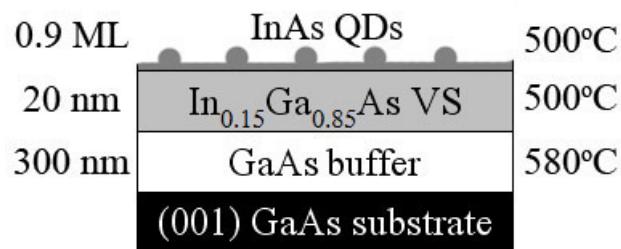
ขั้นตอน u0817



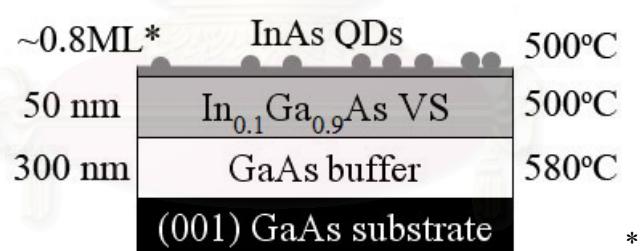
ขั้นตอน u0815



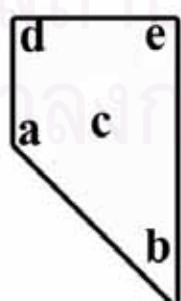
ชิ้นงาน u0842



ชิ้นงาน u0840



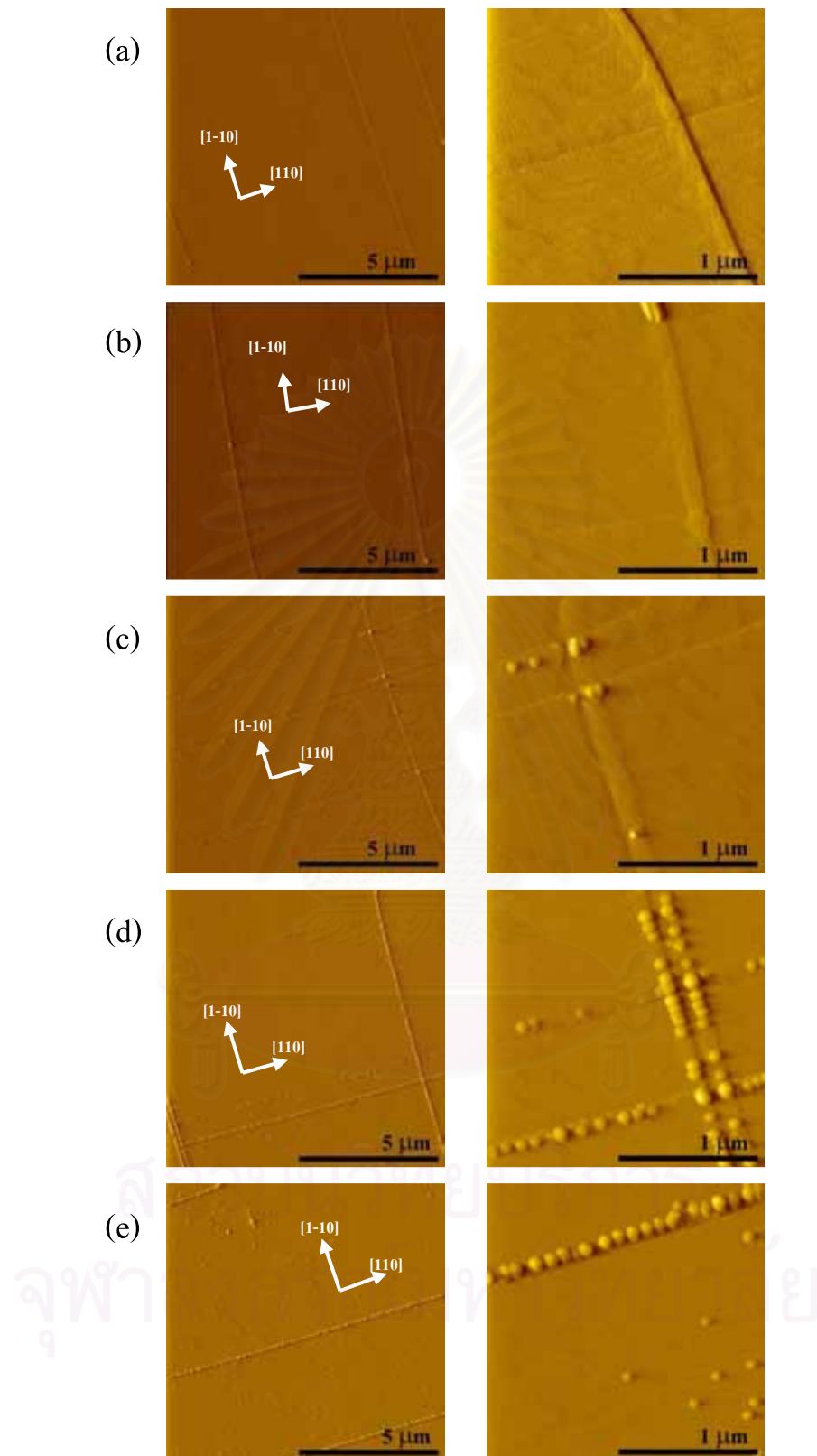
* Motor stop



InAs layer.

ปริมาณของ InAs ที่ตำแหน่ง

$$a < b < c < d < e$$



ภาคผนวก ข

โปรแกรมที่ใช้ประกอบในหัวข้อ 4.4 มีสองโปรแกรมดังนี้

1. 1D-Poisson

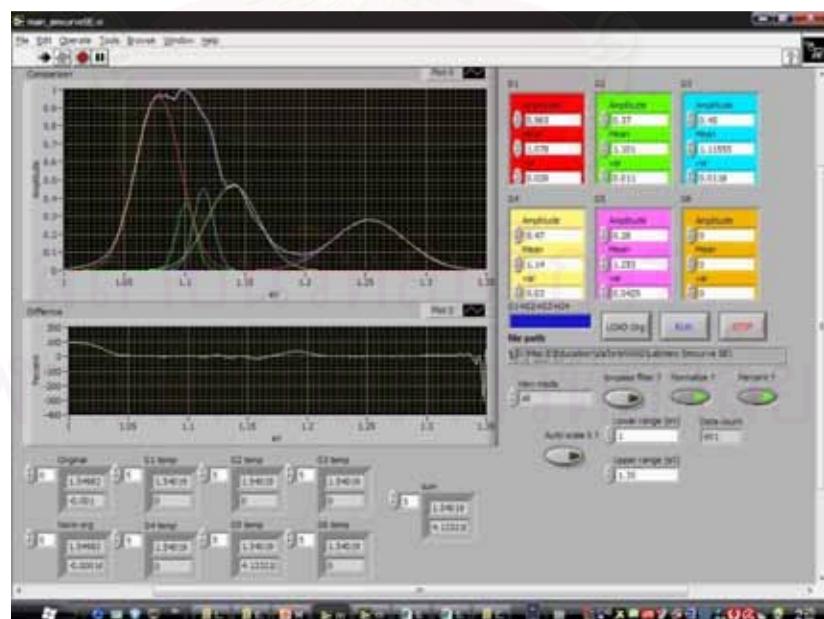
โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ใช้จำลองโครงสร้างแบบหนึ่งมิติ โดยการป้อนข้อมูลของชั้นผลึกแต่ละชั้นในโครงสร้าง เช่น ข้อมูลความหนา, ข้อมูลการโอดป, ข้อมูลชนิดสาร และอัตราส่วนของสารประกอบ เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดอุณหภูมิของผลึกอีกด้วย

พื้นฐานของสมการ Poisson-Schrödinger แบบหนึ่งมิติเป็นส่วนประกอบหลักของโปรแกรม ดังนั้นโปรแกรมจึงสามารถจำลองโครงสร้างได้หนึ่งมิติเท่านั้น

2. LabView

เป็นโปรแกรมหลักที่ใช้สร้างโปรแกรมย่อยสำหรับการจำแนก Gaussian function จากผลการเปล่งแสงที่ป้อนเข้าสู่คอมพิวเตอร์

หลักการของโปรแกรมคือเมื่อป้อนข้อมูลของผลการเปล่งแสงเข้าไปรวมทั้งข้อมูลของ Gaussian function ที่คาดว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของระดับพลังงาน โปรแกรมจะแจ้งผลความแตกต่างระหว่างผลรวมของ Gaussian functions ที่ป้อนเข้าไปและผลการเปล่งแสงจริง เมื่อปรับค่า Gaussian function จนได้ความพิเศษด้านน้อยที่สุดแล้ว จะทำให้สามารถแยกผลการเปล่งแสงจริงออกเป็นผลรวมของแต่ละ Gaussian function และค่าที่ได้ไปคำนวณและออกแบบโครงสร้างใน 1D-Poisson ต่อไปเพื่อให้ได้โครงสร้างเสมือนจริง 1 มิติที่จำลองขึ้นมา



รูปแสดงการหา Gaussian function ที่เป็นส่วนประกอบของผลการเปล่งแสง

ผลงานตีพิมพ์

ในวารสารต่างประเทศ

- “Effective One-dimensional Electronic Structure of InGaAs Quantum Dot Molecule”, Nitidet Thudsalingkarnsakul, **Teeravat Limwongse**, Naparat Siripitakchai, Somsak Panyakeow, and Songphol Kanjanachuchai. Microelectronic Engineering. 85 (2008) : 1225-1228.

ประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ

- “Effective One-dimensional Electronic Structure of InGaAs Quantum Dot Molecule”, Nitidet Thudsalingkarnsakul, **Teeravat Limwongse**, Naparat Siripitakchai, Somsak Panyakeow, and Songphol Kanjanachuchai. Proceedings of the 33rd Micro and Nano Engineering (2007), Copenhagen, Denmark.
- “Effects of Overgrowth and Capping of InAs Quantum Dots Grown on Cross-hatch Surfaces”, Songphol Kanjanachuchai, **Teeravat Limwongse**, Cho Cho Thet, and Somsak Panyakeow. Proceedings of the 34th Micro and Nano Engineering (2008), Greece.
- “Evolution of InAs Quantum Dots Grown on Cross-hatch Substrates”, **Teeravat Limwongse**, Somsak Panyakeow, and Songphol Kanjanachuchai. Proceeding of the 5th Quantum Dots Conference (2008), Gyeong-ju, South Korea.

ประชุมทางวิชาการระดับชาติ

- “Degradation Characteristics of Blue Light-Emitting Diode under Accelerated DC Aging Process”, **Teeravat Limwongse**, Supachok Thainoi, and Songphol Kanjanachuchai. Proceeding of the 4th Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunication and Information technology (2007), Chiang-rai, Thailand : 149-152.
- “Correlation Between Luminescence Properties and Geometry of InAs Quantum Dots”, **Teeravat Limwongse**, Nitidet Thudsalingkarnsakul, Somsak Panyakeow, and Songphol Kanjanachuchai. Proceeding of the 30th Electrical Engineering Conference (2007), Kanjanaburi, Thailand.

ມຄງການໜໍາເສນອ

Oral presentations

1. “Degradation Characteristics of Blue Light-Emitting Diode under Accelerated DC Aging Process”, **Teeravat Limwongse**, Supachok Thainoi, and Songphol Kanjanachuchai. The 4th ECTI (2007), Maefahluang University, Chiang-rai, Thailand, 9-12 May, 2007.
2. “Correlation Between Luminescence Properties and Geometry of InAs Quantum Dots”, **Teeravat Limwongse**, Nitidet Thudsalingkarnsakul, Somsak Panyakeow, and Songphol Kanjanachuchai. The 30th EECON (2007), River Kwai Resort, Kanjanaburi, Thailand, 25-26 October, 2007.

Poster presentations

1. “Effective One-dimensional Electronic Structure of InGaAs Quantum Dot Molecule”, Nitidet Thudsalingkarnsakul, **Teeravat Limwongse**, Naparat Siripitakchai, Somsak Panyakeow, and Songphol Kanjanachuchai. The 33th MNE (2007), Copenhagen, Denmark, 23-26 September, 2007.
2. “Evolution of InAs Quantum Dots Grown on Cross-hatch Substrates”, **Teeravat Limwongse**, Somsak Panyakeow, and Songphol Kanjanachuchai. The 5th QD conference (2008), Hyundai hotel, Gyeong-ju, South Korea, 11-16 May, 2008.
3. “Effects of Overgrowth and Capping of InAs Quantum Dots Grown on Cross-hatch Surfaces”, Songphol Kanjanachuchai, **Teeravat Limwongse**, Cho Cho Thet, and Somsak Panyakeow. The 34th MNE (2008), Athens, Greece, 15-18 September, 2008.

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นายธีรวัฒน์ ลิ่มวงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พุทธศักราช 2527 อาศัยอยู่ที่ บ้านเลขที่ 123 หมู่ 4 ซอยงามจุ้ง 4 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ปัทุมวัน ปีการศึกษา 2544 และสำเร็จ การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัญชี สาขาวิชาบริหารไฟฟ้า จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2548

